



晶宏半導體股份有限公司

2025 年度永續報告書

關於本報告書 GRI 2-2、GRI 2-3、GRI 2-4、GRI 2-5	1
經營者的話 GRI 2-22	3
年度永續亮點	4
1 晶宏永續	5
1.1 關於晶宏 GRI 2-1、GRI 2-6	5
1.2 產業鏈位置 GRI 2-6	8
1.3 營運概況 GRI 2-6、GRI 201-1	8
1.4 社會回饋 GRI 203-1、GRI 203-2	10
2 公司治理	13
2.1 公司治理 GRI 2-12、GRI 2-23	13
2.2 稅務治理 GRI 207-1、207-2、207-3	14
2.3 永續經營 GRI 2-9 ~ GRI 2-21	15
2.4 誠信經營 GRI 2-23、2-24、GRI 205-2、205-3	25
2.5 資訊安全 GRI 2-9、GRI 3-3、GRI 418-1	27
3 鑑別衝擊	33
3.1 利害關係人議合 GRI 3-1、GRI 3-2、GRI 2-29	33
3.2 重大性分析 GRI 3-1、GRI 3-2	35
3.3 重大主題鑑別 GRI 3-2	39
3.4 重大主題管理方針 GRI 3-3	40

4 夥伴共榮	41
4.1 產品品質 GRI 416-1、GRI 416-2	41
4.2 客戶關係管理 GRI 2-6、GRI 418	42
4.3 永續供應鏈 GRI 2-6、GRI 308-1、GRI 414-1	47
4.4 創新管理 GRI 3-3	53
4.5 智慧財產權 GRI 3-3	55
5 友善職場	58
5.1 人才吸引與留任 GRI 401-1、GRI 401-2、GRI 401-3	58
5.2 人才培育與發展 GRI 404-1、404-2、404-3	63
5.3 薪酬福利 GRI 2-19、GRI 2-30、GRI 401-2	68
5.4 人權與員工溝通 GRI 406-1、GRI 412-1、412-2	71
5.5 職安與員工健康 GRI 403-1 ~GRI 403-10	74
6 環境保護	79
6.1 氣候變遷 GRI 201-2	79
6.2 溫室氣體排放 GRI 305-1、305-2、305-3、305-5	85
6.3 能源管理 GRI 302-1、GRI 302-4	87
6.4 水資源管理 GRI 303-1、GRI 303-3、GRI 303-5	89
6.5 廢棄物管理 GRI 306-3、306-4、306-5	90
附錄	92

附錄一 GRI 內容索引表.....	92
附錄二 氣候相關資訊	96
附錄三 產業別永續指標資訊	97
附錄四 其他準則(永續議題資訊蒐集邊界).....	98
附錄五 確信機構意見書	99

關於本報告書 GRI 2-2、GRI 2-3、GRI 2-4、GRI 2-5

1.1 報告書資訊

本報告書為晶宏集團 2025 年度永續報告書(以下稱「本報告書」)(Sustainability Report)內容秉持公開、誠信、務實的原則，揭露晶宏集團 2026 年於永續發展環境、社會、治理中的實踐與作為，藉由本報告書與所有利害關係人分享晶宏集團在永續發展所努力的承諾與成果。晶宏集團 2025 年發行之永續揭露報告，編製之相關資訊如下：

1.1.1 報告範疇

本報告書資訊揭露期間自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，內容以晶宏及財務報告合併子公司為主，範圍涵蓋台灣、大陸東莞、大陸上海等服務據點。

1.1.2 參考範圍

本報告書係參考全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)所出版之 GRI 通用準則 2021 年版編製，報告資訊揭露方向符合上市公司編製與申報永續報告書作業辦法，部份項目參考永續會計準則委員會 SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 準則及氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate related Financial Disclosures, TCFD)之架構，相關準則內容索引檢附於本報告書附錄章節供參。此外，本報告書貨幣相關內容編輯以新台幣為原則，其他非財務量化單位以公認的國際度量標準形式呈現。

1.1.3 永續議題邊界

重大永續議題及重要性原則：邊界涵蓋晶宏半導體(股)公司、子公司超炫科技(股)公司、超核感科技(股)公司、JPS Holding Limited、Ultrachip HK Limited 及大陸子公司東莞晶宏半導體有限公司及晶鴻微電子(上海)有限公司，由相關主管共同篩選出管理方針及策略目標。關於各別永續議題之資訊蒐集與實體組織之對應，請見附錄四其他準則(永續議題資訊蒐集邊界)。

1. 數據揭露：關於人力、環境相關章節，邊界為晶宏及集團合併子公司。為求報告的完整與可比較性，部分章節內容會涵蓋本報導期間以外之資訊，並於該章節補充說明。
2. 財務數據：為母公司晶宏 2025 年年報所刊登的合併財務報表，包含合併營收、每股盈餘、稅務及研發費用等，以晶宏集團為邊界。營運績效揭露之財務績效係依據會計師簽證後之財務報告為準，所有財務數字以新台幣為計算單位，財務數據採用 IFRSs 為基礎所揭露。
3. 報告書審查：報告書所揭露之數據或資料，係由各權責部門提供永續發展委員推動小組進行報告內容編製，完成之報告書送交各部門主管確認無誤後，交由財會部門核閱資料與數據(未經第三方獨立查證機構審查)，呈報永續發展委員會召集人，完成內部審查程序，並

提交永續發展委員會、董事會與公布於官方網站。

1.1.4 外部確信：

非財務資訊：尚未委託第三方驗證機構針對報告書中所揭露的資訊進行查證。

財務資訊：經勤業眾信聯合會計師事務所依據《國際財務報導準則》(IFRSs) 查核簽證之合併財務報告，年度報導期間自 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

1.1.5 報告期間首度發行報告書：2025 年 8 月首度發行 2024 年報告書

本次報導期間：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 止

1. 本次中文版發行日期：2026 年 8 月
2. 上次中文版發行時間：2025 年 8 月
3. 未來發行頻率：每年 1 次
4. 資訊重編：本報告書無資訊重編之情形

1.1.6 聯繫本公司

為提升晶宏集團永續報告書之品質與內容，並促進與利害關係人的溝通，歡迎透過以下方式與我們聯繫。

公司地址：台北市內湖區內湖路一段 308 號 12 樓

公司官網：<http://www.ultrachip.com>

聯絡窗口：王聖芳 協理

聯絡信箱：csr@ultrachip.com

經營者的話 GRI 2-22

晶宏集團秉持“做正確事、現在就做、一次做好”的品質政策，提供給客戶永續的服務，更與供應商攜手創造永續環境，讓企業穩健發展永續經營。

因應全球淨零碳排與企業節能減碳趨勢，晶宏集團致力於超低功耗顯示驅動技術之研發，協助客戶達成減碳與綠色營運之目標；在生產營運面，落實精準的庫存控管與成本優化，強化供應鏈策略夥伴關係，以優異的產品可靠度、卓越品質與穩健的產能配置，滿足客戶訂單需求。STN 產品於工業控制與智慧家電市場已建立穩固基礎，受惠於新能源汽車市場之成長，本公司將加速提升車載儀表及車內智慧顯示之應用佈局。電子紙產品除持續深耕電子貨架標籤(ESL)市場外，將積極擴展至電子字卡、電子書閱讀器、智慧會議桌牌、數位識別證等各項新應用領域，同時全面推進雙穩態顯示 IC 全產品線技術開發，如：T-CON、driver、PMIC，以提升產品附加價值，強化營收及獲利成長動能。微顯示矽基板憑藉 eMP 嵌入式記憶體與數位電流驅動技術，在矽基電路設計上實現了極致的低功耗優勢，有效緩解微型裝置在運作時的散熱壓力，目前已成功應用至消費電子、商用設備及穿戴式零售市場。光學感測元件 IC 之高精度感測技術，可建立抗雜訊與智慧補償。在全球自動化與健康監測需求升溫下，產品已快速滲透至高階消費、商用及智慧物聯網市場，展現強大競爭力。

展望未來

晶宏集團將持續關注全球經濟及地緣政治之影響，深化與供應鏈夥伴合作關係，適度調整產品各製程之產能配置，有效確保產品品質、降低生產成本及提升產能穩定性，以達最具效益之生產組合。本公司將積極投入新產品及技術之研發，提升產品競爭力及顯示技術之滲透率，為客戶提供符合永續及智慧多元性的解決方案，力求在綠色科技市場中尋求新機會，達成營收獲利與環境永續之雙贏局面。

全球經濟景氣瞬息萬變，永續經營仍是我們努力的目標，本公司將更積極投入新顯示技術之研發，追求更高品質且節能省電之驅動 IC，期許為全體股東創造最大之利益！不管未來有多少的挑戰要克服，將正面思考且適時調整經營的策略方針，並搭配全球 ESG 節能減碳的風潮，積極投入新顯示技術之研發，追求更高品質且節能省電之驅動 IC，共創永續經營的目標。

年度永續亮點

人才培育發展

晶宏集團持續加強產學合作，開創多元化招募管道。

晶宏設立多樣化社團活動，獲得 111 人力銀行舉辦之「幸福企業」。

晶宏集團提供給員工多方位的教育訓練，本年度員工訓練總時數為 5,617.5 小時，較去年度員工訓練總時數 3,525.5 小時約增加 59%。

創造永續環境

晶宏集團為 IC 設計公司無自有之工廠，但集團各營運辦公室採取省電節能措施，不僅新購入資產選用節能省電之設備，更宣導員工舉手之勞節電的概念。

持續進行 ISO14064 1 的輔導及盤查，提前完成金管會擬定之「上市櫃公司永續發展路徑圖」時程規劃。

穩健公司治理

晶宏連續五年公司治理評鑑成績維持在上櫃公司前 21%~35% 的名次。

晶宏現任之獨立董事席次超過全體董事會成員半數，已於 2025 年董事屆期改選時，新增一位女性董事，達成董事獨立且多元化。

晶宏董事會每年參考審計品質指標 (AQIs) 評估簽證會計師獨立性及適任性。

1 晶宏永續

1.1 關於晶宏 GRI 2-1、GRI 2-6

晶宏集團(以下簡稱「晶宏」)成立於 1999 年，致力於為全球頂尖的高整合度與低功耗顯示器驅動 IC 技術。我們以台灣台北總部為核心，建構跨越中國大陸、日本、歐美等主要市場的全球化營運網絡。

面對全球氣候變遷與智慧物聯網(AIoT)的蓬勃發展，晶宏不僅專注於小尺寸顯示器驅動 IC 的研發與銷售，更將「低功耗、高整合、綠色永續」視為核心研發 DNA。我們攜手全球供應鏈與系統模組夥伴，致力開發能效領先的綠色晶片，為客戶提供兼具低成本與高環境效益的創新解決方案。

晶宏集團 2025 年營運績效

成立時間	1999 年 8 月 (晶宏)
實收資本額	新台幣 754,607 仟元
全球員工人數	258 人
年度合併營收	新台幣 1,614,117 仟元
營運據點	臺灣 (總部)、中國上海、中國東莞
服務市場	全球市場 (以台灣、中國大陸、日本及歐美為主)
集團成員	晶宏半導體(股)公司、JPS Holding Limited、Ultrachip HK Limited、東莞晶宏半導體有限公司、晶鴻微電子(上海)有限公司、超炫科技(股)公司、超核感科技(股)公司

核心產品與永續技術優勢

主要產品線	應用領域	永續與技術優勢
STN 驅動 IC	家電面板、醫療設備面板等	綠色低功耗設計：專為低成本、低能耗顯示器打造，顯著降低終端產品待機功耗，延長設備使用壽命。
TFT 驅動 IC	智能手錶、車載顯示、可穿戴設備	整合度高與空間優化：晶片深度整合電源管理功能 (PMIC)，有效減少周邊元件數量，協助客戶降低生產成本與電子廢棄物。
觸控整合型驅動 IC (TDDI)	智慧穿戴、消費性電子產品	效能優化：單晶片整合觸控與驅動功能，優化面板能耗與傳輸效率，提升消費性電子的續航力。
光學感測驅動	高階消費、商	高智慧感測：整合類比前端(AFE)與數位訊號處理(DSP)，

IC	用、智慧物聯網 (IoT)	實現高效能的環境光與生物感測，賦能物聯網設備進行智慧節能控制。
微顯示矽基板	AR/VR 微型顯示器、超高分析度投影	次世代節能顯示技術：超高像素密度 (PPI) 與超低功耗驅動技術，滿足未來智慧醫療、工業自動化與智慧生活的高效能、低能耗需求。

晶宏集團深知企業的永續發展與價值鏈息息相關。我們從綠色產品設計源頭出發，落實嚴格的生產與整合管理；同時與晶圓代工廠、封裝測試廠、系統模組廠及專業代理商建立緊密的減碳夥伴關係。未來晶宏集團將持續投入低碳技術研發，以「創新節能、綠色驅動」為目標，立志成為全球客戶在綠色轉型道路上最值得信賴的永續夥伴。

1.企業願景

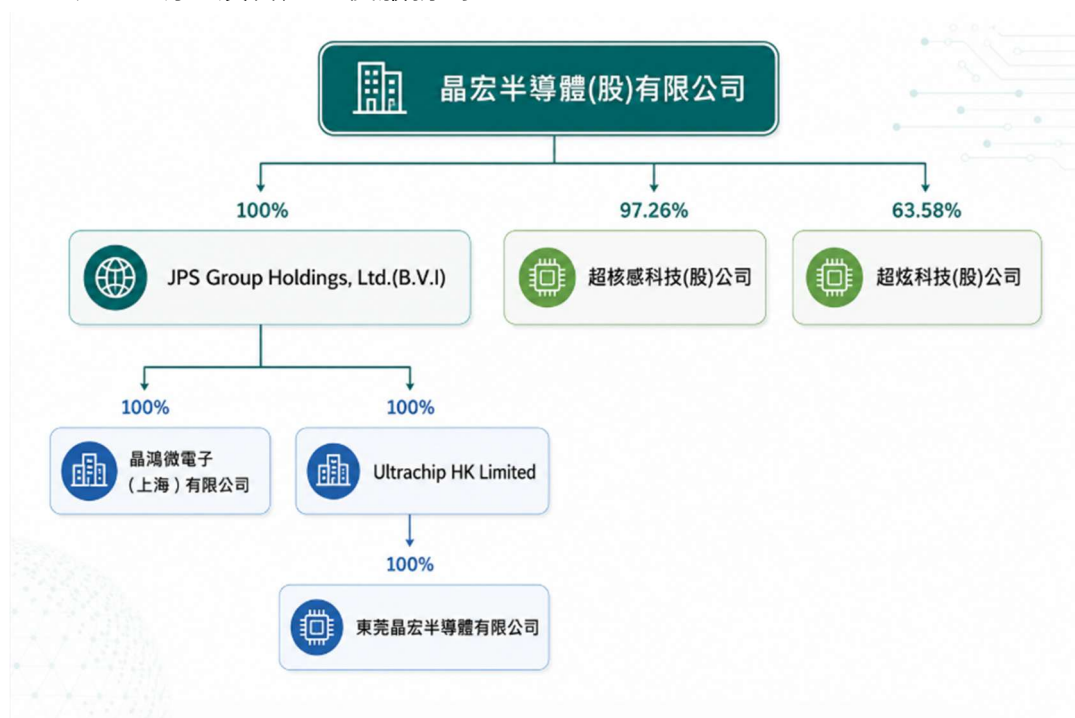
晶宏半導體 (UltraChip) 於創立之初，即以「在積體電路設計的獨特領域做到宏大極致，為世界第一流的晶片設計引領者」為發展藍圖。我們透過經營、研發、營運與銷售團隊的跨部門統合，搭配先進的標準化治理流程，全面落實晶宏的長遠願景與核心任務。

因應國際永續趨勢與半導體行業特性下，晶宏將「四大願景」融入低碳節能、生態設計、供應鏈與產品責任等思維，建構以下四大實踐支柱：

UltraChip 四大願景	實踐說明
獲利上 Profitability	共榮型經濟價值： 透過提供高性價比的晶片，協助客戶降低系統成本並提升終端附加價值。透過彈性且透明的治理機制，將營運成果合理回饋股東與員工，落實長期穩健的永續經濟效益。
技術上 Technology	綠色低碳能效創新： 致力於超低功耗驅動技術與高整合度晶片結構的研發，在微顯示矽基板、光學感測及低能耗雙穩態顯示等技術上追求極致。
功能上 Functionality	設計與環境效益： 利用系統整合設計減少晶片外圍元件，降低客戶端 PCB 板面積與原材料消耗，使產品在維持視覺美感與智慧感測的同時，為綠色物聯網 (AIoT) 提供最高效能。
品質上 Quality	產品責任與韌性： 落實嚴格的產品責任，車載產品全面通過車規級 AEC-Q100 認證，展現高安全性之品質承諾。透過優化晶圓代工、封測廠的良率，降低廢棄物及資源浪費，建立多元供應鏈，以確保地緣政治與氣候變遷下的供貨充足。

2.關係企業組織圖

晶宏集團產品著重於利基型市場之應用，晶宏為中小尺寸顯示器驅動晶片之主要供應商，產品應用以車用、工控、家電及儀表板等市場為主。集團合併子公司經營業務：超核感科技(股)公司-主要營業項目為各式感測晶片之研發及銷售、超炫科技(股)公司-主要營業項目為新型微顯示技術之研發及銷售、晶鴻微電子(上海)有限公司及東莞晶宏半導體有限公司則以中國地區之 IC 銷售及客戶售後服務為主。



3. 近年研發成果

時間	研發成果	應用產品
111	Health monitoring sensor – Proximity + Heart Rate + SpO2 monitor	Wearable, consumer, TWS
	BLDC IPM product mass production	Electric fan, electric tool
112	All-in-one e-paper driver for 4 color ESL display	ESL
113	Skin detection sensor- Senseless BLDC controller	Wearable, Consumer, TWS Liquid cooling pump
114	Light sensor for automobile application True color Sensor(XYZ) to enhance color accuracy	Automobile NB, Pad
	Development of the RISC-V processor for embedded applications	eBook, Consumer
115Q1	High speed half-bridge driver for GaN power switches	Automobile NB, Pad

1.2 產業鏈位置 GRI 2-6

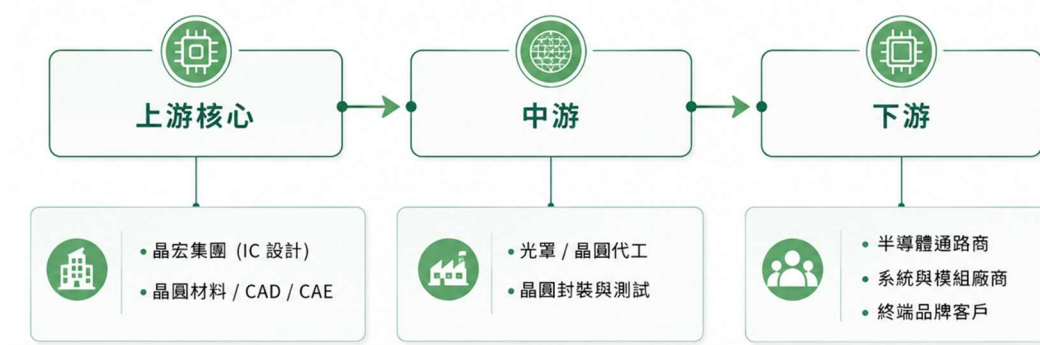
半導體積體電路產業屬全球專業分工模式，整體產業鏈主要可區分為：

上游：以 IC 設計 (Fabless) 及多晶矽、晶圓材料供應為主。IC 設計公司依據市場與客戶需求研發並繪製電路圖，為驅動創新的核心。

中游：以晶圓代工與光罩製造為主。將上游設計好的電路圖，透過先進製程製造於矽晶圓上。

下游：以封裝與測試為主。將完成的晶圓進行檢測、切割、封裝與最終晶片測試，隨後交由通路商、模組廠及系統廠，應用於終端消費性與商用電子產品。

晶宏集團為專業的顯示器驅動 IC 與智慧感測晶片設計公司，位居半導體產業鏈之上游核心。我們專注於高整合度、低功耗之晶片研發、系統設計與銷售，不擁有實體晶圓廠，後續的生產製造均委託國內外頂尖的專業晶圓代工廠商進行，再由專業的封裝及測試廠實施一連串的晶圓檢測、切割、封裝與成品測試。



晶宏集團與產業鏈中的上下游夥伴長期保持緊密且穩固的專業分工合作關係。我們協同晶圓代工廠與外包封測廠商將製程優化與生產技術開發，在確保產品達到高良率與優異能效的同時，亦能為客戶提供迅速準確的交期與高規格的品質。

面對全球供應鏈不確定性，晶宏集團積極落實供應鏈多元化，持續評估並開發符合環境與社會責任標準的新供應商，以確保產能擴充無虞並維持彈性的生產調度。

單位：仟顆

SASB 指標編號	指標項目	2025 年
TC-SC-000.A	晶片總生產數量	129,002
TC-SC-000.B	自有場所產量之百分比(註)	0%

註:晶宏集團為 IC 設計公司，主要營運為晶片設計與銷售，未設置生產線，100%委外製造。

1.3 營運概況 GRI 2-6、GRI 201-1

重大主題-經營績效

策略目標	●追求產品差異化優勢及具競爭力的技術門檻，達到永續營運的承諾。
------	---------------------------------

	●深耕長期往來客戶，掌握市場發展趨勢。 ●積極布局與開發多元應用市場，提供低耗能的綠色產品
核心目標	<u>短期:</u> ●鞏固現有產能，並增強與晶圓代工廠、封裝廠、測試廠等外包廠商策略合作關係，以便獲得穩定充足之產能與技術服務。 ●開發新代工廠並與現有的代工廠增加新製程合作項目，以增加新產能，並提升產能調配之彈性。 ●提升客戶服務品質，與客戶維持長期策略夥伴關係。 ●爭取國內外知名廠商之訂單，提高中小尺寸顯示器驅動 IC 市場占有率。 ●持續提高公司知名度及強化市場定位，向全球車用、工業及醫療大廠推廣公司技術及產品。 ●建立全球之行銷通路商，以利產品之推廣及銷售，並加強對客戶之工程支援及後續服務。 <u>中長期:</u> ●持續開發新產品，爭取成為全球顯示器驅動 IC 之領導廠商。 ●持續爭取與國際大廠技術與銷售之合作機會，提升市場知名度及佔有率。 ●在全球主要市場建立銷售及技術服務據點。 ●維持技術的領先，加強產品的研發。 ●與供應鏈廠共同開發新製程與技術。 ●整合相關技術，擴大產品線廣度和技術層次深度。 ●整合產業供應鏈，強化品牌商與面板廠溝通與合作，擴大經濟規模。
負責單位	各業務單位、財會行政單位。
績效成果	產品在利基市場穩定成長，持續貢獻公司營收。 產品組合持續優化及新產品的導入，明顯提升毛利率。
行動方案	加速開發新產品，以提升產品競爭力。 擴增晶圓代工合作的夥伴，提高製程良率滿足客戶需求。 產品技術領先，因應多元化的產品應用需求。
投入資源	增加高毛利產品且穩定銷售。 加強供應商管理機制。 加速新產品開發時程。
申訴及溝通管道	主管會議/管審會議 /產品及產銷會議 。 年度計畫及預算審查。 各部門目標達成率。

1. 經營績效

會計科目	113 年度	114 年度	差異金額	成長率%
營業收入	1,507,390	1,614,117	106,727	7.08
營業毛利	580,253	566,206	(14,047)	(2.42)
營業淨利	2,666	19,138	16,472	617.85
稅後淨利(不含非控制權益)	87,023	39,955	(47,068)	(54.09)

2025 年度全球經濟環境雖受通膨壓力及地緣政治動盪之影響，晶宏集團憑藉在顯示驅動技術領域的深厚佈局，工控儀器及車載應用產品仍維持穩健出貨之成長動能，使 2025 年度合併營業收入達新台幣 1,614,117 仟元，較 2024 年度成長 7.08%。在獲利表現方面，儘管營業毛利受匯率波動及年度庫存去化調整影響而小幅下滑，但本公司透過嚴格的費用控管與營運效率優化，使 2025 年度營業淨利較 2024 年度大幅成長 617.85%，然受新台幣兌美元匯率波動影響致業外淨匯兌損失增加，致 2025 年度合併稅後淨利較 2024 年度減少新台幣 47,068 仟元。

2. 股利政策

晶宏股利的分配比率，係視當年度實際獲利、資本預算及資金狀況等相關因素予以調整，同時兼顧股東之利益，當年度決算如有盈餘，除依法完納稅捐及彌補以往年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分派之。

本公司前期累積之帳列其他權益減項淨額，應自前期末分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。歷年股利分配如下：

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
每股盈餘 EPS (新台幣/元)	9.80	7.01	1.13	1.16	0.54
現金股利 (新台幣/元)	4.00	2.67	0.51	0.51	0.36
股利分配率 %	41%	38%	45%	44%	67%

1.4 社會回饋 GRI 203-1、GRI 203-2

晶宏集團深信，企業的價值不僅來自於商業上的成功，更來自於對社會的正面貢獻。我們秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，將企業影響力延伸至弱勢關懷、偏鄉教育與地方共榮。2025 年度，晶宏透過定期捐款、物資支援、教育資源挹注以及綠色採購等多元管道，積

極落實地方社群之實質支持。為創造永續環境並落實企業公民責任。晶宏攜手在地具公信力之慈善機構，針對中低收入戶、身心障礙者及突發性變故之弱勢群體，提供即時之資金及物資協助，緩解社會基層生活壓力。

項次	項目	社會貢獻	對應 SDGs 永續目標
1	靈鷲山慈善基金會，推動「全台送暖專案」	晶宏秉持互助與分享的精神，2025 年度對「新北市靈鷲山慈善基金會(83 北府社三字第 099267 號函奉准設立)」捐贈新台幣 200,000 元。此筆資金實質轉化為 500 箱急難生活物資，配送至全台各縣市之中低收入戶與邊緣戶家庭。此外，晶宏今年正式加入「普仁之友」行列，承諾長期協助該基金會推廣慈善志業，引導社會正向循環。	SDG 1 終結貧窮  SDG 2 消除飢餓 
2	支持自閉症協進會，資助營運資源	為協助心智障礙者順利接受各項福利措施與早期療育服務，晶宏密切關注在地機構的營運痛點。2025 年度，晶宏向「財團法人桃園市自閉症協進會」捐贈辦公家具一批，優化其第一線行政與諮詢空間，以具體行動支持身心障礙同仁的照護環境與早療計畫之推動。	SDG 3 良好健康與福祉  SDG 10 減少不平等 
3	響應綠色公益採購，支持宜蘭聯勸基金會	晶宏將永續觀念融入企業日常採購，2025 年本公司選擇向「財團法人宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會」採購中秋團圓禮盒作為企業贈禮。總採購費用中 10%提撥作為弱勢尊嚴生活扶助金，晶宏集團以此專案累計捐助約新台幣 10,000 元，將傳統節慶送禮轉化為推動地方社會福利的永續動力。	SDG 10 減少不平等  SDG12 責任消費與生產 
4	偏鄉教育與希望翻轉	2025 年度，晶宏與尾牙合作廠商達成永續共識，攜手發起「尾牙綠色回饋計畫」。將部分尾牙籌辦費用轉化為教育公益基金，提撥捐贈予「花蓮縣光復國小」，用於購置教育物資與設立獎助學金。透過經濟資源的直接挹注，實質緩解偏鄉家庭的就學負擔，提升在地基礎教育之韌性，讓偏鄉的孩子們能在充滿關懷與資源充足的環境中茁壯成長。	SDG 4 優質教育  SDG 17 夥伴關係 

目前晶宏集團的社會參與多以企業層面的資金與物資挹注為主。為進一步鼓勵員工親身投入弱勢關懷與環境保護活動，評估未來透過志工假或公益假之給予，鼓勵員工走入社群、親身投入弱勢關懷與環境保護活動，將 DEI (多元、公平、共融) 精神融入並深化於晶宏集團。

2 公司治理

2.1 公司治理 GRI 2-12、GRI 2-23

晶宏於 2020 年 7 月 31 日董事會決議通過，指定王協理兼任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。王協理已具備公開發行公司從事財會行政之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等。

1.本公司治理人員主要職責為：

- (1)辦理公司登記及變更登記。
- (2)研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、公司透明度及法令遵循與內部控制制度落實。
- (3)依法辦理董事會及股東會之相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
- (4)製作董事會及股東會議事錄。
- (5)提供董事人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，協助董事遵循法令。
- (6)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- (7)與投資人關係相關之事務。
- (8)其他依公司章程或契約所訂定之事項。
- (9)應參與「上市櫃公司永續發展行動方案」相關宣導活動或課程，並向董事會報告。

2.業務執行情形如下：

- (1)協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
- (2)協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：
- (3)維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並股東權益受到良好的維護。
- (4)擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- (5)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記。

3.當年度進修情形：

人員	進修機構	課程名稱	時數
公司治理主管	證券暨期貨市場發展基金會	115 年度 ESG 評鑑宣導會	3
	證券櫃檯買賣中心	114 年公司治理評鑑宣導說明會	3
	中華民國會計研究發展基金會	「永續資訊之管理」內控內稽重點與實務案例解析	6
		「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6

2.2 稅務治理 GRI 207-1、207-2、207-3

1. 治理原則

晶宏集團在稅務治理首重稅務風險之管控，期望透過良好的租稅規劃使租稅成本有效降低，進而提升公司競爭力。晶宏集團所有營運活動皆依循營運所在地之稅務法令，晶宏負責督導稅務治理之執行，並向管理階層報告，以確保稅務管理機制有效運作，輔以外部稅務諮詢機構提供專業諮詢，由會計師事務所協助覆核稅務揭露資訊之合理性及正確性，以符合穩健經營及誠實納稅原則，降低稅務風險，善盡企業社會責任。

2. 風險管理

- (1) 法令遵循：各子公司遵循所在地之稅務法規與其相關稅務立法精神，於法定期限內申報並繳納稅款，善盡納稅義務人之社會責任。
- (2) 資訊透明：遵循財務報導準則及政府規定，定期揭露稅務資訊，確保稅務資訊透明化。
- (3) 誠信溝通：以開放及誠實態度，與稅務機關建立相互尊重之關係。
- (4) 人才培育：強化稅務人員專業能力，稅務會計師不定期提供最新稅務法令及時事新聞，並於年度安排稅務訓練課程，以提升稅務人員專業素養。

3. 移轉訂價管理

全球各國稅務機關對於企業移轉計價之查核日趨嚴格，晶宏集團之移轉訂價政策主要考量各子公司之經濟實質基本原則，並在符合各營運地之稅務法令之前提，訂定常規交易價格，以降低各營運地稅務機關之查核風險。

- (1) 經濟實質原則：實際檢視晶宏集團中各公司之功能角色，及所處營運地之法令規定或產業環境變動因素，不以避稅為唯一目的而進行規劃。
- (2) 常規交易訂價：依據晶宏集團中各公司所承擔功能之風險重要性，而給予合理之利潤，並每年度因應內外部經營環境之變化而適時調整。

2.3 永續經營 GRI 2-9 ~ GRI 2-21

2025 年在人工智慧浪潮推動與地緣政治韌性要求的雙重交織下，使企業迎來結構性的轉型。異常氣候的常態化、國際碳邊境調節機制的實質推進，以及各國對企業供應鏈人權與環境盡職調查的嚴格立法，使得永續治理不再僅是企業的合規責任，更是決定市佔率與營運的核心競爭力。

晶宏集團深知在經營成果獲利的同時，更要維持永續經營。政府法規政策的推動使資金投向永續創新、商業模式的轉型、與利害關係人創造共用價值、培育人才等，這些累積的資源也為未來永續、減碳的行動種下正循環的契機。2025 年，我們持續將永續注入日常營運與商業模式之中，透過政府法規政策的引導，將資金與研發資源投入低碳產品創新、綠色供應鏈打造及人才培育。我們致力與全體利害關係人創造共用價值，將綠色資本累積轉化為驅動企業長期價值增長的正循環。

我們將永續落實於環境 (E)、社會 (S) 與治理 (G) 三大構面，具體行動如下：

■ 環境面 (Environmental) — 超低功耗顯示技術

綠色低碳產品設計：晶宏持續發揮在顯示器驅動 IC 的技術優勢，以超低耗電、極小尺寸為核心研發方向。2025 年，我們透過優化電路架構與縮減晶片體積，顯著減少晶片在上游製造、封裝及終端應用時的材料消耗與能源碳足跡。

溫室氣體與能源管理：晶宏集團積極遵循台灣「2050 淨零排放路徑圖」，於 2025 年全面深化與落實 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，並依據盤查結果訂定明確的階段性節能減碳目標。採購具備一級能效之節能設備，宣導管控節水節電指標。

■ 社會面 (Social) — 打造綠色供應鏈

負責任供應鏈管理：全面落實「供應商行為準則」，2025 年持續精進責任商業聯盟 (RBA) 標準之遵循。我們實施嚴格的責任礦產採購政策 (拒絕衝突礦產)，並針對供應商進行環境與勞工權益盡職調查，嚴格禁止使用童工，保障勞工健康與安全環境。

多元與包容的人才培育：視員工為企業最寶貴的資產，2025 年我們建構了完整的員工在職訓練與個人生涯發展路徑，提供客製化技術與管理課程，以提升員工同仁的向心力與專業價值，維持健康的留才機制。

社會產學合作：持續擴大與國內外大專院校之產學合作計畫，為半導體設計領域培育綠色科技人才；同時，透過捐贈與贊助相關公益團體，實質回饋在地社會。

■ 治理面 (Governance) — 深化風險防禦機制，健全公司治理文化

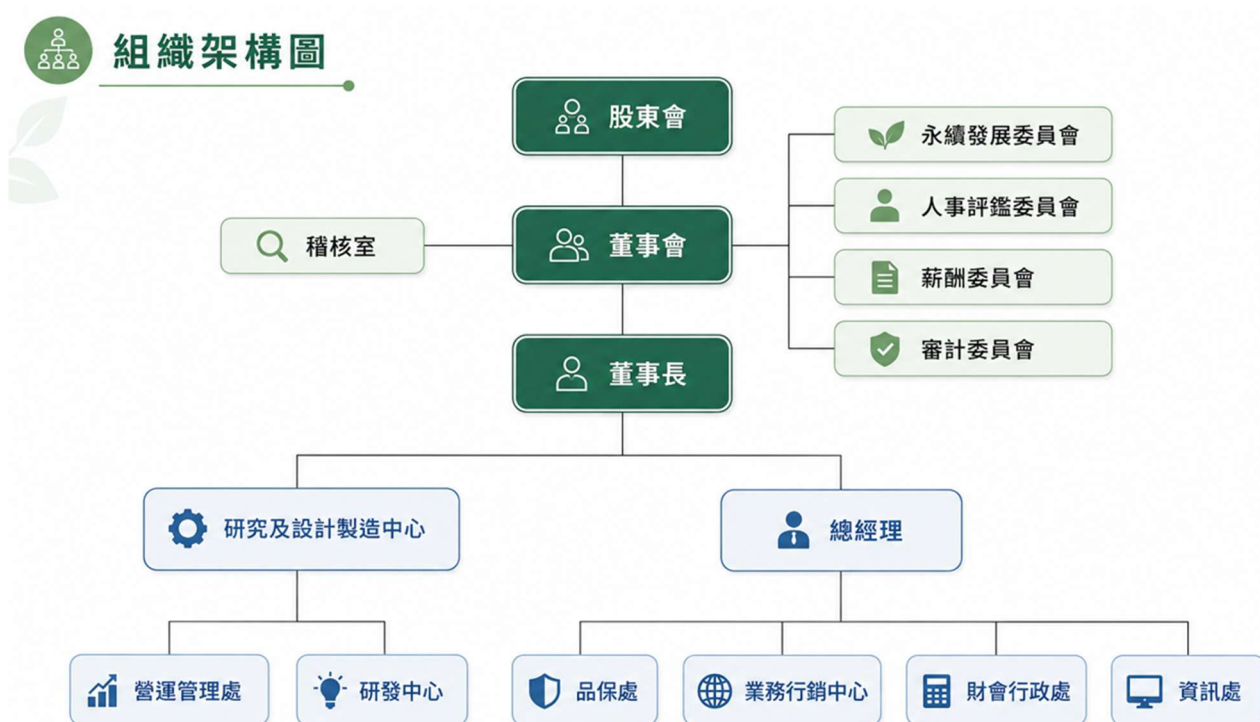
永續與風險管理：依據「風險管理政策與程序」，於董事會下由高階管理階層成立之「永續發展委員會」，定期向董事會匯報氣候風險、資安風險及 ESG 關鍵績效，確保永續策略與企業營運策略深度結合。

資訊安全防護：面對日益嚴峻的網路威脅，2025 年晶宏持續強化並升級資安防護架構，導入多因子驗證與端點防禦，並對全體員工進行全面性的防範惡意郵件宣導與資安實戰演練。

公司治理評鑑：落實公司治理評鑑各項指標，持續提升資訊揭露之透明度與即時性，保障股東與有利害關係人之權益，建立誠信經營之企業文化。

2.3.1.永續委員會

晶宏集團以創造企業長期價值為基礎，落實環境、社會和治理上的風險管理，持續關注氣候風險、與供應鏈一起實現綠色低碳的願景。一直以來秉持著誠信經營之文化，建立良好公司治理制度，遵循政府法令之營運，落實企業永續經營。晶宏董事會係由深具產業經驗、技術發展之專業人士所組成，並依照主管機關規定，設立審計委員會、薪酬委員會、永續發展委員會，協助董事會發揮內控機制，健全薪酬制度、執行永續發展策略，以善盡公司治理職責，以強化董事會職能。



1.組織架構

晶宏為建立良好公司治理，於 2024 年訂定永續發展組織規程，並於 2025 年成立永續發展委員會落實企業永續發展，集團合併子公司亦遵循母公司晶宏之規範達到公司治理。

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，爰依本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」規定，本公司已成立專職單位 - 永續發展委員會，係由各處級單位主管擔任各組負責人，並由董事長擔任委員會主席，各組分工如下：

(1)永續經營風險組：

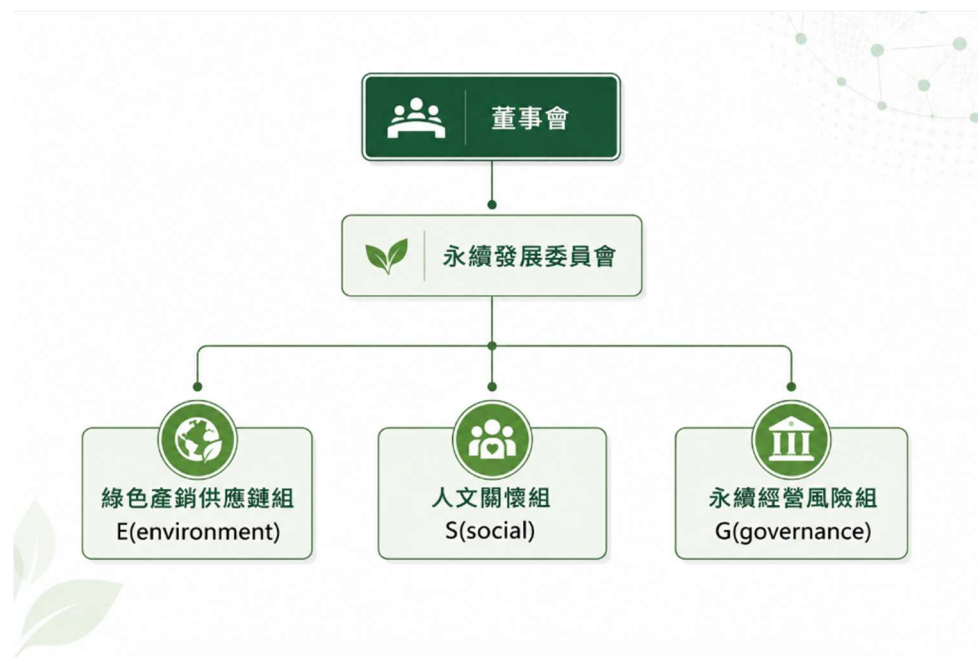
- 擬定風險管理政策。
- 風險管控相關議題之督導、改善及執行。
- 推動及協調風險管理活動。
- 彙編各功能單位之風險管理報告
- 確保風險管理機制之持續有效。

(2)綠色產銷供應鏈組：

- 提供本公司環境保育及碳排放、碳中和相關的政策和計畫，包含氣候變遷與能源管理、廢棄物管理、推動綠色產品。
- 供應鏈與客戶端環境永續等相關事項。

(3)人文關懷組：

- 制定公司治理策略、制度及組織架構，董事會的獨立，內稽內控的落實。
- 落實公司誠信經營、風險管理及資訊安全等風險管理相關工作。
- 遵循國際人權原則，落實員工培育，創造適於員工職涯發展的環境與制度。
- 實踐社區關懷及回饋社會，藉由商業活動或實物捐贈、參與社區發展及教育。



永續發展委員會每年一次向晶宏董事會報告永續發展執行成果，以檢討運作成效及相關利害關係人之議題。內容包含(1)公司之永續議題，擬定因應之對策；(2)永續發展之目標及策略；(3)督導永續經營之實施及執行情形。已於 2025 年 10 月 31 日董事會報告。各董事平時即對其所擬訂之永續經營議題，對各項目提出執行的重點，評估調整並給予建議。亦請經營團隊於當年度執行時，若因實務變化使可能性低時，隨時於董事會提出討論修正，以督促目標的完成。

2.3.2 永續風險管理

晶宏於 2022 年 10 月經董事會通過訂定「風險管理政策與程序」，作為風險管理之最高指導原則，並於永續發展推動小組下設「永續經營風險組」每年定期進行風險因子鑑別，藉以辨識可能影響企業永續發展的各項風險，宣達與溝通重要風險管理事項，以執行及追蹤各項風險管理決議事項。並遵從規定執行必要之作業及風險管理工作，確保所涉風險控制於可承擔之範圍內且有效地控制。

為增進本公司穩健經營與永續發展，依據公司整體營運方針，建置及維持有效之風險管理架構，確保風險管理運作完整性並落實制衡機制，提升分工效能，使風險控制在公司可承受範圍，達到風險與報酬合理化之目標，提升企業價值。公司與內外部利害關係人維持良好之溝通管道，針對疑義進行協商，此外為降低突發事件所帶來之負面衝擊，已設置永續發展委員會，協助推動小組各項風險管理政策之推行。

晶宏風險管理組織架構包括董事會、永續發展推動小組、稽核室、各單位。

- (1)董事會-為風險管理最高決策機關，審核並監督整體風險之存在或潛在風險之。董事會負責核定風險管理政策及重要風險管理制度，並監督風險管理制度的執行，以確保風險管理机制之有效運作。
- (2)永續發展推動小組-協助董事會執行其風險管理職責，負責審查提出之各項風險管理議題。故於公司永續發展推動小組下設「永續經營風險組」，由本公司各處為權責單位，辨識所轄業務面臨之各項風險，宣達與溝通重要風險管理事項，以執行及追蹤各項風險管理決議事項。並遵從規定執行必要之作業及風險管理工作，確保所涉風險控制於可承擔之範圍內且有效地控制。
- (3)稽核室-直接隸屬於董事會，對本公司之風險管理進行查核，適時提供管理階層掌握內部控制已存在或潛在風險議題，確保其符合既定規定與控管程序。

1.風險範疇

本公司針對各種策略、營運、財務及危害性等潛在的風險與營運及獲利可能造成影響，建置及維持有效之風險管理架構，確保風險管理運作完整性及落實並評估風險事件發生的頻率及

對公司營運衝擊的嚴重度，來定義風險的優先順序與風險等級，並依風險等級採取對應的風險管理策略。本公司的風險管理包括營運風險、財務風險、策略風險、危害風險、法律風險及其他風險之管理。

2.風險管理運作執行情形

本公司於永續發展委員會組織下，設立永續經營風險組，擬定風險管理政策、推動及協調風險管理活動及風險管控相關議題之督導、改善及執行等，以確保風險管理機制之持續有效。本公司每年定期向董事會報告風險評估情形，最近一次係於 2024 年 11 月 05 日於董事會報告。各董事對擬訂之永續經營風險議題，提出執行重點，並給予建議。若因實務變化使目標達成可能性降低時，隨時於董事會提出討論修正，以督促目標的完成。

2.3.3 董事會及功能性委員會 |

1.董事會職責

晶宏董事會主要是監督公司守法、財務狀況透明、了解揭露公司重要訊息並決議重要事項，此外更透過與經營階層的溝通討論，調整公司的策略及發展。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- (1)營運判斷能力。
- (2)會計及財務分析能力。
- (3)經營管理能力。
- (4)危機處理能力。
- (5)產業知識。
- (6)國際市場觀。
- (7)領導能力。
- (8)決策能力。
- (9)風險管理知識與能力。

2. 董事會成員

晶宏董事會由七位具備不同背景及工作領域之專業人士組成，且為了強化董事會結構及健全監督功能，選任四位獨立董事，董事會成員資訊如下：

姓名	主要學經歷	目前主要職務
徐豫東	美國麻州州立大學管理科學碩士	晶宏半導體(股)公司董事長暨總經理、超炫科技(股)公司法人董事代表人暨董事長、超核感科技

	英特爾公司行銷經理、世界先進業務經理、沛訊半導體業務暨行銷協理、晶磊半導體業務暨行銷副總	(股)公司法人董事代表人暨董事長、晶鴻微電子(上海)有限公司法人董事代表人暨董事長、東莞晶宏半導體有限公司法人董事代表人暨董事長
董事- 簡學仁	美國麻省理工學院化工工程碩士 世界先進積體電路(股)公司董事長暨總經理	福住投資(股)公司董事長、福住建設(股)公司董事長、永誠營造(股)公司董事、竹間實業(股)公司監察人、緯創資通(股)公司獨立董事、南亞電路板(股)公司獨立董事、兆捷科技國際(股)公司獨立董事
董事- 黃秋永	台大 EMBA 肄業 毅嘉科技(股)董事長	毅嘉科技(股)公司董事長、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、毅嘉科技(馬來西亞)有限公司董事、ICHIA USA INC.董事長、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD 董事、ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD.董事長、ICHIA UK LTD.董事長、ICHIA HOLDINGS (H.K.)CO., LTD.董事長
獨立董事- 徐建華	成功大學化學工程碩士 聯華電子(股)公司經理、廠長、資深副總、和艦科技(股)公司總經理、董事長	漢磊科技(股)公司法人代表董事長暨執行長 嘉晶電子(股)公司法人代表董事長暨策略長 威諾投資(股)公司法人代表董事長暨總經理
獨立董事- 王鶴偉	台灣大學醫管所博士 集邦科技(股)公司光電處總經理	優材科技有限公司董事長
獨立董事- 林再林	台北工專電機科(台北科技大學電機系) 世平興業(股)公司合夥創辦人	大聯大控股(股)公司董事、台灣產業控股協會副理事長、台北市電子零件商業同業公會(TECSA)常務理事、范特喜微創文化(股)公司董事、雲創通訊(股)公司董事、漢氫醫藥生技(股)公司董事、漢氫科技(股)公司董事、三商家購(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員、大橡股份有限公司監察人
獨立董事- 吳孟璘	美國史丹福大學材料科學與工程學系碩士、國立清華大學材料科學與工程學系學士 穎崴科技(股)公司董事、聯陽半導體(股)公司資深專案經理/資深行銷與業務經理、聯華電子(股)公司新事業開發資深經理/資深製程整合工程師	達盈管理顧問(股)公司副總經理/董事/合夥人、達駿資產管理(股)公司監察人、達晨創業投資(股)公司董事、達駿創業投資(股)公司董事、慧盛(股)公司董事、點序科技(股)公司獨立董事/審計委員會/薪酬委員、智齡科技(股)公司法人董事、思必瑞特生技(股)公司法人董事、泛亞應用科技(股)公司法人董事、亞亞科技(股)公司監察人

3.董事會多元性

本公司於「公司章程」明確規定董事選任以候選人提名制進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下兩大面向之標準：

(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2)專業知識技能：專業背景(如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 3 位董事，獨立董事席次占比為 57%，董事會成員具備財務、會計、風險管理及法律等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 20%以上，目前 7 位董事，有 1 位女性董事，未來將依此方向努力，董事會成員落實多元化情形如下：

多元項目 董事姓名	基本組成					產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期年資	領導決策	經營管理	產業知識	國際市場	法律	會計	行銷管理	風險管理
董事長-徐豫東	中華民國	男	總經理	66-70 歲	不適用	√	√	√	√	√	√	√	√
董事-簡學仁	中華民國	男	無	71-75 歲	不適用	√	√	√	√		√	√	√
董事-黃秋永	中華民國	男	無	66-70 歲	不適用	√	√	√	√	√		√	√
獨立董事-徐建華	中華民國	男	無	66-70 歲	6 至 9 年	√	√	√	√	√		√	√
獨立董事-王鶴偉	中華民國	男	無	51-55 歲	6 至 9 年	√	√	√	√	√		√	√
獨立董事-林再林	中華民國	男	無	71-75 歲	0 至 3 年	√	√	√	√	√		√	√
獨立董事-吳孟璘	中華民國	女	無	51-55 歲	0 至 3 年	√	√	√	√	√	√	√	√

晶宏已訂定內部重大訊息處理及內部人申報作業程序及防範內線交易程序並於公司治理實務守則明訂董事不於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。本公司每年至少一次提供董事、監察人、經理人及受雇人「防範內線交易作業程序」及「內部重大訊息處理及內部人申報作業程序」相關法令之教育宣導及課程進修，本年度於 2025 年 12 月對董事、經理人及受雇人進行內部重大訊息、保密及違規作業處理進行宣導，寄送給所有董事、監察人、經理人及受雇人等資料參考，並將課程簡報與影音檔案置於內部員工教育訓練系統。課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理，計 207 人次進行 311 小時教育宣導。

本公司每季提醒董事、經理人及受雇人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

本公司已於 2025 年每季次月以郵件通知提醒董事及各內部人，董事會開會日期以及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事及內部人誤觸該規範。

4.董事參與永續發展相關進修

2025 年課程名稱	時數	ESG 相關課程
全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	6	V
智慧財產權態樣、權利保護與 AI 相關議題	3	V
全球經濟情勢與川普新政的效應	6	
地緣政治下資安治理及管理	3	
非合意併購實務與公司治理議題	3	
打造永續績效指標與獎酬	3	V
人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3	V
企業的危機管理與溝通	3	
全球化企業管理策略	3	
AI 驅動的產業數智轉型與商業創新應用	3	V
公司治理與證券法規	3	
證券交易法下公司與董監之義務與責任	3	V
董監應注意之非常規交易及財報不實實務問題	3	
公司重大資訊揭露與董監責任	3	V

5.董事會評鑑情形

母公司晶宏已於 2020.07.31 訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行以提升董事會及功能性委員會之運作，作為檢討及改進之依據。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	2025.01.01~ 2025.12.31	董事會績效評估、 個別董事成員績效 評估	董事會 內部評估	公司營運之參與程度
				董事會決策品質
				董事會組成與結構
				董事的選任及持續進修
				內部控制
			董事成員自評	公司目標與任務之掌握
				董事職責認知
				對公司營運之參與程度
				內部關係經營與溝通

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
				董事之專業及持續進修
				內部控制

母公司晶宏已完成 2025 年度董事會之績效自評，並提送 2026.02.24 董事會報告。董事會績效自評整體平均分數為 4.68 (滿分 5 分)，個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.73 分 (滿分 5 分)，顯示整體董事會運作良好。

6.董事及高階經理人薪酬政策

- (1)董事酬金：係依晶宏之公司章程之規定年度尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算董事酬勞；如有獲利，應提撥不高於百分之五為董事酬勞；參考『董事成員(自我或同儕)評估問卷』、董事會績效評估、董事會出席情形及董事進修情形來訂定酬金，經薪酬委員會審核後提交董事會核准，再呈報股東會，依董事人數作分配。
- (2)總經理、副總經理及高階經理人酬金：係包括固定薪酬、績效獎金、員工酬勞和其他薪酬，依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌該職位同業水準議定之。晶宏每年進行兩次績效考核，納入評估的有職務及管理成效、年度績效目標及 ESG 永續績效指標(包含研發節能省電之綠色產品、提高產能利用率不浪費資源、財務資訊即時揭露保障股東權益、完善員工留才及獎酬制度、落實資安政策防止機密外洩等)，上述評估項目連結其變動獎酬，經報薪酬委員會審核後提交董事會通過執行，以達到永續經營之目標。

7.董事會成員及高階經理人接班規劃

- (1)董事會：晶宏現任董事會由 7 位董事組成(含 4 位獨立董事)，各具備財務、會計、風險管理及法律等不同背景及工作領域之專業，以強化董事會結構及健全監督功能。董事會成員每年均依法進修相關課程至少 6 小時，公司每年亦提供董事相關法規及進行內部人注意事項宣導，以獲取新知並熟悉在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司的治理制度。2025 年董事進修課程內容包含企業風險管理與危機處理、員工獎酬策略探討、企業永續及 ESG 相關法律等，未來亦注重董事會成員之性別，目標女性董事為 20%以上，多元化的背景將延續並予以強化。
目前集團內有多位高階經理人，擁有卓越的領導力與競爭力，且具備出色的策略思維、豐富的研發實績、以及企業經營規劃的實力，使他們成為未來接班人選的關鍵，為董事會奠定堅實的領導基礎，並確保組織在快速變化的環境中持續穩健成長。
- (2)重要管理階層之接班規劃：晶宏重視核心管理階層的發展(協理級以上員工)，透過經驗傳承、重要專案推動、跨專業領域的鍛煉及參與公司營運政策的制定等方式，來強化及培養

現有管理階層的優勢，為公司重要管理層的接班規劃做好準備。我們鼓勵副總級管理階層於 EMBA 進修，有效發展領導人思維，帶領團隊達成目標。

晶宏每月定期召開主管會議，討論經營績效、設定經營目標、策略方向規劃及經營績效檢討等，由董事長與重要主管共同參與，研討各營運面的策略及解決方案，亦透過會議培養領導人應具備的高效能工作準則與思維模式，並促進全體與會者達成一致之價值與理念。本公司持續培育內部具潛力的中、高階經理人，運用績效考核制度，結合專案指派、定期會議及工作交流等方式，全面提升未來經營團隊的實力。同時有系統地評估與甄選適合的接班人選，預計 5-10 年後從中拔擢，10-15 年後接班，確保公司在未來的競爭環境中穩步前行，持續創造卓越成就。

2.3.3 審計委員會職責

母公司晶宏為建全審計監督功能及強化管理機能成立審計委員會，主要職責為確保財報允當、內控有效及會計師獨立性等相關法令遵循。

年度工作重點：

- (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)年度財務報告及半年度財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

母公司晶宏審計委員會由 4 名獨立董事組成，各自擁有專業資格與經驗，2025 年 6 月 11 日至 2028 年 6 月 10 日止，審計委員會至少每季召開一次會議。2025 年度審計委員會共舉行 4 次，整體出席率為 100%，個別成員詳細資料及委員會運作情形請詳 2025 年年報。

2.3.4 薪酬委員會職責

以專業客觀之地位，訂定董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準及結構，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

晶宏薪酬委員會成員共 3 名，皆由獨立董事組成，各自擁有專業資格與經驗，委員會任期為 2025 年 6 月 11 日至 2028 年 6 月 10 日止，薪酬委員會每年至少召開 2 次會議。2025 年度薪酬委員會共舉行 2 次，整體出席率為 100%，個別成員詳細資料及委員會運作情形請詳 2025 年年報。

2.3.5 功能性委員會評鑑情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	2025.01.01 ~ 2025.12.31	審計委員會績效 評估、薪資報酬 委員會績效評估	審計委員會、 薪資報酬委員 會內部評估	公司營運之參與程度
				審計委員會、薪資報酬委員會職責認知
				提升審計委員會、薪資報酬委員會決策品質
				審計委員會、薪資報酬委員會組成及成員選任
				內部控制

晶宏於 2020.07.31 訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行以提升董事會及功能性委員會之運作，作為檢討及改進之依據。已完成 2025 年度審計委員會及薪資報酬委員會之績效自評，並提送 2026.02.24 董事會報告。審計委員會及薪資報酬委員會績效自評結果整體平均分數分別為 4.81 分及 4.72 分(滿分 5 分)，顯示審計委員會及薪資報酬委員會運作良好。

2.4 誠信經營 GRI 2-23、2-24、GRI 205-2、205-3

晶宏集團將「誠信」視為企業永續發展與核心文化的指導原則。我們遵循「公司治理實務守則」善盡公司治理，管理階層積極落實誠信經營之承諾，並在內部管理及商業活動中確實執行誠信經營政策。本公司嚴格禁止任何形式的貪腐、賄賂、勒索、挪用公款或不正當利益之輸送，並透過健全的內部控制制度與誠信宣導，將誠信經營思維內化於日常行為中。

1.專責單位與董事會監督

為落實誠信經營，本公司設置「人事評鑑委員會」作為企業誠信經營守則之專職單位，負責辦理相關規章之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容之登錄建檔。人事評鑑委員會每年定期向董事會報告誠信經營之推動與執行情形，以確保最高治理階層的實質監督。2025 年度 2025 年 10 月 31 日，專職單位向董事會報告當年度之誠信經營治理實績。

2.誠信經營政策與宣導

為防止利益衝突、深化誠信文化，本公司已訂定一系列完善的內部管理規範，包含：「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為辦法」，積極落實企業之誠信文化及穩健發展。同時，本公司的日常工作代理制度以及與客戶、廠商

間簽訂之商務合約中，全面訂有防止利益衝突及誠信行為之相關條款，將誠信經營之約束力由公司內部實質延伸至外部供應鏈，確保整體商業活動符合道德標準。

為落實誠信經營之核心價值，本公司每年透過課程向公司各級主管、資深同仁及新進員工宣導，誠信道德與反腐意識，並將誠信政策與法令資訊張貼於公佈欄及公司內部系統，以確保全員隨時掌握遵法規範。2025 年度透過線上課程推動誠信經營之重要性，全年度同仁參加之教育訓練課程（包含誠信經營相關法規、會計及內控制度等相關專業課程），累計受訓達 727 人次，合計總受訓時數高達 2,391 小時。

3.舉報機制與檢舉人完整保護

本公司建立起公開、透明且互信的多元內外部獨立舉報管道，任何人不論具名或匿名，若發現任何違反誠信道德、涉嫌貪腐或從事任何不法行為之情事，均可進行舉報。外部檢舉管道（官方網站專區信箱）：need@ultrachip.com；內部檢舉管道：同仁可採取具名或匿名方式進行檢舉，且公司訂有適當之獎酬制度鼓勵對不法行為進行舉報。本公司建立獨立管道進行案件查證，全方位保護檢舉人，確保內部治理之公平性。

嚴格保密：本公司對檢舉案件及檢舉人身分納入最嚴格之安全體系，實施絕對保密，確保檢舉人不會因舉報而遭受任何職場不利益之處置或報復。

保障申訴機會：基於公平誠信原則，調查過程中亦會提供被檢舉之相對人適當且充分的申訴機會，確保調查程序之正當性。

公正決議機制：案件調查視必要時，將召開人事評鑑委員會進行實質審議與處分決議。

2025 年度，本公司無因營運、員工違反誠信道德行為或從事任何不法行為而遭受申訴或舉報之事件，重大誠信違規事件總數為 0 件。同時本公司於 2025 年度沒有發生任何因違反社會、經濟及環境相關法律或法規而遭受重大罰款或非金錢裁罰之情事。

重大主題-誠信治理

策略目標	透過公司之「道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」與「檢舉非法與不道德或不誠信行為辦法」等相關辦法，依循永續發展為指導原則，以落實誠信經營之企業文化。
核心目標	<u>短期</u> ： ● 新進及全體員工每年進行誠信、智財權及營業秘密等相關課程。 ● 對員工及供應商持續宣導「道德行為準則」及「供應商行為準則」，並要求簽署確認函及遵守規範。

	<u>中期</u>： ● 透過教育訓練與宣導，使違反人群(包括人權)、經濟及環境之相關法律或法規及員工貪腐事件及其他違反誠信經營重大情事為零。
負責單位	財會行政處、永續推動小組、品保單位。
績效評估	● 董事長與高階主管定期會議，了解公司永續治理方案與成果。 ● 員工每年持續進行誠信經營相關課程，且完訓率達100%。 ● 100%供應商簽署情形「供應商行為準則」。
行動方案	● 持續遵循ESG評鑑指標，強化公司治理，落實功能性委員會及董事會之監督 ● 稽核單位每年進行稽核，了解法令遵循之情形，且向審計委員會和董事會報告查核結果及追蹤改善情形。 ● 公司治理主管定期向董事會報告誠信經營實績。 ● 透過每年對員工宣導誠信及營業秘密之政策，深化誠信經營之企業文化。
投入資源	● 設置人事評鑑委員會為企業誠信經營守則之專職單位，並於公司官網及內部網站設置檢舉信箱。 ● 每年透過教育訓練對所有員工宣導誠信守則及政策。
申訴及溝通管道	外部由公司網站信箱檢舉 need@ultrachip.com。 內部可具名或匿名檢舉並提供適當的獎酬，並保密檢舉案件。

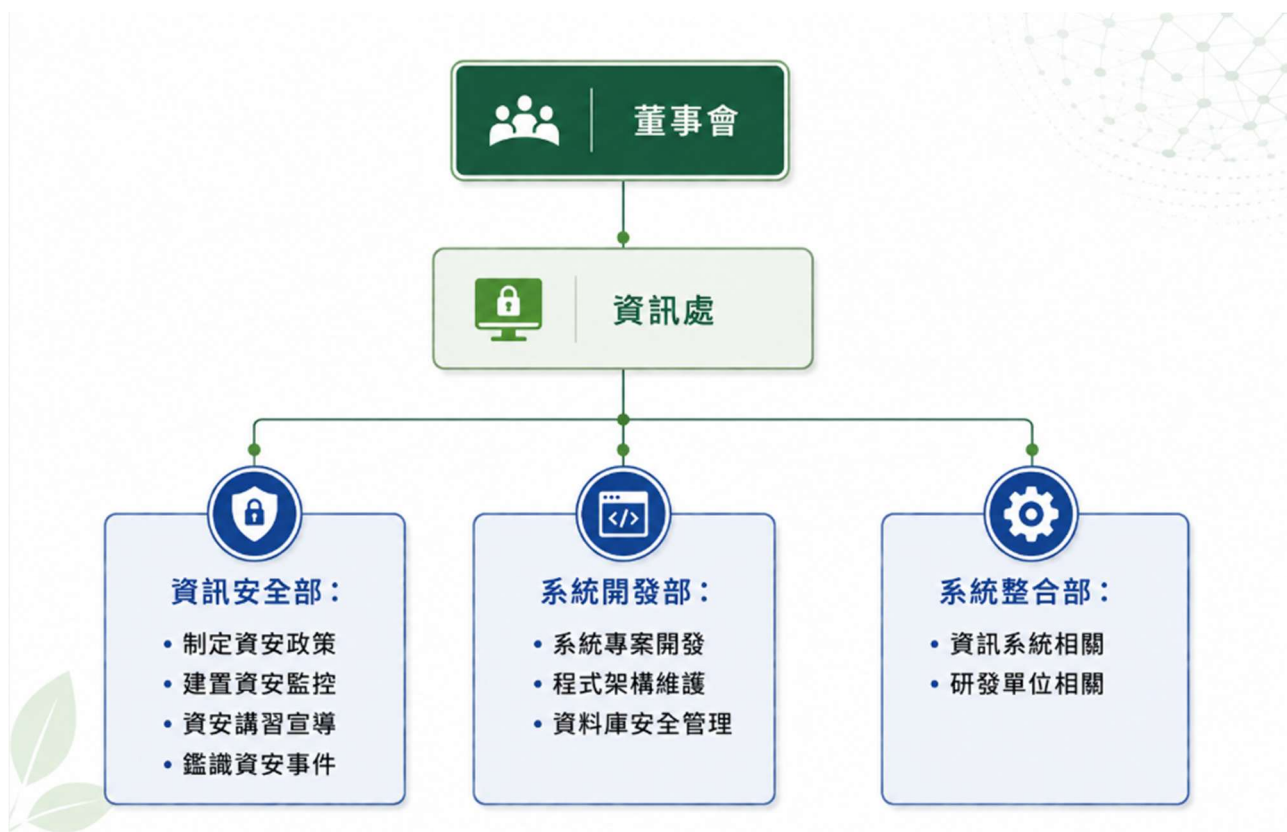
2.5 資訊安全 GRI 2-9、GRI 3-3、GRI 418-1

身為 IC 技術提供者，晶宏集團將「資訊安全」與「客戶隱私保護」視為企業營運韌性與誠信經營的最高防線。我們致力將資安治理內化於日常維運中，透過職能明確的專業部門分工，全面保障公司核心技術、商業機密及客戶夥伴之智慧財產權，確保資料安全(機密、可用、完整)、高效率之服務，以實踐永續經營之承諾。

1. 治理架構與部門職掌

為確保公司資訊安全管理制度之權責明確，並有效落實資安政策之推行，本公司嚴格遵循台灣「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 9 條之 1 之規定，設置資安專責單位。資訊處最高主管擔任資安召集人，配置資安專責主管及專責人員，督導資訊處下三大部門。針對重大風險評估或特定資安議題，視需要召集法務、稽核、人力資源及研發等單位共同研議。每年定期向董事會報告資安執行結果與防禦成效，集團合併子公司亦同步落實此資訊安全管理政策。

依據公司實際營運規劃，資訊處下區分為部門，各司其職且高效協作，建構起完整的日常防禦與系統維護：



(1)資訊安全部：負責資訊安全政策之制定、資安風險評估與緊急應變計畫之擬定。同時負責建置第一線資安監控機制（包含分析潛在威脅、監控異常行為規則），主辦員工資安講習及宣導，並於發生非預期事件時，進行即時的資安事件鑑識與追蹤改善。

(2)系統開發部：負責公司系統與軟體程式之專案開發與維護。針對日常營運之系統進行高安全性的資料庫管理，確保開發流程符合規範，從源頭阻斷系統漏洞。

(3)系統整合部：聚焦於跨系統的技術整合與介接。針對「資訊系統相關」、「跨平台系統整合相關」之業務，建構安全的資料傳輸渠道，確保辦公環境之資料對接具備防護，以防範跨系統整合時之相關風險。

資訊處最高主管定期彙整三大部門的日常監控數據、風險改善成效及稽核結果，每年至少一次直接向董事會進行專案報告（已於 2025 年 10 月 25 日完成董事會報告），由最高治理階層實質監督資安風險與資源投入。

2. 資訊安全政策

為有效落實資安管理，晶宏資訊處依據「規劃、執行、查核與行動 (Plan-Do-Check-Act, PDCA)」的管理循環機制，動態檢視資訊安全適用性與保護措施，並定期回報執行成效，確保資安規範持續有效：

(1)規劃階段 (Plan) - 資安風險管理：著重於前瞻性資安風險管理，建立完整的資訊安全管理系統機制，從「系統面、技術面、程序面」三大維度全面降低企業資安威脅，為客戶與

供應鏈夥伴建立最高規格的機密資訊保護服務。本公司制定有嚴格的《個人資料保護管理政策》，針對客戶、員工及合作夥伴之個人資料蒐集、處理與利用，落實最小化權限控管與加密傳輸，以維護個人隱私與資訊安全。

(2)執行階段 (Do) - 多層防護與流程：建構多層次的智慧資安防護網，持續導入資安防禦創新技術。將資安控制機制深度整合並內化於軟硬體維運、供應商資安管理等平日作業流程中，實施系統化日常監控，以維護本公司重要技術資產之機密性、完整性及可用性。

(3)查核階段 (Check) - 成效監控與評鑑：積極監控資安管理成效，依據查核結果進行資安關鍵指標衡量。同時透過定期模擬演練資安攻擊、郵件社交工程演練等，進行內部資訊安全成熟度評鑑，確保防禦機制的彈性。

(4)行動階段 (Act) - 持續演進與優化：以「檢討與持續改善」為主，落實嚴謹的日常監督與內部稽核，針對發現之潛在缺口立即啟動因應對策，確保資安管理規範。

3.資安管理方案

管理項目	施行措施與具體方案	預期治理效益
網路安全	●強化網路防火牆與網路控管，防止電腦病毒跨機及跨區擴散。 ●依據網路服務需要區隔獨立的邏輯網域 (如 DMZ 隔離區)，並針對不同作業環境建立適當之資安防護措施。	阻斷非法存取，防範網路邊緣之資料洩漏。
裝置安全	●建置端點防毒措施，強化惡意軟體與勒索病毒之行為偵測。 ●建置端點資安監控措施，偵測並警示非法連線之風險及意圖。 ●全天候留意安全漏洞通知，即時修補高風險系統漏洞與 Patch 更新。	強化端點網路存取之安全，降低惡意軟體侵入風險。
帳號與權限管理	●特權帳號(Privileged Accounts)實施最小化原則，需得申請核准後方可限時、限額使用。 ●定期審查特權帳號、使用者帳號及權限，停用久未使用之閒置帳號。 ●外部連線之 VPN 全面強制採用多重因素認證 (MFA /多重認證) 機制。 ●啟動多次登入失敗自動鎖定機制。 ●建立通行密碼管理之嚴格規定，包含預設密碼變	避免因憑證或帳密洩漏，而導致資料外流或跨島式資安攻擊。

	更、密碼長度、複雜度、有效期限等。	
資料安全	● 針對核心驅動 IC 研發、智慧財產等機敏性資料之處理及儲存建立高強度防護，如：實體隔離、專用電腦作業環境、存取權限控管、關鍵資料不落地與資料加密等。 ● 完整落實機敏性資料之本地備份、異地備份以及虛擬化備援機制。	確保企業最核心技術資產與無形資產之機密性與完整性
資安監控與維護	● 建構機敏性資料異常讀取或大量下載之即時自動化警示系統。 ● 全天候監控內網異常連線與攻擊警示。 ● 針對網際網路服務隔離區 (DMZ) 之攻擊實施即時警示，包含 WWW、DNS、FTP、Mail 等通道。 ● 設 VPN 攻擊警示與帳號密碼暴力破解攻擊警示。	強化資安事件之主動應變力，將營運衝擊降至最低。
教育訓練與宣導	● 持續加強員工對最新郵件社交工程攻擊 (如 AI 變體釣魚郵件) 之警覺性。 ● 定期舉辦全員資安教育訓練及主題宣導，提升全員資安意識。	確認資安政策有效性，建立全員資安 DNA。

4.執行成果

(1)資安經費與專責人力投入：2025 年度，本公司針對資訊安全相關設施之維護、資安軟硬體技術升級與防衛改善，實質投入高達約新台幣 220 萬元。在人力配置上，本公司自 2022 年 8 月起即落實配置 1 名資安主管及 1 名專責資安人員，專職負責全集團資通安全之規劃、督導、執行及事件通報回應。

(2)多樣化的訓練與加強資安防護：

- 全員資安教育訓練：2025 年度資安電腦及宣導相關課程，累計參與同仁達 216 人次，深化全員日常防範技巧。
- 實體專業講習：2025 年度舉辦 1 場實體資安講習課程，聚焦於 AI 對資訊安全的風險。
- 資安專業證照取得：為確保資安團隊之技術，本公司積極支持資安同仁參與外部專業訓練，2025 年度資安同仁成功取得 Certified Ethical Hacker (CEH)及 iPAS 資訊安全證照共 2 張，為公司的資安防護網提供最專業的技術厚度。

2025 年度，晶宏集團未發生任何重大資訊安全事件，亦無任何因資安漏洞而影響公司營運、財務或商譽之情事。

晶宏目前的資安管理機制與日常運作流程，皆參考國際 ISO/IEC 27001 資訊安全管理標準

之核心精神進行建置。為進一步強化企業韌性並與國際標準接軌，公司已將「取得 ISO27001 資訊安全管理系統認證」納入 2026 年度目標，預計透過外部專家稽核與持續優化，深化客戶對晶宏資訊安全防護的信賴。

重大主題-資安與隱私管理

策略目標	● 網路安全：保證網路服務妥善並強化內、外網路資訊安全。 ● 裝置安全：落實端點防毒措施及端點資安監控措施並即時修補高風險漏洞。 ● 資料安全：確保資料的機密性、完整性和可用性。 ● 帳戶管理：推動帳戶多重認證機制(外部服務)，並訂定帳戶驗證通行政策。
核心目標	<u>短期：</u> ● 成立資訊安全委員會。 ● 導入ISO 27001資訊安全管理系統。 ● 持續性的資通安全教育和宣導。 ● 持續進行網路設備、系統日誌收集與分析。 ● 持續進行端點偵測及應變措施。 ● 持續進行端點設備弱點掃描及安全性漏洞更新。 <u>中期：</u> ● 建立資通安全威脅偵測與管理平台。 ● 收集各系統來源數據及其交叉分析。 ● 異常行為及事件之監控。 ● 異常事件即時警示機制。 ● 資安事件通報應變與情資評估因應。 <u>長期：</u> ● 建立全面的資通安全文化。 ● 資通安全合規性與法規遵循。 ● 資安威脅情報分享與合作。 ● 資通安全風險管理。 ● 資通安全之持續精進及績效管理機制。
負責單位	資安專責單位。
績效評估	● 每季定期報告資安相關指標執行狀況。 ● 每年定期向董事會報告資安執行結果。
行動方案	● 權責： 資安專責單位制定安全政策。

	提供資訊安全宣導。 非預期資安事件鑑別與處置。 ● 教育訓練與宣導： 加強員工對社交工程攻擊之警覺性。 定期舉辦資安教育訓練及宣導，提升員工資安意識。 ● 網路安全管理： 強化網路防火牆與網路控管，防止電腦病毒跨機及跨區擴散。 依據網路服務需要區隔獨立的邏輯網域 (如 DMZ)，並針對不同作業環境建立適當之資安防護措施。 ● 資料存取控制： 機敏性資料之處理及儲存，建立防護措施，如：實體隔離、專用電腦作業環境、存取權限、資料加密等。 阻斷機密與敏感資料直接存取的渠道，關鍵資料不落地。 機敏性資料之本地、異地備份以及備援機制。 ● 資訊紀錄的保護： 蒐集網通設備、伺服器、資安各項服務等必要資訊紀錄。 除交付監控系統分析外，並作保存保護。
投入資源	● 增加網路設備管理及異常監控機制。 ● 建立資通安全偵測與管理程序。 ● 提升資通安全知識及軟硬體升級。
申訴及溝通管道	資安專責單位

3 鑑別衝擊

3.1 利害關係人議合 GRI 3-1、GRI 3-2、GRI 2-29

晶宏集團視利害關係人的議合為企業永續發展的基石。本公司參考 AA1000 利害關係人議合標準 (AA1000 SES) 之五大核心維度 (依賴性、責任、張力、影響力及多元觀點) 進行綜合性權重衡量，判斷對晶宏集團具有影響性及受本公司影響的團體或組織。

透過問卷方式每兩年進行再次鑑別，請晶宏永續發展委員會委員、部門主管及集團合併子公司部門主管勾選出其業務往來所接觸的利害關係人類型及考量個別利害關係人相互影響程度與重要程度，篩選出 5 類對晶宏集團而言具有重要性的主要利害關係人。永續推動小組本年度延續前一年度鑑別結果，共計 5 類主要利害關係人分別為客戶、員工、投資人、供應商、政府與主管機關。各項核心利害關係人日常之溝通管道、頻率與回應機制，請參閱「主要利害關係人議合與溝通對照表」。

晶宏集團之利害關係人由於身份類別不同，使得各類別的利害關係人關注議題有差異，各部門主動透過多元管道與利害關係人持續良性互動，讓利害關係人能適時瞭解公司營運概況；同時透過公司網頁揭露聯絡信箱，掌握利害關係人對晶宏集團的期待並及時回應，每年定期向董事會報告，2025 年公司與利害關係人議合之現況：

利害關係人	重要關注議題	溝通方式及聯絡方式	溝通實績
客戶	1.市場品牌形象 2.顧客安全及品質 3.產品責任法規遵循	1.客戶滿意度調查 2.產品品質若有問題，與客戶舉行品質會議 3.提升成本競爭力，減輕客戶負擔 4.定期收集經銷商財報彙總分析表 5.連絡窗口:產銷規劃部 顏小姐 sales@ultrachip.com	1.整體客戶滿意度為 93.5%。 2.經銷商年度定期會議。 3.配合客戶執行碳盤查。 4.不定期聯繫客戶，以確認客戶需求及未來產品走向。
員工	1.勞資關係 2.平等無歧視 3.社會法令的遵循 4.職業安全	1.定期與勞方代表開會互動 2.透過公告及郵件與員工多元化溝通 3.員工滿意度調查及意見調查 4.連絡窗口:人力資源管理部 李小姐	1.2025 年每季舉行勞資會議。 2.2025 年每季召開職工福利委員會。 3.2024 年 07 月舉行員工定期體檢。 4.2025 年 2 月舉辦春酒餐會，分享公司經營情形及未來展望。 5.每月發送健康資訊公告。

利害關係人	重要關注議題	溝通方式及聯絡方式	溝通實績
	與健康	hr@ultrachip.com	6.每年年度旅遊補助及每日下午茶之員工福利。 7.半年度執行績效考核，依獲利狀況發放績效獎金。 8.設置員工申訴專用信箱，目前無同仁回饋申訴事項
投資人	1.投資及經營績效 2.勞資關係 3.供應商品質及環境 4.顧客安全及品質 5.法令遵循	1.每年召開股東常會 2.每年依規定發行年報於股東會發送 3.定期召開法人說明會 4.於公開資訊觀測站公佈經營狀況重大訊息 5.公司官方網站設置投資人專區 6.連絡窗口:財會行政處 王小姐 invest@ultrachip.com	1.2025 年 6 月 11 日召開股東常會，向股東說明營運績效及回覆相關問題，並於會後公告逐項議案之詳細表決資訊。 2.於 2025Q4 舉辦法人說明會。 3.對外應公告或揭露之訊息，均已依規定申報，中英文重大訊息公告共 65 則。 4. 2025/8 月發布中文版永續報告書。 5.對外股東溝通之管道皆已透過郵件或電話立即回覆。
供應商	1.供應商勞雇關係 2.社會相關法規 3.無歧視、反貪污 4.環境法規遵循	1.定期查核及協助供應商提升品質 2.進行各項定期檢討報告或會議，透過面對面的方式進行公司策略與目標、品質績效檢討、合作計畫進度報告、市場資訊分享等事項溝通 3.連絡窗口:品保處 李先生 supplier@ultrachip.com	1.定期進行供應商評核共 11 家。 2.2025 年將完成 13 家供應商實地稽核。 3.往來供應商簽署有害物質禁用承諾書。 4.依供應商性質定期議價。 5.每年春酒餐會邀請供應商參加，營造良好合作氣氛。
政府與主管機關	1.法律遵循 2.公司治理 3.風險管理 4.主管機關溝通	1.參加主管機關舉辦的研討會及宣導會。 2.配合主管機關監理與查核。 3.建立與主管機關聯絡之窗口 4.連絡窗口:財會行政處 王小姐 invest@ultrachip.com	1.第十一屆公司治理評鑑上櫃公司排名級距為 21% ~ 35%。 2.2025 年參加內部人股權宣導說明會、應辦事項宣導會及 IFRS 永續揭露準則宣導會。 3.收到政府/主管機關共 68 封電子公文。 4.2025 年完成櫃買中心財報實審及國稅局補充說明。

3.2 重大性分析 GRI 3-1、GRI 3-2

1. 重大永續議題鑑別

STEP 01：範疇界定

本公司遵循 AA1000 利害關係人議合標準 (AA1000 SES) 之五大基礎指標——「依賴性、相互責任、關注張力、多元觀點、影響力」進行權重加權。透過永續推動小組回收之問券，確立本公司 5 大核心利害關係人，分別為：客戶、員工、投資人、供應商、政府與主管機關。



STEP 02：衝擊建構

依據 GRI Standards 2021 準則、SASB 半導體產業標準以及國內永續揭露指標。結合半導體晶片設計業之核心營運，由母公司晶宏及集團合併子公司之各部門主管進行潛在議題盤點，初步篩選出涵蓋環境、社會、公司治理三大面向共 19 項營業活動相關之永續候選議題。



STEP 03：雙軌議題

由永續推動小組發放與回收共計 32 份專業評估問卷 (包含母公司主管 22 份、子公司主管 10 份)。問卷設計秉持雙重實質性精神，針對各項議題對外部經濟、環境及社會帶來的「實質與潛在」、「正面與負面」影響，依「發生可能性 (X 軸)」與「衝擊程度 (Y 軸)」進行 1 至 5 分的交叉評級，據此繪製永續議題衝擊矩陣圖，據以篩選出落入高實質性區間之核心主題。



STEP 04：決策核准

為確保永續策略與企業商業發展目標高度契合，最終鑑別結果呈報至最高治理階層。本公司為保持永續方針的動態彈性及參考同業動態調整，定期審視議題之增減。本年度經董事長核定後，重大議題由 2024 年之 4 項擴充與深化調整為 7 項。詳細變動情形與背景邏輯請參閱下表之差異分析：本年度之重大議題矩陣及變更調整，已正式呈報董事長核准通過，作為 2025 年永續報告書的核心揭露主軸，並由永續發展委員會針對各重大主題擬定對應之方針與績效指標。

2.重大永續議題篩選

參考國內外永續報告並依據全球永續揭露規範，晶宏集團彙總出 19 項相關永續議題(如下表)並製作成調查問卷，同時加入可能之利害關係人進行問卷勾選調查，以了解重要利害關係人對於本公司推動各項永續議題的關注程度。

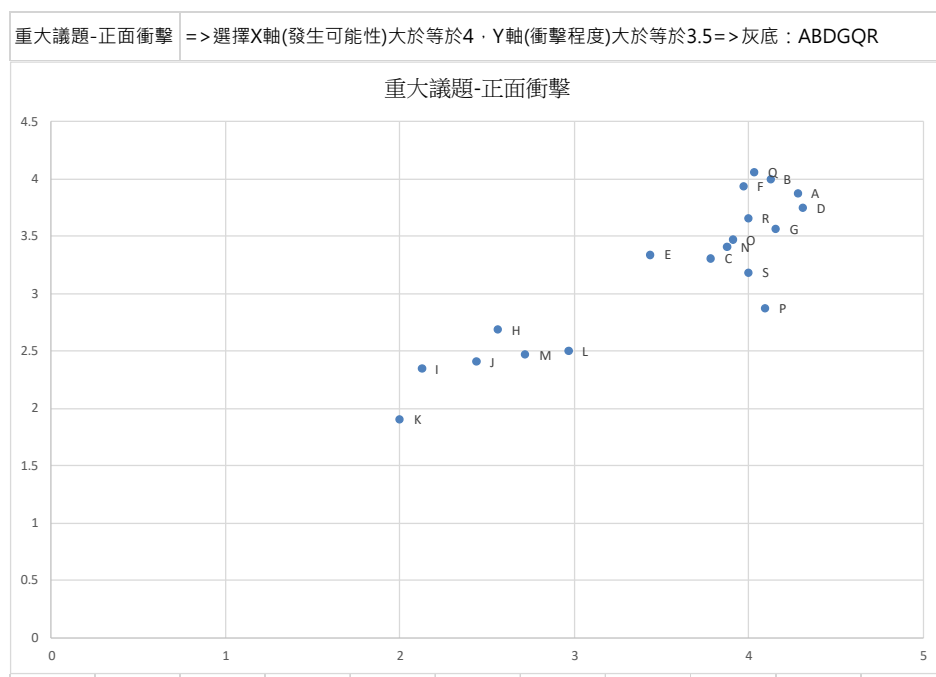
各永續重大議題可歸類為環境保護、社會責任、公司治理三大面向下，每個面向各自展開子議題，每個議題以 A~S 為編號代表，並利用圖表清楚呈現結果。

代碼	ESG 面向分類	永續議題
A	G 治理	誠信治理
B	G 治理	經營績效
C	G 治理	風險管理
D	G 治理	資安與隱私管理
E	E 環境	產品創新及研發
F	E 環境	產品品質與安全
G	E 環境	供應鏈管理
H	E 環境	氣候策略
I	E 環境	能源管理
J	E 環境	溫室氣體管理及減碳
K	E 環境	水資源管理
L	E 環境	廢棄物管理
M	E 環境	循環經濟
N	E 環境	客戶關係管理
O	S 社會	勞雇關係
P	S 社會	職場健康安全
Q	S 社會	人才吸引與員工福利
R	S 社會	人才培育
S	S 社會	人權保護

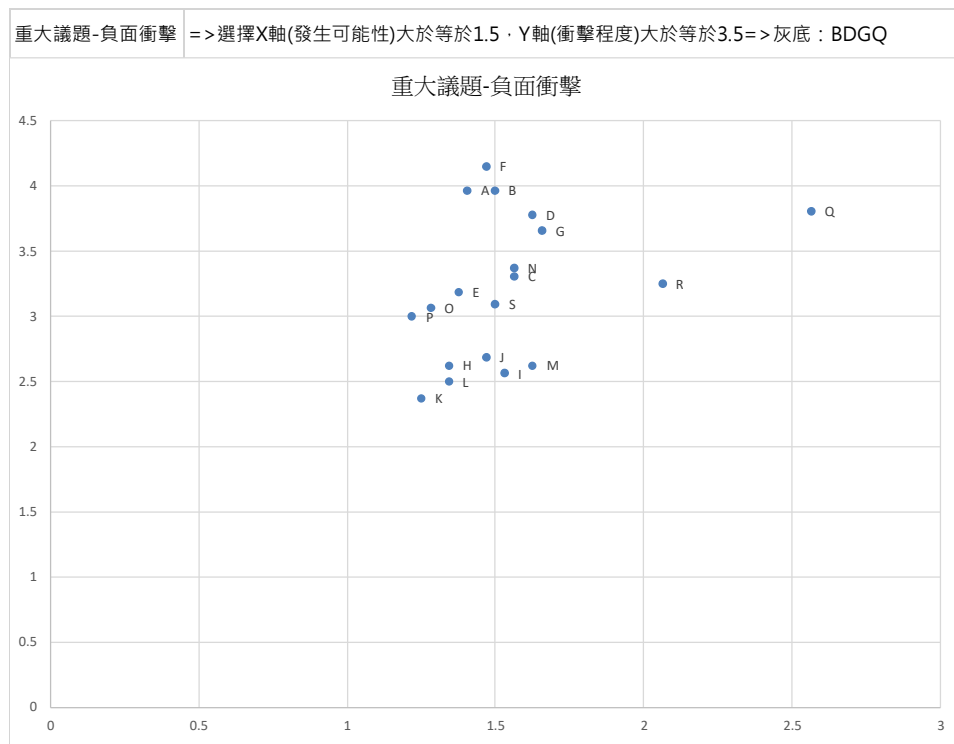
我們以 X 軸為「發生可能性」; Y 軸為「衝擊程度」進行調查，最終總計回收 32 份評估問卷，包含母公司晶宏主管 22 份及集團合併子公司 10 份，加總各項目後平均，並將各永續議題之「發生可能性」與「衝擊程度」做趨勢分布圖。

3.矩陣圖

依據回收問卷各項目之加總平均計算結果，將正面衝擊中發生可能性大於等於 4，且正面衝擊中衝擊程度大於等於 3.5，納入正面衝擊之重大議題。



負面衝擊中發生可能性大於等於 1.5，且負面衝擊中衝擊程度大於等於 3.5，納入負面衝擊之重大議題。



正面衝擊與負面衝擊都是灰底-->選出的重大議題				正面衝擊		負面衝擊	
篩選出 重大主	代碼	ESG面向分類	永續議題	發生 可能性X	衝擊 程度Y	發生 可能性X	衝擊 程度Y
	A	G治理	誠信治理	4.2813	3.875	1.40625	3.969
V	B	G治理	經營績效	4.125	4	1.5	3.969
	C	G治理	風險管理	3.7813	3.313	1.5625	3.313
V	D	G治理	資安與隱私管理	4.3125	3.75	1.625	3.781
	E	E環境	產品創新及研發	3.4375	3.344	1.375	3.188
	F	E環境	產品品質與安全	3.9688	3.938	1.46875	4.156
V	G	E環境	供應鏈管理	4.1563	3.563	1.65625	3.656
	H	E環境	氣候策略	2.5625	2.688	1.34375	2.625
	I	E環境	能源管理	2.125	2.344	1.53125	2.563
	J	E環境	溫室氣體管理及減碳	2.4375	2.406	1.46875	2.688
	K	E環境	水資源管理	2	1.906	1.25	2.375
	L	E環境	廢棄物管理	2.9688	2.5	1.34375	2.5
	M	E環境	循環經濟	2.7188	2.469	1.625	2.625
	N	E環境	客戶關係管理	3.875	3.406	1.5625	3.375
	O	S社會	勞雇關係	3.9063	3.469	1.28125	3.063
	P	S社會	職場健康安全	4.0938	2.875	1.21875	3
V	Q	S社會	人才吸引與員工福利	4.0313	4.063	2.5625	3.813
	R	S社會	人才培育	4	3.656	2.0625	3.25
	S	S社會	人權保護	4	3.188	1.5	3.094

正面衝擊之重大議題與負面衝擊之重大議題同時皆達到上述之標準之項目則納入公司重大議題。本公司透過 32 份內部關鍵主管問卷，嚴謹評估 19 項永續候選議題在「發生可能性」與「衝擊程度」上，對外部經濟、環境、社會及人群（含人權）所造成的實際或潛在、正面或負面影響，最終鑑別結果確定為「經營績效」、「資安與隱私管理」、「供應鏈管理」、「人才吸引與員工福利」4 項為 2024 年度重大議題。2025 年度晶宏集團審慎評估外部 ESG 趨勢與市場期許，反過來對企業自身財務狀況、獲利能力及營運韌性所帶來的風險與機會。經最高治理階層（董事長）核定新增之「誠信治理」、「產品創新及研發」、「客戶關係管理」三項重大主題，並將人才吸引與員工福利調整為「人才培育」，共 7 項列為 2025 年度重大議題。以彰顯公司本公司在半導體價值鏈中的綠色技術競爭力、客戶黏著度與法令合規風險，以保障股東價值與長期經營績效之關鍵。

展望未來，本公司將持續深化雙重重大性的量化評估機制，逐步轉型並建構完整的雙軌矩陣分析，以更高規格的資訊揭露回應投資機構、國際客戶與各界利害關係人的期許。

3.3 重大主題鑑別 GRI 3-2

重大議題對應 GRI / SASB 標準與價值鏈衝擊

GRI Standards 為國際主要之永續資訊揭露標準，根據 GRI Standards 鑑別出之重大永續議題也要與 SASB 進行對應，以作為永續推動依據，以回應利害關係人、投資機構之關注，以及金管會公司治理政策。本公司因應近年來國際「淨零碳排」趨勢的加速推進、客戶對於綠色研發的要求，以及才市場的結構性轉變，永續推動小組沿用 2024 年 4 大核心重大議題，進行了雙重重大性分析，以確定 2025 年 7 項重大議題。逐一對接國際通用之 GRI 主題準則與 SASB 半導體指標，並嚴格定義其於價值鏈（上游供應商、晶宏集團、下游客戶）之實質衝擊邊界，確保資訊揭露之完整性。

重大永續議題變化與對應 GRI 準則/SASB 標準/聯合國永續發展目標（SDGs）

較前一年 度變化	2025 年度 重大主題	GRI 準則主題	SASB 揭露指標 / 半導體規範	聯合國永續發展目標 （SDGs）與核心內涵	價值鏈實質 衝擊邊界
未異動	經營績效	GRI 201 經濟績效	TC-SC-000.A 產能與營運規模	SDG 8 尊嚴勞動與經濟成長（提升企業營運效益，促進穩定且永續的經濟成長）	上游供應商、本公司、下游客戶
	資安與隱私管理	GRI 418-1 客戶隱私	TC-SC-230a.1 資料安全	SDG 16 和平正義與有力制度（強化資訊安全與隱私防護，建構透明且可信賴的治理制度）	本公司、下游客戶
	供應鏈管理	GRI 204 採購實務/ GRI 308 供應商環境評估/ GRI 414 供應商社會評估	TC-SC-440a.1 供應鏈溫室氣體 TC-SC-150a.1 關鍵材料採購風險	SDG 12 責任消費與生產（推動綠色採購，落實供應商在地化與永續風險稽核）	上游供應商、本公司
新列入	誠信治理	GRI 205 反貪腐/ GRI 206 反競爭行為	TC-SC-510a.1 業務倫理	SDG 16 和平正義與有力制度（落實反貪腐、誠信守法，杜絕不公平競爭）	本公司
	產品創新及研發	GRI 302 能源/ GRI 416 客戶	TC-SC-410a.1 產品生命週期能	SDG 9 產業創新與基礎設施（研發低功耗、綠	本公司、下游客戶

		健康與安全	源效率	色環保晶片，提升技術領先優勢) SDG 12 責任消費與生產 (提升產品生命週期的能源效率)	
	客戶關係管理	GRI 2-29 利害關係人議合	半導體供應鏈客戶滿意度核心架構	SDG 8 尊嚴勞動與經濟成長 (透過深耕客戶夥伴關係，確保供應鏈黏著度與永續獲利能力)	本公司、下游客戶
	人才培育	GRI 401 勞僱關係/GRI 404 訓練與教育/GRI 405 員工多元化與平等機會	TC-SC-330a.1 招募與留才機制	SDG 4 優質教育 (提供完善的員工職涯培訓與跨領域技能發展) SDG 8 尊嚴勞動與經濟成長 (建構多元平等、安全友善的職場生態)	本公司

3.4 重大主題管理方針 GRI 3-3

本公司依照各項重大主題的衝擊性質，制定對應的政策與管理行動，由專責單位負責追縱執行之有效性，並定期檢視目標達成率。經辨別產生之重大主題，其管理措施將於後續各章節說明之。

4 夥伴共榮

4.1 產品品質 GRI 416-1、GRI 416-2

1.品質政策

晶宏集團深知卓越的產品品質是贏得市場信賴的基石。我們建立並維持完善的品質管理體系，全面通過 ISO 9001 品質管理系統認證，並積極落實 PDCA (規劃-實施-檢查-行動) 的持續改善精神，致力於超越客戶的期望與產品規格。透過內部組織的嚴密把關與外部供應鏈的緊密協同，本公司持續提升晶片產品的可靠度，以最具競爭力的成本與極致品質，達成最高的客戶滿意度。截至 2025 年度，晶宏集團未發生任何違反有關產品與服務之健康和安法法規的重大事件。

核心品質政策-以最具競爭力的成本與極致品質，達成最高的客戶滿意度。

(1)品質系統

ISO 系統與稽核/管理審查與持續改善/綠色環境物質管控/法規確認與教育訓練/客戶稽核。

(2)品質工程及量產管理

產品品質與信賴性驗證/量產監控與異動管理/品質異常分析/客戶服務與訴願處理。

(3)封裝整合工程

封裝技術評估與開發/外包供應商生產品質管理/儀器設備與治具校正/供應鏈稽核。

本公司為強化全員品質意識，每年度針對品保、工程等相關同仁，開辦涵蓋 ISO 9001、車載品質系統 (IATF 16949)、國際綠色法規 (RoHS/REACH) 等專業課程。2025 年度全公司與產品品質及服務品質相關之教育訓練總時數達 138 小時，總計投入訓練經費達新台幣 24 仟元，透過持續的學習，確保同仁具備高標準的品質控管與知識。

2.生命週期管理

晶宏集團致力於提供兼具高效能與成本優勢的晶片解決方案。為了精準掌控高複雜度的研發專案，我們建立了嚴謹的「產品生命週期」，將產品定義、晶片設計、晶圓驗證及晶圓量產等關鍵點，納入系統化的專案追蹤。透過彈性的資源調配與跨部門協作，我們在確保智慧財產權與研發成本的最佳平衡下，實現專案如期交付並極大化客戶滿意度。

SASB 指標編號	指標項目	2023 年	2024 年	2025 年
TC-SC-410a.1	含有 IEC 62474 應申報物質之產品收入百分比	0	0	0
TC-SC-410a.2	(1)伺服器、(2)桌上型電腦，及(3)筆記型電腦	晶宏集團之產品未應用於商用主機與個人電腦，因此不適用本揭露指標。		

	於系統層級之處理器能源效率	
--	---------------	--

產品開發管理系統中所累積的專業技術、專利配置與研發經驗，為本公司最核心的無形資產。為保障利害關係人與客戶的商業秘密，本公司訂有嚴格的內部資訊安全管理規範與實體存取權限控管，並定期對員工實施智慧財產保護與資安意識宣導，確保所有研發專案資訊在生命週期各階段皆受到妥善保護。

本公司的 IC 研發與專案管理程序包含以下四大關鍵階段：

【產品定義】——→【核心設計】——→【晶圓驗證】——→【產品量產】

(1)產品定義

市場動態訂定產品規格/精準掌握客戶痛點/技術趨勢與專利檢索/規格收斂與可行性評估

(2)晶片設計

設計品質與時程控管/電路設計與系統模擬/資源配置與審查/可製造性與綠色設計

(3)晶圓驗證

工程測試與信賴性/系統應用與相容性測試/引導客戶導入與承認/

(4)產品量產

供應鏈營運與產品競爭力/良率提升與製程優化/品質控管與產能落實/技術維護與升級

4.2 客戶關係管理 GRI 2-6、GRI 418

在晶宏集團，我們深信卓越的客戶服務，源自於對客戶成功的深度承諾。我們超越傳統的買賣關係，致力於成為您最值得信賴的「策略創新夥伴」。晶宏集團始終堅持“以客戶為中心”作為長期發展戰略，並通過負責任的、可持續的方式管理與客戶的互動，從而共同創造長期價值。對晶宏來說，客戶不只是客戶，是我們一起打拼的夥伴！

為了隨時掌握客戶需求，從產品設計到生產階段，我們除了透過定期會議與年度滿意度調查保持緊密聯繫外，更重視將客戶的每一個意見進行深度分析，轉化為具體的改善計畫。因為我們的目標只有一個：與客戶攜手成功，共創雙贏。我們堅信，持久且互信的客戶關係是公司永續經營的基石，與客戶攜手應對環境與社會挑戰，共同邁向可持續的未來。

1.客戶服務與溝通

晶宏集團扮演的角色不僅是供應商，更是客戶永續轉型路上的共創夥伴。我們提供「客製化效能優化」與「系統級整合諮詢」，確保我們的解決方案不僅符合規格，更能為您的終端產品

帶來差異化的市場優勢。

本公司與客戶建立了多元且結構化的溝通渠道：

- (1)常態溝通機制：日常會議、郵件、每月拜訪、季度業務檢討，確保資訊即時同步。
- (2)策略性調查：每年針對銷售服務、技術支援、客服品質、產品表現四大核心構面進行滿意度調查，量化追蹤績效表現。
- (3)暢通申訴機制：建立系統化客訴程序，涵蓋產品品質、包裝、運送至使用過程，確保任何疑慮都能透過專責窗口獲得即時回應。

為滿足客戶、投資機構等外部利害關係人的 ESG 需求，我們不僅積極配合填寫客戶的永續問卷，協同各權責單位回應提問，更進一步將企業社會責任視為開拓新市場可能性的契機，與客戶實現真正的價值共創。我們致力於：

- 減碳目標規劃：配合客戶達成減碳目標，提供技術支援與解決方案，共同邁向淨零排放的願景。
- ISO14064-1 導入：配合客戶進行溫室氣體盤查，訂定晶宏集團減碳目標，以提升整體供應鏈的永續競爭力。
- CSR 商機開發：敏銳捕捉客戶在永續轉型中的需求與潛在風險，將企業社會責任轉化為共同的市場優勢。

2.客戶滿意度調查

我們深信，客戶的聲音是引領我們前進最寶貴的指南針。為此，晶宏建立了一套從「傾聽」到「行動」的完整流程，承諾將您的每一個回饋，都化為我們共同成長的動力。

晶宏於每年第一季針對各產品之前十大客戶發放「客戶滿意度調查表」。回收後由產銷規畫單位進行專業分析，再由相關權責單位針對不滿意項目提出具體改善措施，並於年度管理審查會議中檢討，確保持續提升客戶滿意度。

客戶滿意度調查不僅使我們聚焦於解決當下問題，更將客戶回饋深化為策略合作的橋樑：

- (1)深度解析驅動產品精進：(2024 年實績) 2025 年度我們的整體客戶滿意度評分達到 93.5%，超越原定 85%的目標，尤其在「產品市場導入」與「技術支援速度」項目獲得高度評價。我們並未止步於高分，而是進一步深度分析高滿意度背後的驅動因素，將其固化為我們的標準服務流程。
- (2)根本原因分析達成服務優化：我們維持了客戶回饋案件 100%的改善結案率。對於每一個反饋案件，我們不僅解決表面問題，更執行根本原因分析，從設計端、製程端或服務流程

端進行矯正與預防。同時，我們將客訴分析結果轉化為內部培訓教材，提前化解潛在問題，降低雙方的溝通成本。

- (3)從滿意度調查延伸至聯合開發 我們將調查中發現的客戶潛在需求，轉化為聯合開發的契機。邀請關鍵客戶與我們的產品、研發團隊共同腦力激盪，將客戶現有的「痛點」，直接轉化為下一代產品創新的亮點。
- (4)預警式的服務升級 透過分析客訴數據與趨勢，我們能預測客戶未來可能面臨的挑戰，並主動提供解決方案或升級服務。例如，我們曾觀察到特定使用模式後，主動為客戶更新產品規格書並提供培訓，防患於未然，贏得了客戶極大的信任。

對我們而言，客戶滿意度調查不僅是績效考核的指標，更是驅動組織學習、強化夥伴關係的戰略核心。我們承諾持續聆聽、敏捷改善，並與客戶攜手，將每一個回饋都轉化為共創卓越未來的寶貴機會。

3.客訴處理與回饋

在晶宏集團，我們深信客戶的每一則回饋，都是驅動我們持續精進的關鍵動能。我們致力於緊密與客戶互動，高度重視每一份回饋意見並持續關注客戶需求，視客訴處理為強化夥伴關係、共創未來價值的戰略契機。

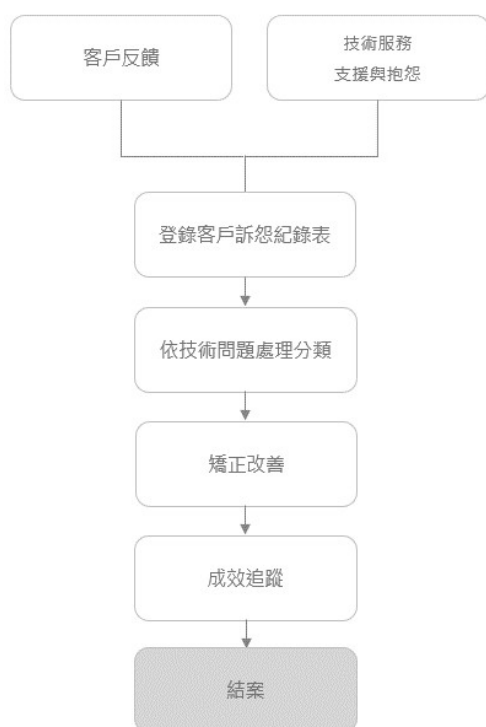
為落實積極的服務態度並滿足客戶技術支援需求，晶宏集團建立了完善的「客戶抱怨處理程序」，透過客戶技術支援窗口密切了解客戶問題/需求，整合所有技術支援及抱怨處理資訊，確保服務的即時性與透明度：

- (1)建立當責溝通體系：我們提供多元且即時的反映窗口，負責協調問題並進行初步資料收集。針對異常案件，先分析問題屬性，若需進階分析，則由各事業部(BU)窗口將產品關鍵資訊登錄於 CCA 系統。
- (2)深化根因分析：各 BU 窗口填寫 FA 委託單，由相關技術單位進行深度根源分析。針對重要案件，我們落實專案負責人制度，確保問題核心被徹底理解並追蹤至完善解決。
- (3)嚴謹的進度監控與回饋：品保單位扮演監控核心，每週定期檢視所有案件的處理進度，以期在最短時間內解決客戶問題，並每月統計匯報客訴案件，確保管理層掌握品質動態。我們不僅止於解決當下的問題，更致力於將挑戰轉化為成長的養分，以從源頭預防並與客戶價值共創：

- 深化前瞻預防：工程團隊將分析結果系統性地回饋至研發設計與製程端透過推動「製程前移」管理與「設計防呆」機制，從源頭降低風險，避免抱怨再次發生，與客戶共同建構穩健的供應鏈。
- 驅動產品演進：2025 年我們成功將數項關鍵客戶的實務建議，轉化為具體產品躍進升級。這不僅解決了客戶痛點，更全面提升了後續產品線的可靠性與效能。

- 實現 100%結案率：對晶宏而言，「結案」不是服務的終點，而是效能提升與信任深化的新起點。我們持續將改善成果量化並與客戶分享，確保每一次進步都能直接轉化為客戶在市場上的競爭優勢。針對確認有品質異常之瑕疵產品或未達預期之服務，會依據合約與品質承諾提供完善的補救措施，包括啟動退換貨流程、重新安排補足良品、進行現地/遠端技術調校補救，並將改善成果量化主動與客戶分享。2025 年度所有客訴案件皆透過上述機制獲得妥善解決，實質結案率達 100%，確保每一次進步都能直接轉化為客戶在市場上的競爭優勢。

客訴處理流程：



客訴處理效率：

年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度
客訴平均結案天數	4.10	3.85	3.55

4.客戶隱私與資訊安全保障 (GRI 418)

作為半導體設計領域的關鍵供應商，晶宏集團深知資訊安全與客戶隱私是信任的基石。我們嚴格遵守《個人資料保護法》及國際相關資安準則，並採取以下措施：

- (1)嚴密的資訊存取控制：針對客戶的設計圖檔、規格書及未來產品規劃等機密資訊，採取分級存取管理與加密傳輸，並定期執行資安審計。
- (2)全員資安意識培訓：每年針對全體員工及承包商進行 100% 的資安與保密協議 (NDA)

遵循培訓，確保同仁落實業務機密保護。

- (3)零違規紀錄：晶宏集團於營運過程中遵守各項業道德與客戶權益法規，2025 年度未發生任何接獲投訴關於侵犯客戶隱私或遺失客戶資料之情事，亦無任何涉及違反「產品健康與安全標示」、「客戶權益爭議」、「反壟斷或不公平競爭」之違規紀錄。我們承諾將持續優化合規與資安管理體系，全面保障客戶與消費者的智慧財產權與實質權益。

重大主題-客戶關係管理

2025 年目標	客戶滿意度問卷，滿意度達 90% 。 ESG 問卷回覆率 100% 。 客訴結案率 100% 。 無發生侵犯客戶或資訊洩露相關之情事。
核心目標	<u>短期目標</u> 客戶滿意度問卷，滿意度達 85% 。 ESG 問卷回覆率達 100% 。 持續開發新產品，滿足客戶需求 。 無發生侵犯客戶或資訊洩露相關之情事。 持續精進與客戶的永續營運發展溝通 。 配合主要客戶需求，協助客戶整合產品後勤支援體系，並提供最佳行銷服務予客戶，以贏得客戶信賴及符合客戶需求 。 <u>中長期目標</u> 客戶滿意度問卷，滿意度達 90% 。 持續提升產品市佔率及產品品質，並架構全球服務技術網 。 與客戶建立長期穩健共贏的合作關係，實現多元永續發展 。
負責單位	業務單位/行銷單位/研發單位/工程單位/品管單位
評估指標	客戶滿意度問卷。 ESG 問卷。 客訴結案。 銷售額。
行動方案	每年執行客戶滿意度調查，瞭解客戶對產品和服務的回饋與要求 。 每年針對客訴處理回覆及時。
主要利害關係人	客戶
申訴及溝通管道	請參閱「利害關係人溝通對照表」，並對應上述主要利害關係人。

4.3 永續供應鏈 GRI 2-6、GRI 308-1、GRI 414-1

1.採購實務與風險管理

晶宏集團的核心競爭力建立在高效的無晶圓廠 (Fabless) 營運模式上，我們的採購策略不僅是成本控制，更是企業永續發展的戰略支柱。關鍵供應鏈集中於提供高品質的委外代工 (Foundry)、專業封裝 (Packaging) 與精密測試 (Testing) 服務的頂尖廠商，作為核心原物料的是，100% 委託由晶圓代工廠進行製造。

在 IC 設計產業中，供應鏈風險具有高度複雜性，除了持續關注晶圓產能排擠和製程良率等傳統風險外，更將原物料來源的穩定性和外包廠商的規範遵循視為年度風險評估的重點。我們考量下列之採購風險：

- (1)市場洞察：晶宏集團除了傳統的訂單跟蹤，更具前瞻性的收集市場情報。透過相關部門每週的產銷協調會議，結合業務取得之客戶回饋、市場趨勢、全球經濟預測，以及地緣政治分析，我們得以準確判斷未來 6 至 12 個月的市場供需情勢，使我們能夠及早識別潛在的晶圓緊缺、關鍵材料交期拉長等風險。
- (2)供應源多樣性：晶宏集團實施嚴格的供應商多元化策略，我們堅決避免單一供應源的依賴，藉由積極開發新合作夥伴，並鼓勵現有供應商在不同地理位置設置生產據點，以分散因天災、疫情或區域衝突造成的營運中斷風險。
- (3)危機應變：當突發事件(如天災、缺料或晶圓廠產能限制)發生時，我們緊急應變程序包括：
 - (1)轉廠評估：迅速評估其他合格代工夥伴的產能與技術匹配度。
 - (2)策略性安全庫存：針對長交期、關鍵或高價值原物料，維持策略性的安全庫存水位，並定期根據市場波動性進行動態調整。
- (4)採購評選：晶宏集團的採購決策摒棄僅以「最低單價」為導向的做法，轉而採用總體擁有成本的理念。供應商的評選框架涵蓋：品質可靠性、技術支援、交貨速度與彈性、環境社會治理績效，以及長期的合作夥伴關係價值。我們尋求的供應商是能與晶宏集團共同成長，且具有永續發展理念的長期夥伴。

2.在地採購與供應鏈韌性

晶宏集團為了提升採購效率，實踐環境保護與社會責任的具體行動，將在地採購視為實現企業永續發展目標的關鍵戰略。

- (1)環境影響最小化：透過優先採購在地供應商的服務與物料，我們才得以大幅縮短運輸距離。這直接減少了產品生命週期中的運輸碳里程與相關的溫室氣體排放，是我們承諾氣候變遷行動的重要一環。
- (2)營運效率風險：縮短的運輸距離意味著更快的交期和更強的供貨彈性。在全球供應鏈面臨

不確定性的背景下，在地採購能有效分散國際物流中斷、關稅壁壘或地緣政治風險，顯著提升晶宏的營運韌性和供貨穩定度。

(3)社會在地共榮：在地採購直接支持了當地經濟體系的發展，創造了就業機會，並強化了晶宏與所在營運地區社群的連結。我們致力於成為一個負責任的在地企業，與社會環境共同繁榮。

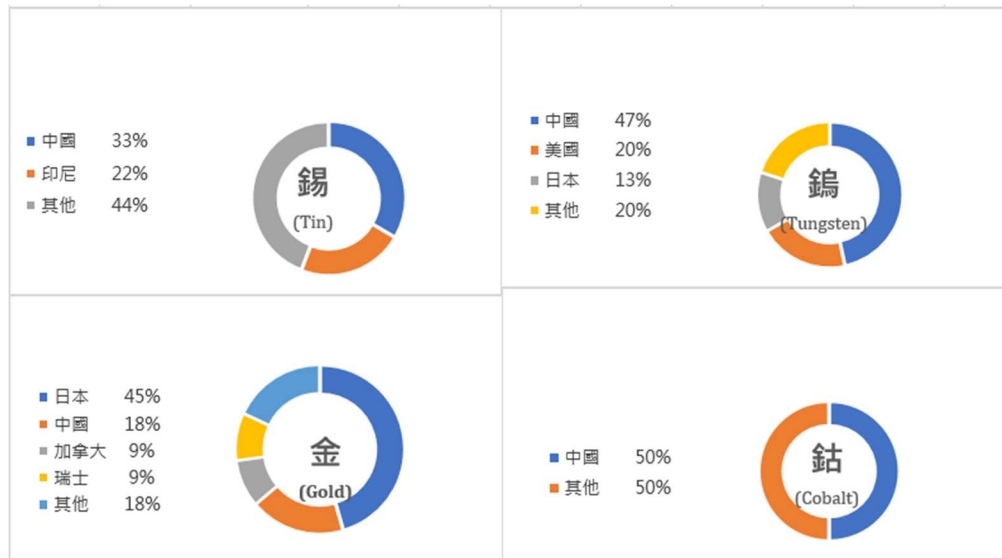
2025 年，晶宏集團持續優化採購策略，以應對全球供應鏈「去全球化」的趨勢，並取得了穩定的在地採購表現，晶宏原料進貨供應商的在地採購比例約為 40%。儘管部分高度專業化的關鍵原物料仍須仰賴國際供應鏈，但我們將持續研究和開發具有潛力的在地供應商。我們的目標是持續在符合品質要求的前提下，穩步提升在地採購比例，以優化我們的供應鏈結構，降低環境足跡。

3.責任礦產採購

晶宏集團將責任採購提升至公司治理層次，以確保我們的供應鏈不僅合法，更具道德性。我們承諾絕不採購來自剛果民主共和國及其鄰近受衝突影響和高風險區域的衝突礦物(3TG:金、錫、鉭、鎢)，並將持續關注鈷等新興責任礦產。我們嚴格遵循 RBA 行為準則、OECD《受衝突影響和高風險區域礦產供應鏈的盡職調查指引》等國際規範，以維護供應鏈透明度與尊重人權。

晶宏集團要求所有涉及關鍵物料的生產相關供應商填寫 RMI_CMRT，系統性蒐集 3TG 使用與冶煉廠資訊，並有效管理衝突礦產風險。2025 年度所有往來供應商皆 100% 完成，展現了供應鏈對此政策的高度認同與配合。

我們運用國際責任礦產倡議組織 RMI 建立的衝突礦產報告模板 CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) 與 EMRT(Extended Minerals Reporting Template)作為主要的數據收集工具，要求供應商逐層追溯產品中的 3TG 和鈷等金屬來源。我們要求供應商提供完整的礦源地、供應鏈流向及冶煉廠名稱。針對收集到的冶煉廠清單將與 RMI 合格冶煉廠名單 (Conformant Smelters List) 進行嚴格比對。只有來源於 RMI 認證冶煉廠的金屬，才被視為符合晶宏的採購標準。對於任何未經認證或位於高風險地區的潛在冶煉廠，我們將立即啟動風險調查與矯正程序。我們持續監控 RMI 等國際組織發布的最新衝突礦產資訊與高風險區域變動，確保政策與時俱進。我們的目標是建立一個具有高度韌性和道德標準的供應鏈，確保我們的產品不會間接資助非法武裝或侵犯人權的活動。



若發現不合規的冶煉廠，我們將要求供應商在限定時間內替換來源。若供應商無法在期限內完成整改，晶宏將根據供應商管理政策（請參閱「供應商評鑑與輔導」章節）採取限制或終止合作等措施。

4. 供應商永續管理

晶宏集團深知，建立一個具備韌性且符合道德規範的供應鏈，是維持企業競爭力與實踐永續承諾的關鍵。我們制定並嚴格執行「供應商管理程序」，從源頭篩選、持續性評鑑到合作夥伴輔導，建構出完整的供應鏈管理迴圈（PDCA）。我們不僅關注供應商的技術與品質，更將環境保護（Environment）、社會責任（Social）及公司治理（Governance）績效納入核心評估標準。

(1) 新供應商導入

為確保供應鏈素質，晶宏集團對於新供應商的導入採取「源頭嚴格把關」策略。新供應商必須通過多階段的資格審查與實地評鑑，方能進入我們的合格供應商名單。

● 稽核小組：由品保單位召集工程部門等跨單位組成稽核小組，針對潛在供應商的工程能力、品質系統、綠色產品管理及社會責任進行全方位審核。

● 永續與品質門檻：所有新進 100% 之供應商皆須通過環境與社會標準，包括國際管理系統認證：包含 ISO9001 品質管理系統證書、車載產品供應商需具備 IATF 16949 汽車業品質管理系統證書。產品必須符合國際綠色法規，包含符合歐盟 RoHS、REACH SVHC、無鹵（HF）、持久性有機汙染物 POPs 等，以及簽署晶宏「不使用禁限用物質聲明書」，承諾產品符合環境有害物質法規管制。

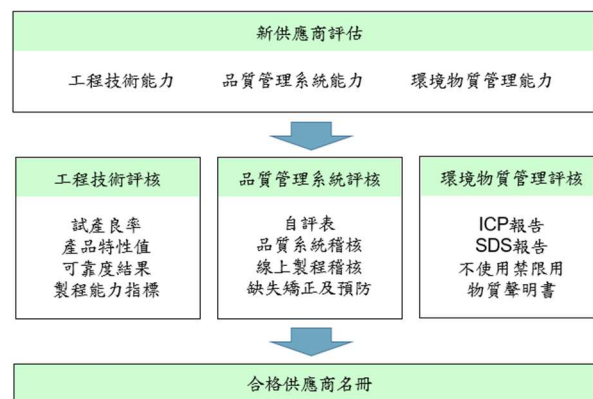
2025年度晶宏半導體重要供應商取得認證以及符合環境物質法規統計如下

	項目	取得認證/符合規範比例
品質管理	ISO 9001 品質管理系統	100%
	IATF 16494 汽車品質管理系統	100%
環境物質管理	ROHS / REACH / HF / POPs	100%

●工程技術能力評核：製程資格驗證階段需提交工程驗證報告，包含良率、製程能力指標及可靠度驗證報告。唯有在工程技術能力評核、品質系統與環境物質管理能力評核完成，符合標準後，方能正式登錄為合格供應商。

新供應商評鑑項目

- ◆ 通過ISO9001、IATF 16949或其他國際系統認證合格。
- ◆ 符合歐盟 RoHS、REACH SVHC、HF、POPs等，國際綠色法規。



(2)合格供應商評鑑

針對已登錄的合格供應商，晶宏集團依據「供應商管理程序」實施動態的分級管理制度，透過「季度或半年度考核」與「年度稽核」雙軌並行，確保合作夥伴持續符合我們的營運與永續標準。

●季度績效評鑑：由公司內部品保/生管/工程人員，針對已達到產量標準之供應商，進行季度評分，依其品質、技術能力、價格、交期、生產服務等項目給予評分，對於評比分數不符晶宏要求之供應商，要求供應商進行改善以符合公司要求，也會依其改善結果進行確認，以確保產品品質穩定性，並作為調整加工配額的重要依據。評鑑結果將直接連結至採購策略，表現優異者將獲得優先合作機會，若評分結果不好者(即 C 等級以下)，要提書面改善計畫，定期追蹤。

●年度永續與品質系統稽核：我們每年依據當年度產量達標準之生產相關供應商，執行年度稽核計畫。稽核範疇參考 RBA 行為準則與 ISO 標準，共計涵蓋 11 大要項大致區分為下列三大面向，深入檢視供應商的營運體質：

品質與工程面：設計管制、製程參數監控、設備保養、供應商管理、變更管理(ECN/PCN)

及矯正預防措施。

環境與職安面：污染防治設備運作、廢棄物合法清運、化學品管理。

社會責任面：檢視是否落實禁用童工、禁止強迫勞動、提供人道待遇及符合法規的工時與薪資福利。

●彈性稽核機制：考量當年度採購情形及相關地緣政治風險或不可抗力因素，部份供應商採實地稽核，其餘供應商須進行詳盡的供應商自評表，經晶宏評鑑小組審查後核定結果，確保供應鏈持續監控。2025 年針對生產相關之重要供應商及高風險供應商共計 38 家，實地稽核供應商有 18 家，書面稽核 20 家，實際達成率為 100%。所有廠商稽核結果皆為合格，沒有任一供應商列為不合格名單。稽核過程中發現的建議改善事項主要集中於文件管理與細部製程參數優化，所有缺失皆已要求供應商於規定期限內完成改善，改善完成率達 100%。2025 年度供應鏈中未發現任何具重大環境汙染、聘用童工或強迫勞動之情形，亦沒有涉及 ESG 之相關爭議。

稽核頻率

項目		晶宏
晶圓類供應商	年度稽核	◎
	季度評鑑	◎
委外加工供應商	年度稽核	◎

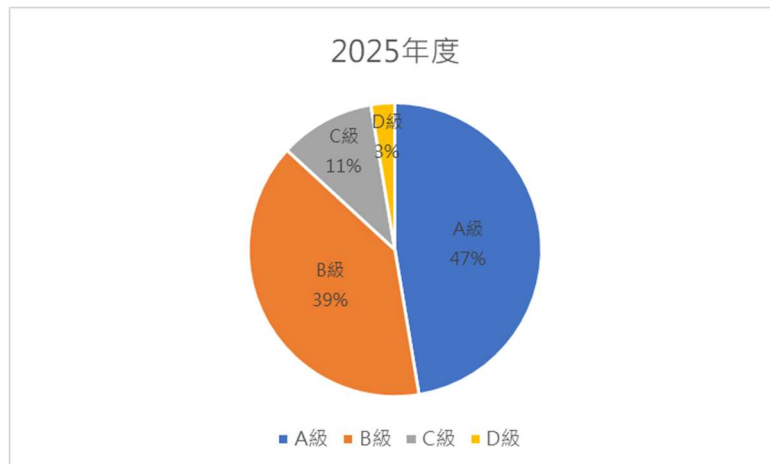
評鑑項目及評鑑比重

頻率	評鑑項目	評鑑比重
季度	Quality control	35%
	Engineering	30%
	Production plan	35%
年度	品質系統稽核	100%

(3) 供應商管理與輔導

晶宏集團秉持「共存共榮」的理念，積極制定並落實綠色供應鏈管理政策。我們不僅扮演稽核者的角色，更是供應商的輔導者。在引進新合作夥伴時，晶宏將供應商的環境管理表現納入評估考量，確保源頭管理；對於現有供應商，我們則透過每年度的永續與品質系統稽核，定期追蹤其環境管理作為。

●分級處置原則：經評鑑小組審核，2025 年 18 家供應商評等為 A 級，15 家為 B 級、4 家為 C 級、1 家為 D 級，所有受稽核廠商皆符合合格標準，並無列為不合格或除名之供應商。



A 級(Excellent)：列為優先策略合作夥伴，並可適度簡化下年度稽核頻率。

B 級(Good)：保持密切合作，並持續定期監控品質。

C 級 (Normal)：維持正常合作，但須針對弱項提出改善計畫，必要時安排不定期抽查。

D 級 (Bad)：維持正常合作，但須針對弱項提出改善計畫，必要時安排不定期抽查。

●輔導與溝通機制：晶宏集團對供應商雖未有實體教育訓練，但我們將對合作夥伴的「教育與輔導」內化於日常中。我們定期召開供應商會議及品質檢討會議，與供應商共同探討製程瓶頸、良率提升方案及最新國際法規趨勢(如淨零碳排要求)。對於評鑑發現的缺失，工程與品保團隊會主動介入，協助供應商進行根因分析改善措施的有效性與防呆機制的落實。析，確保

●退場機制：若供應商在接受輔導後，經重新驗證仍無法達到合格標準，或發生重大違反誠信廉潔、嚴重汙染環境及侵犯人權之情事，晶宏將其從合格供應商名單中除名，並尋求替代供應商，以捍衛晶宏的永續價值與客戶權益。

●未來展望與持續改善：奠基於現有的輔導成效，晶宏未來將持續加強供應鏈環境管理成效之揭露。除維持上述之質性輔導案例外，我們亦規劃逐步導入更具體的量化指標(如：關鍵供應商之減碳達成率、綠色採購成效等)，以利利害關係人更全面地評估晶宏綠色供應鏈的實質影響力。

針對評鑑等級較低之供應商，晶宏品質單位提供供應商評鑑結果中待加強項目進行溝通，更於次年度追蹤改善情形，供應商往往可透過此程序成功提升評等級別，展現晶宏與供應商攜手成長的實質管理成效。

重大主題-供應鏈管理

2025年目標	使用之礦物原料100%採用RMI認可的冶煉廠。 完成供應商ESG問卷自評表。
核心目標	<u>短期</u> ： ● 確認供應商符合衝突礦產冶煉廠。 ● 追蹤關鍵供應商符合ESG管理標準。 ● 持續定期執行供應商評比。 <u>中期</u> ： ● 定期取得供應商衝突礦產冶煉廠清單。 ● 配合上下游供應商之溫室氣體盤查，並導入14064-1溫室氣體盤查。 ● 參考RBA行為準則，落實供應商 ESG 評估及供應商調查，持續追蹤

	供應鏈永續發展績效。 ● 協同關鍵供應商完成溫室氣體盤查、碳足跡等碳管理專案。 ● 深化區域性策略合作，持續提昇區域性地採購，減緩物料運輸產生的碳排放，降低環境衝擊。
負責單位	生產管理及品質單位。
評估指標	透過定期之供應商評鑑及執行供應商實地稽核，了解供應商之品質、製程、環境、社會企業責任。
行動方案	依據國際標準與客戶規範，制定「環境有害物質管理規範」，並透過文件溝通、評鑑與稽核，由相關部門推動供應商環境物質管理，落實產品符合綠色環保。
投入資源	● 全面簽署不使用禁限用物質聲明書。 ● 新供應商需簽署不使用禁限用物質聲明書。 ● 供應商ESG問卷自評。
申訴及溝通管道	生產管理及品質部門。 舉報信箱。

4.4 創新管理 GRI 3-3

晶宏集團為全球中小尺寸顯示器驅動晶片、特別是電子紙 (E-paper) 顯示驅動晶片的技術領導者。晶宏長期深耕超低功耗、高整合度的晶片設計與銷售，核心產品全面涵蓋新零售 (電子貨架標籤 ESL)、智慧物流、醫療照護、穿戴裝置、工控儀表及智慧家居等多元物聯網(AIoT) 應用領域。

我們以「極致省電、無紙化綠色科技」為核心訴求，深入跨產業客戶群。晶宏不僅重視內部研發技能的累積，更積極掌握全球減碳與智慧化動向，提早部署關鍵技術，率先推出具備高抗干擾、雙穩態驅動 (Bistable Drive) 與多色系 (如四色、五色) 電子紙驅動之差異化解決方案，敏銳滿足全球消費性與商用電子市場的永續趨勢。

此外，晶宏集團重視跨領域的技術縱深與產品線橫向延伸，除了顯示驅動晶片外，亦布局至馬達驅動控制晶片 (Motor Driver IC)、前瞻功率元件驅動 (GaN Pre-driver)、光學感測元件 (Optical Sensors) 及微顯示矽基板 (Micro-display CMOS Backplane)，建構出龐大且分散風險的多元產品生態系。

1.研發創新與投入

為創造公司長期成長動能並維持全球技術領先地位，晶宏持續投入關鍵製程與電路設計研發，

推動各類產品跨入高附加價值的新興領域。

(1)近期開發之新產品與技術

新世代多色超高解析度電子紙驅動晶片：支援四色以上（黑/白/紅/黃/橘）之色彩，提升零售與廣告看板之視覺豐富度與永續無紙化效益。

物聯網低功耗無線感測整合型顯示晶片：將 RF(UHF)（低功耗藍牙）或 NFC 與電子紙驅動晶片高度整合，專攻智慧物流標籤與無電池智慧卡。

車載與工控高耐候型電子紙驅動晶片：開發耐極端溫度（寬溫）之驅動技術，滿足戶外智慧站牌與工業倉儲之嚴苛環境需求。

醫療級超低電壓穿戴式顯示驅動系統：鎖定智慧醫院電子床頭卡、長照生理監測穿戴裝置，提供近乎零耗能的顯示解決方案。

晶宏集團歷年投入之研發費用持續將高比例營收回饋於研發投入，確保綠色科技與前瞻技術的絕對領先。

單位：新臺幣仟元

	2024 年度	2025 年度
研發費用	360,840	372,902
佔當年度營業收入比例	24%	23%

(2)近期開發成功之關鍵技術與產品

大尺寸電子紙看板高壓驅動晶片：突破大尺寸電子紙刷新速度的瓶頸，成功商品化並應用於智慧城市之電子公車站牌與戶外廣告。

防水抗干擾多合一觸控顯示整合晶片（TDDI for STN）：專為戶外及工控環境設計，具備極高的雜訊抑制能力，即使在表面有水滴覆蓋的情況下，仍能精準提供觸控反饋。

專用車規級液晶顯示驅動 IC：為車用段碼儀錶盤量身打造之高對比、大尺寸、高安全性車規晶片，已成功通過國際大廠認證並導入中、韓、印等車機大廠。

2.永續產品

晶宏集團各事業體秉持節約資源、提高能源效率、節能減碳、降低環境有害毒性、延長產品壽命以及材料資源易回收等方針，將綠色設計思維深度落實於產品生命週期的各個環節。我們透過自主技術創新，協助客戶及社會大眾在日常應用中具體實踐循環經濟與低碳轉型。

	永續貢獻與低碳技術
雙穩態低功耗技術	實現極致終端省電與無紙化轉型- 電子紙驅動晶片運用雙穩態技術，僅在畫面更新時消耗電力，移除電源後畫面仍可永久保留。大幅降低終端智慧裝置（如：ESL、電子標籤）在使用

	階段的碳排放，並全面替代傳統紙張標籤，減少樹木砍伐與廢棄物產生。
高階觸控顯示整合技術	結構微縮與製程減碳- 將顯示驅動晶片 (Driver IC) 與觸控控制晶片 (Touch IC) 整合為單一晶片，大幅減少外部元件數量、縮減電路板體積。在原物料階段即降低晶片用量，並簡化下游模組廠的組裝工序，達到製造階段的節能減壓。
高精準 FOC SMO 馬達驅控	提升能源效率與降低電磁干擾 (EMI) - 搭載自主研發之 FOC SMO (磁場導向控制滑模觀測器) 演算法與三相無霍爾弦波控制技術，大幅提升馬達運轉的電力轉換效率、解決機械振動與噪音。應用於伺服器液冷、工控馬達與白色家電，顯著改善能耗。
氮化鎵前級驅動技術	AIoT 與 AI 伺服器電源綠色轉型- 專為高頻高效應用設計之 GaN Pre-driver，與功率元件合封後能顯著降低開關損耗、大幅縮減電源模組體積與散熱需求，協助客戶打造高效能、高密度的節能綠色電源。
高訊噪比光學感測 AFE	非侵入式健康監測與長效續航- 將高訊噪比類比前端 (AFE) 與 DSP 整合至單一感測晶片，在極低待機電流下即可精準捕捉微弱生理訊號，延長穿戴裝置的使用壽命，落實綠色醫療與穿戴智慧化趨勢
嵌入式記憶體微顯示技術	空間運算極致低功耗架構- 運用 eMP (嵌入式記憶體) 與數位電流驅動技術，在 CMOS 矽基背板電路設計上實現相較傳統模擬驅動更優異的低功耗表現，大幅緩解 AR/VR 微型裝置的運作散熱壓力，優化電池續航力與產品耐用度。

4.5 智慧財產權 GRI 3-3

揭露主題：智慧財產權保護與競爭行為

(單位：新臺幣元)

SASB 指標編號	指標項目	2024 年	2025 年
TC-SC-520a.1	與反競爭行為法規有關之法律程序導致之貨幣性損失總額	0	0

晶宏集團為專業 IC 設計公司，智慧財產權 (Intellectual Property, IP) 為公司核心競爭力與邁向永續經營的重要基石。我們持續鼓勵員工創新思考、提升研發價值，並透過完善規劃的智慧財產管理政策，將研發成果轉化為實質的市場競爭力，以健全公司治理並提升整體營運績效。

1. 營業秘密管理與資訊安全

晶宏視技術關鍵與研發成果為最高機密，對內建構嚴密的資訊安全環境以管控資訊流向，對

外則落實嚴格的保密規範。2025 年度，晶宏集團未發生任何營業秘密被侵害或重大資安外洩之案件。

(1) 保密協議簽署：

- 客戶開發：洽談初期，需與客戶或供應商簽訂保密合約 (NDA)，確保合作之安全性。
- 在職員工：新進及在職員工均須簽署聘僱契約書及遵守工作規則，承諾履行營業秘密與機密資訊保密義務
- 離職員工：離職時均需簽訂離職保密合約，確保離職後不洩漏公司任何商業與技術機密。

(2) 資安監控與管理：建構資訊安全環境監控，設置研發資料權限分級管控，將研發成果集中於安全控管之資料中心，避免未授權接觸。定期舉辦員工資訊安全宣導與智慧財產權教育訓練，強化防護意識。

為進一步完善資安與智財管理，晶宏已著手檢視既有流程，評估於未來導入 ISO27001 資訊安全管理系統認證，落實資安管控。

2. 專利管理與激勵機制

晶宏積極推動專利布局，建立完善的專利全生命週期管理流程，從提案、答辯到獲權維護均由專利事務所協助，以確保研發產出之品質。

【專利管理流程】

研發創新提案 → 內部專利評審 → 依法提交申請 → 專業答辯維護 → 獲權資產運用

專利布局與維護：結合研究開發策略與市場趨勢，積極申請國內外專利。針對申請中之專利進行最適答辯；對已獲權專利則依法定期繳交專利年費，落實資產維護。

多元獎勵機制：訂定明文之「專利獎金規範」，包含「提案獎金」與「獲權獎金」，以實質制度激勵員工持續投入創新發明，協助公司累積智財資產。

重大主題-產品創新

策略目標	● 高階觸控顯示整合技術。 ● 雙穩態顯示器整合型驅動IC ● 霍爾感應器之單相馬達驅動IC及GaN (氮化鎵)驅動IC ● 超微像素間距、超高解析度、超低工耗之次世代微顯示矽基板
核心目標	<u>短期:</u> ● 全力推進零電容技術往中高解析度顯示器驅動晶片市場。 產品應用持續於物聯網 (IoT) 產品、工控 (Industrial)設備、車用智慧座艙等多元領域、維持各產品線均衡發展，降低景氣循環對公司營運與獲利的影響。 ● 在感測晶片領域上持續研發創新，提供橫跨市場低階、中階至高階的感測

	晶片產品線，滿足多元市場的需求。 <u>中長期:</u> ●持續產品分散應用並保持各產品線均衡發展。 ●持續投入研發，建立差異化技術障礙以擴大與競爭者之距離。
負責單位	研發中心
績效評估	定期檢視研發成果及時程，透過業務了解市場趨勢，調整內部資源配置。
行動方案	持續鞏固利基型市場並開發多元性產品應用，更致力開發低功耗且節能省電之綠色產品。
投入資源	● 將研發投入支出持續維持總營業額之15%~25%，並深耕客戶以提升營收表現。
申訴及溝通管道	● 業務對外部客戶及對內部之研發雙向溝通管道通暢，以掌握市場及消費者需求。 ● 各地區業務聯絡窗口可參考公司官網。

5 友善職場

5.1 人才吸引與留任 GRI 401-1、GRI 401-2、GRI 401-3

1.人才佈局與人才結構

晶宏集團將「多元性 (Diversity) 」視為推動組織創新與永續發展的重要基礎，並落實 DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) 多元、公平與共融理念，透過制度化的人力資源管理機制與包容性的組織文化，營造尊重差異、公平競爭的職場工作環境。

本公司堅信專業表現不因性別、背景或年齡而有所限制，於人才招募、任用、培育與晉升各階段，均依據職務專業、績效表現與潛力進行評估，確保公平、公正的用人原則。從各個職位招募至中高階管理職位遴選，皆致力於提供平等的發展機會，吸引並留任具多元背景之優秀人才。

聘用員工總人數(依性別)

年度		2024 年度	2025 年度
人數	女生	80	83
	男生	167	175
	合計	247	258
比例	女生	32.39%	32.17%
	男生	67.61%	67.83%

晶宏集團長期深耕研發創新與專業技術布局，致力於建立兼具穩定性與成長動能的人才結構。截至 2025 年底，我們全球員工總數為 258 人，為確保技術經驗的傳承與指導，本公司同仁平均服務年資為 8 年，展現出穩定且具經驗的人力結構與持續發展潛力。

聘用員工總人數(依地區別)

年度		2024 年度	2025 年度
人數	台灣	222	233
	中國大陸	25	25
	合計	247	258
比例	台灣	89.88%	90.31%
	中國大陸	10.12%	9.69%

晶宏集團的人才佈局橫跨台灣及海外據點配置人力，以即時回應全球客戶對驅動 IC 的需求。我們重視在地化經營，海外員工占全集團人數比為 10%，透過延攬當地優秀人才，落實共榮發展。

身為領先的驅動 IC 技術提供者，晶宏的人力資源配置以工程技術與研發創新為核心，研發人員占全體員工比例達 68%。同時，本公司持續推動多元招募政策，女性員工整體比例維持於 32%，逐步提升女性於技術與管理職系之參與度。晶宏集團女性管理階層比例達 20%以上，顯示性別多元治理方面的持續投入。為進一步落實 DEI 的公平 (Equity) 原則，本公司已著手研擬各職級男女薪酬比例之動態分析機制，預期於未來年度逐步落實各階級男女薪酬比之透明揭露，以確保整體薪資結構之性別平權與無偏見治理，落實永續發展目標。

聘用員工總人數(依職務分級)

年度			2024 年度	2025 年度
人數	管理階層	女生	16	19
		男生	62	64
		合計	78	83
	一般員工	女生	65	80
		男生	104	95
		合計	169	175
比例	管理階層	女生	20.51%	22.89%
		男生	79.49%	77.11%
	一般員工	女生	38.46%	45.71%
		男生	61.54%	54.29%

聘用員工總人數(依員工類別)

年度		2024 年度	2025 年度
人數	作業及技術	163	176
	管理及業務	84	82
	合計	247	258
比例	作業及技術	65.99%	68.22%
	管理及業務	34.01%	31.78%

身心障礙人數

年度	2024 年度	2025 年度
身心障礙人數	0	0
年底在職人數	247	258
比例	0%	0%

晶宏集團積極落實社會責任，將多元包容擴及至社會弱勢族群，2025 年因多為技術職致沒有足額僱用身心障礙同仁，公司已積極與各地就業服務中心合作開設專案媒合，並透過繳納差額補助費保障弱勢權益。

2.多元招募與人才延攬

在半導體研發人才競逐激烈的環境下，晶宏將「人才」視為本公司推動技術創新與永續成長的核心資產。為因應節能顯示技術及多元應用市場的快速發展，我們採取多元化的招募策略，透過官方網站、人力銀行及校園產學合作等管道，廣泛延攬具備專業實力與潛力的人才。

揭露主題：招募與管理全球及技術勞工

SASB 指標編號	指標項目	2024 年	2025 年
TC-SC-330a.1	需要工作簽證之員工百分比	0%	0%

晶宏集團員工皆無須簽發額外工作簽證，故沒有因工作簽證失效而導致的人才流失風險。

(1)內部舉才計畫

晶宏深信同仁是公司最專業的「獵才大使」。我們推動制度化的內部推薦獎勵機制，鼓勵同仁透過專業人脈，引薦優秀合適人才加入，提升招募效率與文化適配度。透過內部推薦加入之同仁，能更快速融入組織並縮短適應期，有助於提升留任表現與團隊凝聚力。

為激勵同仁主動舉才，晶宏訂定「員工推薦獎勵制度」，此制度肯定同仁在人才開發的貢獻，被推薦人經錄取、試用期滿且評估表現優異者，公司將依據職務等級，發放高額的介紹獎金，肯定同仁為公司引薦潛在人才。

(2)產學合作計畫

晶宏深信，學界的創新研究是產業技術突破的重要來源。為持續強化在驅動技術及超低功耗顯示領域的領先地位，我們積極與國內頂尖大學之電機、電子學院建立深度交流管道。透過簽署產學合作合約與技術交流專案，晶宏不僅將業界實務資源導入校園，更藉此強化公司的研發動能，實踐「理論領先、實務落地」的學用合一目標。晶宏與成大校系建立交流管道簽訂合約，結合學界知識，強化研發動能，深入布局領域人才。產學合作期間，晶宏提供技術資源，與成大進行技術合作，並透過職場導師制度定期進行關懷，協助學生於在學期間提前認識產業環境與職涯方向，為未來半導體人才培育奠定基礎，落實學用合一。

類別	學校	金額
2025 年度產學合作計畫	成功大學	新台幣 360 仟元

(3)校園徵才與培育

為儲備中長期研發能量並解決半導體產業人才競爭壓力，晶宏持續深耕校園徵才，於學術

機構建立深度的長期合作關係。我們透過校園徵才將企業資源導入校園，協助優秀學子接軌職涯發展，重視校園人才是推動未來創新突破的新生力量。為因應半導體產業人才競爭與技術更迭，我們持續透過「校園深耕計畫」主動走入國內頂尖大學，不僅是為了獵取頂尖研發人才，更是為了強化年輕學子對晶宏「節能、創新、永續」企業精神的認同感，並建立長期的技術人才儲備庫。積極參與指標性大學之徵才博覽會(成大、交大、高科大等)，讓優秀學子在畢業前即可鎖定職缺畢業即就業，展現對青年人才培育。

3.人才留任

晶宏集團不只追求人力的成長，更重視「招募品質」與「新進員工的長期發展」，透過下列機制，來穩定研發團隊為企業永續發展的最強後盾。我們不僅致力於延攬頂尖人才，更透過完善的職涯發展、具競爭力的薪酬機制及深厚的人文關懷，打造一個讓同仁擁有高度歸屬感的工作環境。

(1)新進人員關懷機制：為協助新進同仁迅速掌握職務核心、熟悉內部作業流程並深度認同晶宏的企業文化，本公司建立了系統化的「新進人員教育訓練」。透過線上及實體舉辦的教育訓練，我們將公司的營運願景、誠信經營規範、資安防護政策及永續發展目標等傳遞給每位新成員，確保同仁在入職初期即能建立正確的職涯導向。

(2)離職訪談反饋：針對異動同仁進行訪談，蒐集意見並回饋至制度與管理流程，持續優化職場環境。

2025 年度，因應新應用市場擴展及組織需求所致，晶宏集團全球人力較 2024 年成長 4.45%，展現晶宏在技術研發與營運規模上的擴張動能。晶宏集團之員工離職率僅為 6.16%。若參考 104 人力銀行 2024 年公布之《人資 FBI 調查報告》，該年度台灣電子資訊產業之總離職率約為 25%，相較於業界數據，晶宏始終維持極低且優於業界水準的留任表現。

為進一步透視人才流動結構，本公司針對 2025 年度之新進與離職人員進行性別與年齡層分析如下：

新進與離職員工人數(依性別)

年度			2024 年度	2025 年度
人數	新進人員	女性	8	9
		男性	27	19
		合計	35	28
	離職人員	女性	11	6
		男性	25	11
		合計	36	17
比例	新進人員	女性	22.86%	32.14%

	離職人員	男性	77.14%	67.86%
		女性	31%	35%
		男性	69%	65%

顯示晶宏集團積極引進年輕的新生代研發動能。

新進與離職員工人數(依年齡別)

年度			2024 年度	2025 年度
人數	新進人員	30 歲以下	9	13
		30 歲~50 歲	20	12
		50 歲以上	6	3
		合計	35	28
	離職人員	30 歲以下	4	1
		30 歲~50 歲	23	12
		50 歲以上	9	4
		合計	36	17
比例	新進人員	30 歲以下	25.72%	46.43%
		30 歲~50 歲	57.14%	42.86%
		50 歲以上	17.14%	10.71%
	離職人員	30 歲以下	11.11%	5.88%
		30 歲~50 歲	63.89%	70.59%
		50 歲以上	25.00%	23.53%

離職率(依員工類別)

年度		2024 年度	2025 年度
離職人員人數	經理人	0	0
	一般職員	27	15
	合計	27	15
資遣其退休人數		9	2
期末員工人數		247	258
離職率(註)		12.48%	6.16%

註：離職率=(本期離職人數+本期資遣及退休人數)/(期末人數+本期離職人數+本期資遣及退休人數)

5.2 人才培育與發展 GRI 404-1、404-2、404-3

晶宏集團深知，卓越的人力資本是推動顯示技術持續領先的核心動能。除了延攬具備國際視野的外部菁英，我們更致力於建構完善的內部培育機制，以因應企業在多元顯示應用市場的快速成長。同時，公司未來將研擬建立人力資本投入之量化效益評估機制，以精準優化人才發展資源配置，實踐企業與員工共榮發展的永續承諾。

1. 核心職能地圖

為了將人才發展與晶宏「誠信、創新、卓越」的經營哲學緊密結合，並實現「做正確事、現在就做、一次做好」的企業使命，我們經由組織文化分析與業界競爭力盤點，確立了晶宏同仁必備的五大核心職能：

卓越技術力 (Technical Excellence)：持續精進低功耗與高整合驅動技術。

市場敏銳度 (Market Insights)：深度洞察客戶需求，提供具競爭力的系統解決方案。

創新思維 (Disruptive Innovation)：敢於挑戰現狀，推動更環保、更智慧的顯示技術。

團隊凝聚 (Collective Synergy)：跨部門高效溝通，追求組織目標而非個人英雄主義。

韌性成長 (Adaptive Resilience)：在瞬息萬變的半導體產業中，保持彈性並持續優化自我。

這五大職能不僅是晶宏選才的標準，更是我們透過人才發展藍圖與教育訓練體系，協助員工與公司共同邁向永續經營的基石。

2. 人才發展藍圖

晶宏集團為同仁規劃了從入職到資深職涯的全方位發展路徑，確保同仁在每一階段都能獲得充足的成長養分：



(1) 啟航期 (新人導引)：

新進員工到職後，公司即安排必修新人訓練課程，內容涵蓋 ESG 規範、資訊安全、品質管理體系及標準作業流程，以協助同仁建立對公司制度與營運規範之基本認知，讓新人快速熟悉融入企業文化，提升留任與工作穩定度。

(2) 深耕期 (績效發展)：

同仁通過試用期後，主管將依據部門策略指標設定個人績效目標，確保個人發展方向與組織整體策略一致。公司採行「在職訓練」與「專業外部訓練」雙軌並進的人才培育機制，鼓勵同仁參與國際技術研討會及專業工作坊，並透過內部分享與實務應用，將學習成果內

化為組織知識，持續強化公司核心競爭力。

(3)成就期 (適才適所)：

晶宏透過每年度的績效考核與職涯發展對談，評估員工之專業表現、發展潛力與職涯志向，並提供「專業技術職」與「組織管理職」雙軌晉升制度。並依人才特質安排培訓或專業資源，逐步建立人才梯隊，確保公司持續具備穩健的人才動能與創新能力。

3.友善多元學習

(1)外部教育訓練：

晶宏半導體深信，持續引進外部前瞻知識與多元學習資源，是維持組織創新動能與人才競爭力的重要關鍵。公司長期與產業專業培訓機構及管理顧問單位合作，協助同仁掌握顯示技術相關之技術趨勢與管理思維，打造開放且友善的學習環境。

- 指標性培訓專案：

為強化組織決策品質與中堅管理梯隊之整體能量，晶宏規劃「團隊共識與自我價值認知」系列課程，培訓對象涵蓋部門主管、具發展潛力之儲備幹部及一般員工，累計參與人數達 175 人。透過系統化課程設計，引導學員建立共同目標認知與價值共識，提升團隊合作效能與組織凝聚力。

- 深耕式人才培育承諾： 相關培訓課程不僅止於單次知識傳遞，而是透過具結構性的教育訓練制度持續推動，平均每人訓練時數達 21.8 小時以上，確保學習成果能有效轉化為日常管理與工作實踐。

(2)專業進修培訓計畫：

為落實「友善學習環境」之人才發展理念，晶宏提供多元且完善的進修支持機制，確保同仁在追求專業成長的過程中，均能獲得充足資源與制度保障。

- 多元化學習管道：建置線上學習平台，整合內部技術分享、外部實體課程及數位學習資源，涵蓋 IC 設計前端技術、低功耗演算法、法令遵循及專案管理等主題，協助同仁依個人需求自主規劃學習進度。
- 全額補助與職能認證支持：凡與職務相關之專業進修課程、技能研習或國際性專業證照，公司均提供全額費用補助，鼓勵同仁持續精進專業能力。
- 帶薪外訓公假制度：提供外訓公假，支持同仁於工作時間參與外部研討會、課程或專業考核，降低學習負擔，促進工作與學習之平衡。

年份	2024 年	2025 年
員工人數	247	258
總訓練時數	3,525.5	5,617.5
每位員工平均受訓時數	14.3	21.7

(3)內部講師獎勵制度

晶宏視員工累積之專業實務經驗為公司重要的無形資產。公司推動內部講師獎勵制度，鼓勵具備核心專業能力之同仁參與知識萃取與經驗傳承。透過內部授課與職能擴散機制，將個人專業轉化為組織共通之知識體系，進而提升整體技術競爭力。

為肯定內部講師於繁忙工作之餘，對組織知識傳承所付出的貢獻，公司規劃課程授課獎金。凡協助公司進行課程規劃、教材編撰並完成授課之內部講師，將依課程性質及實際授課時數，提供相應之授課鐘點費，以鼓勵專業分享。

同時，晶宏將「人才培育」視為資深同仁及管理階層的重要職責。人資部門定期追蹤授課時數，並透過課後學員意見回饋、課程滿意度調查，持續檢視培訓品質與知識傳承成效，確保內部培育機制之持續優化。

4.教育訓練成果

晶宏集團深信員工專業能力的持續精進，是支撐企業永續競爭力的關鍵基礎。公司訂定「教育訓練管理辦法」，將中長期經營策略與員工個人職涯發展計畫 (IDP) 相互連結，確保人才培育方向與組織發展目標一致。2025 年度員工培訓總投入達 1,842 人次，全球受訓總時數達 5,617.5 小時；每位員工平均受訓時數達 21.7 小時，總訓練時數較去年度 2024 年大幅成長 59%，實質展現晶宏深化人力資本的決心。

除專注於專業與技術能力外，晶宏亦將核心職能納入年度教育訓練規劃，透過內部培訓、外部專業課程及多元學習資源，協助同仁因應半導體產業之快速變化，持續精進專業與核心職能，支持公司長期營運與人才永續發展。

序號	訓 練 類 別	總訓練人次	總訓練時數
1	新進人員之培訓	39	156
2	專門知識及技術之訓練	351	1,324
3	勞工法令之教育訓練	397	1,073
4	安全衛生訓練	446	1,697.5
5	電腦訓練	216	393
6	財務管理	14	117
7	其他	379	857
合計		1,842	5,617.5

5.滿意度調查

為確保培訓資源精準符合工作實務所需，於 2025 年針對內部教育訓練課程實施 7 次員工滿意度調查，總計調查 208 人，達成 100% 職員全覆蓋率，整體平均滿意度高達 95.8%。為

了解員工對公司內部宣導之職能專業課程、團隊合作及商業談判等課程內容是否滿足工作需求，並蒐集課程回饋意見，進行深度溝通和訪談與訂定改善計畫之依據。

對象	全體職員
題目	內部訓練課程滿意度
調查人數	208 人
覆蓋率	100%
負責調查單位	人力資源部
調查頻率	2025 年共 7 次
調查期間	2025/01/01~2025/12/31
整體滿意度	95.8%
提升改善方案	1.持續推行管理階層、核心員工、一般員工培訓課程透過課程學習培養員工的領導力，強化跨部門溝通與管理技能;協助員工理解團隊合作的重要性，建立責任感與自我價值認知。進一步提升員工職能專業性與組織整體競爭力，以因應快速變動的產業環境。 2.透過內部講師培訓計畫，運用公司內部專業知識與實務經驗，提升員工專業與通識能力，營造持續學習的組織文化，並促進關鍵知識與經驗的有效傳承，支持組織長期穩健發展。

6.績效考核

晶宏視同仁為最珍貴的資產，秉持「以人為本」的經營理念，針對全體正式員工（不分性別、職級與國籍）實施 100%定期績效考核。致力於打造一個公平、競爭且具備成長動力的工作環境。我們透過制度化的績效考核體系，不僅檢視過去的貢獻，更著重於開發同仁的潛能，確保每一位成員的職涯成長與公司的永續營運方針並齊。

(1)核心目標：

- 目標對齊：確保員工個人績效目標（KPI）與公司年度營運目標連結。
- 潛能開發：透過面談了解員工職涯意願，發掘具潛力之人才。
- 公平獎酬：提供數據化、客觀評估依據，作為薪資調整與獎金發放與激勵制度的標準。

(2)考核流程：

資訊部自行開發軟體程式，將績效管理全面數位化，系統即時提供考核完成度、等第分配、人力預算執行、離職率統計、教育訓練達成率與費用統計等。

本公司的考核制度強調雙向「溝通」而非單向評分。流程分為三個核心階段：

階段	執行重點	永續價值
(1)員工自評	員工針對年度目標達成度進行質化與量化的自我總結。	提升員工自主意識，強化職責認同感。
(2)主管評核	直屬主管依據關鍵績效指標（KPI）及工作行為表現，給予客觀回饋。	確保管理標準一致化，落實績效文化。
(3)績效面談	透過面對面溝通，主管與同仁共同探討困難與解決方案。	建立透明、互信的職場文化，透過與員工溝通痛點。

(3)考核應用：

績效考核並非終點，而是我們人力資源規劃的起點。我們會根據考核結果，將資源投入在以下三個面向：

- 薪酬與激勵機制：考核結果直接關聯至年度調薪、年終獎金及績效分紅，確保優秀表現獲得實質回饋。
- 人才梯隊與晉升：作為職位升遷、職責擴張及接班人計畫（Succession Planning）的重要篩選依據。
- 賦能與教育訓練：針對考核中發現的職能缺口，人力資源部將規劃相對應的專業培訓、通識課程或管理課程，支持員工持續學習與轉型成長。

(4)升遷制度

晶宏集團視同仁的職涯發展為組織成長的基石。我們透過計畫性的教育訓練資源與嚴謹的年度績效考核，建立公平、公正的人才鑑別機制。透過每年度的評核過程，我們不僅檢視同仁的工作達成率，更深度評估其職能成長潛力，以此作為晉升推薦的核心依據，確保每一位具備卓越貢獻的優秀人才能在組織內獲得應有的發展空間。

為兼顧半導體產業對專業技術與組織管理的需求，晶宏提供「技術職」與「管理職」雙軌晉升，同仁晉升依據年度績效表現、專案關鍵貢獻、核心職能評鑑以及現有年資條件進行綜合評比，透過此機制確保管理人才與技術菁英皆能在晶宏找到適才適所的職涯舞台。

- 管理職：績效卓越、具領導力及跨部門溝通能力者，授予管理職銜與相應權責，培養成為組織決策核心。
- 技術職：專注 IC 設計、技術研發或特定領域深耕者，提供晉升機會，成為公司技術創新的領航者。

經核定晉升的同仁，除薪資與職稱調整外，公司將透過公告表揚，肯定其對公司永續經營的貢獻，營造追求卓越、共同成長的企業文化。

重大主題-人才培育

策略目標	年度人均受訓時數較前一年度上升10%以上 內部講師人數增加10%，開課比率達60%
核心目標	<u>短期:</u> ● 年度人均訓練時數達13小時 ● 內部講師人數10人 <u>中長期:</u> ● 人均訓練時數達17小時 ● 內部講師人數達15人以上 ● 關鍵人才留任率>80% ● 專業課程完訓率90%
負責單位	人力資源部
績效評估	定期檢視離職率、員工意見溝通、課後回饋及測驗、員工績效考評機制表現。
行動方案	● 持續進行人才培訓計劃，達到組織創新、團隊協同與永續人才發展目標。 ● 系統化的數位培訓機制，有效傳承組織知識、掌握關鍵人才，增加專業職能及職涯發展，培養優秀管理人才，促進人才傳承與組織永續。
投入資源	● 定期檢視課後回饋及測驗。 ● 人均受訓時數與成本。 ● 員工績效考評。
申訴及溝通管道	● 員工溝通。 ● 績效考核。

5.3 薪酬福利 GRI 2-19、GRI 2-30、GRI 401-2

在 IC 設計產業中，員工的專業技術與創新思維是企業維持領先地位的關鍵。晶宏集團視人才為公司最珍貴的資產，因此我們致力於提供具備產業競爭力的薪酬福利制度。我們透過優質的待遇吸引全球一流人才加入，並藉由合理的利潤分享機制留任核心技術夥伴，確保公司在驅動 IC 領域的長遠競爭力。晶宏持續關注整體薪酬在業界的排名，確保薪資水平能反映研發人才的專業價值。我們以營運績效為基礎，將企業經營成果直接回饋給同仁，營造「公司成長，同仁獲益」的共榮循環。

1. 薪酬績效

晶宏半導體以學歷、專業職能及職務內容作為起薪標準，並根據個人經歷差異進行核薪，確保固定薪資的公平性。到職滿週年後，公司會依據市場行情趨勢、公司年度營運狀況及個人工作績效等條件進行薪資調整，不因性別、年齡或工作地點，而有差別待遇。

本公司定期了解同業薪資水準，確保整體薪酬維持在同業平均，使員工薪酬具產業競爭力。此外，公司面對市場景氣波動，保障同仁之基本固定薪資與法定福利，並於公司營運達成目標時，提撥固定比例之盈餘作為員工酬勞，實質確保優秀人才之實質回報與留任吸引力。根據證交所最新公布之 2024 年上市櫃企業「非擔任主管職務之全時員工薪資」統計：晶宏在全台半導體產業排序第 62 名。

2025 年資訊如下：

- 非擔任主管職務之全時員工薪資平均數：新台幣 1,337 仟元。
- 非擔任主管職務之全時員工薪資中位數：新台幣 1,219 仟元。
- 優於法定基本工資之保障：晶宏員工每月平均收入遠高於台灣法定基本工資數倍之上。
-

年度	員工福利費用(含薪資、勞健保、退休金等)	非擔任主管職務之全時員工資訊員工薪資總額(仟元)	非擔任主管職務之全時員工資訊員工人數-年度平均(人)	非擔任主管職務之全時員工資訊員工薪資-平均數(仟元/人)	非擔任主管職務之全時員工資訊員工薪資-中位數(仟元/人)
2024	243,730	178,780	141	1,268	1,204
2025	243,501	191,211	143	1,337	1,219

本公司薪酬政策與經營績效具有高度彈性與緊密連結，薪資費用之變動均全面反映當年度之營運獲利實績：

2024 年度：受全球半導體供應鏈庫存調整及市場需求放緩影響，公司營運績效下滑，致使非主管職員工之平均薪資與中位數有所調整，展現薪酬與經營績效彈性連動，亦確保企業在逆境中的韌性。

2025 年度：隨著驅動 IC 市場回溫及綠色顯示技術產品穩定出貨下，本公司依據利潤分享原則，將營運績效直接回饋予員工並考量物價通膨指數，致 2025 年非主管職全時員工薪資平均數增加 5.4% 達新台幣 1,337 仟元，中位數亦同步成長。

本公司董事會薪酬委員會亦定期審查高階主管與整體員工之薪酬發放結構，確保薪資費用與經營績效相當，在維護股東權益的同時，整體薪酬水準在驅動 IC 產業中展現了穩健且具競爭力的優勢。

2. 公平核薪

晶宏半導體堅守公平競爭與多元共融原則，主要以職務與工作表現為核心的薪酬體系。

- (1)起薪一致：針對無經驗之社會新鮮人，各職務類別對兩性同仁均採取相同的核薪標準，不因性別而有差別待遇。
- (2)同工同酬：在相同職級與職務下，同仁的薪資調整、績效獎金發放及晉升機會，係依據

績效考核結果 (KPI) 與相關專業年資決定。

(3)透明度與公正性：透過每年度的績效面談機制，確保同仁對薪資核敘邏輯有充分的了解，並保障同仁的薪資福利不受性別、地域、種族或宗教等因素干擾。

藉由高度透明且具激勵性的薪資制度，晶宏半導體不僅能留住技術核心，更能激發同仁在工作上的熱情，共同開創綠色顯示技術的新未來。

本公司目前依據職務與績效落實同工同酬。為進一步提升薪酬透明度與公平性，未來將規劃導入各職級男女薪酬比例分析，以定期檢視並確保無性別偏見之薪酬結構。

3.員工持股信託

本公司為有效提升員工福利並保障員工退休生活，晶宏推行「員工持股信託計畫」。凡任職滿一定年資之正式同仁皆可自主申請加入員工持股會。

依據持股會章程內容，相對提撥高達 50% ~ 150%的「公司公提金」作為激勵獎勵金。此機制等同實質提升同仁的每月整體薪資福利，透過定期定額的長期投資，不僅能有效分散市場投資風險，更能讓同仁化身為公司股東，與公司併肩作戰，共同分享驅動 IC 業務拓展的永續經營成果。

本公司之員工持股信託開辦，對員工有以下之優點：

- (1)鼓勵員工日常儲蓄，保障老年退休生活之穩定。
- (2)公司額外提撥獎勵金，等同薪資福利之提升。
- (3)定期定額長期投資，除分散投資風險外，並分享公司經營成果。
- (4)員工持股會資產交付信託有保障。

4.友善福利與健康職場

晶宏依據「勞動基準法」及相關法令提供完善保障，並額外規劃了多項全方位、優於法規的彈性福利與健康防護，讓同仁無後顧之憂：

- (1)優於法規之特選休假：為鼓勵同仁適度放鬆，除了勞基法規定的法定假別之外，公司每年度另行給予同仁 7 日的專屬「公司補休假」，讓同仁有更充裕的時間陪伴家人、調適身心。
- (2)優於法定之全面保險與健康福利：晶宏不僅依法辦理在職員工體檢，更定期提供進階健康檢查補助。此外，全額補助員工及眷屬之團體保險 (涵蓋壽險、醫療險、癌症險、骨折險及意外險)，並針對同仁出差海外提供完善的旅遊平安險 (含意外、醫療、旅遊不便險及全球海外急難救助)，讓保障延伸至全方位的家庭照護。
- (3)人性化高彈性工作制度：為應對突發之氣候、颱風等天然災害因素，晶宏推動彈性居家工作，優先保障同仁的通勤安全。

5.4 人權與員工溝通 GRI 406-1、GRI 412-1、412-2

晶宏集團致力於企業永續經營，持續強化對員工福祉與環境永續責任的重視。我們營造尊重人權、健康安全且具包容性的工作環境，堅信員工是公司最核心的資產。

1. 人權政策與承諾

本公司恪遵國際人權精神，參照《世界人權宣言》(International Bill of Rights) 及《國際勞工組織關於工作中的基本原則與權利宣言》(ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 等國際公認之人權標準。為善盡企業社會責任並落實人權保障，杜絕侵犯及違反人權的行為，本公司訂定核心人權政策、程序及具體管理面向：

- 禁用童工：嚴禁聘用未滿 18 歲之勞工，亦不接受供應商或外包商雇用童工。
- 自由選擇職業：尊重員工自由，嚴禁任何形式的強迫勞動，並要求外包商遵守相同原則。
- 安全衛生職場：提供安全衛生的工作環境，採取必要之預防措施以防止職業災害，確保員工安全與身心健康。
- 結社自由與福利：鼓勵員工自組社團，支持社團多元化活動與福利計畫。
- 反歧視與機會均等：禁止任何形式之歧視行為，建立公平、尊重與包容之工作環境。
- 尊嚴勞動與隱私：尊重人格尊嚴與個人隱私，禁止一切侮辱、威脅、騷擾、職場暴力等不當行為。

制度化保障與多元平等 (DEI)

為確保上述政策落實，本公司已制定「員工手冊」、「工作規則」、「招募任用辦法」及「性騷擾防治」等規章，明確保障同仁於招募、任用、薪酬、福利、培訓、升遷、解職、退休等全方位面向之勞動權益。

公司重視平等的工作環境，每年定期提供員工性騷擾防治及反歧視相關教育訓練，確保同仁不會因性別、種族、宗教、年齡等不同背景而受不平等待遇。

2. 風險評估與減緩措施

2025 年度，本公司依循此流程進行營運環境之人權風險鑑別，針對重要人權議題制定之具體目標、作為、風險評估與減緩措施如下表所示：

人權關注議題	目標與作為	風險評估	減緩與補救措施
--------	-------	------	---------

提供安全與健康的工作環境	強化職業疾病預防，持續降低工作危險因子，促進員工身心健康。	避免因工作環境或操作不當造成之職業疾病與潛在工安事故。	1.定期提供多元健康資訊。 2.辦理優於法規之員工定期健康檢查。
杜絕不法歧視以確保工作機會均等	招募面談及任用程序中，嚴禁詢問與工作無關之個人隱私個資，落實公平對待。	避免招募、調薪或升遷流程中出現不法歧視，衝擊多元平等職場環境。	自招募、調派至聘僱之全流程，透過內部控制與稽核程序杜絕不法歧視。
禁用童工	嚴格限於年滿18歲之應徵者方得錄用，對獲聘同仁進行嚴格查驗，落實雙重把關。	避免因招募審查疏漏或供應鏈管理不當而誤用童工之風險。	於到職前要求提供相關身分證明文件（如身分證、健保卡、學歷證明）進行核對確認，杜絕童工聘用。
禁止強迫勞動	遵循勞動法令，於工作規則中明定延長工時需取得員工同意，並依法提供加班費或補休。	避免因系統控管不周、工時過長或違反員工意願進行勞務之風險。	1.於申報加班系統中設置工時提醒功能。 2.逐月進行工時檢視與控管。 3.搭配刷卡系統及多元申訴管道落實保障。
協助員工維持身心健康與工作生活平衡	提供多元化活動（如社團、運動類），並與優質機構簽署辦理托兒設施，降低同仁育兒壓力。	同仁工作壓力過大或缺乏生活平衡，導致參與率低或身心失衡。	1.福委會委員及窗口加強宣傳。 2.定期檢視各項福利與社團參與率，動態優化活動內容。 3.優於勞基法給予7日補休假 4.健檢補助、員工及眷屬團體保險、出差旅平險。 5.颱風天居家工作、因照顧家人可申請居家工作（WFH）。

3.人權關注事項與具體作法

(1)打造安全與健康的工作環境

本公司依法令規範提供安全與健康之工作環境，所有營運據點均取得建築物公共安全合格標章。我們定期辦理安全衛生、消防等相關教育訓練，採取必要之預防措施以防止職業災害發生，建構零災害的職場。

(2)消除歧視與工作機會均等

本公司於人員招募上秉持公平客觀精神。在評估求職者之綜合表現外，積極回應社會責任，將聘用身心障礙、原住民或工作場所所在地之求職者視為優先考量。

本公司於聘用、薪酬福利、培訓機會、升遷、解職或退休等勞動權益事項上，對於職工及求職者不以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或其他歧視等因素為由而有不公平的對待。經人權盡職調查與內部稽核盤點，2025 年度晶宏集團未發生任何歧視事件，且於評估期間內，晶宏集團營運據點均未有違反任何國內外人權、勞動相關法規之情事。

(3)人權保障與誠信培訓

為將人權意識內化至企業文化，公司針對全體同仁推行系統化人權教育訓練：

- 新進人員訓練：同仁到職時即進行相關法遵宣導，涵蓋性騷擾防治、反歧視、反騷擾、工時管理、人道待遇保障及健康與安全工作環境。
- 預防職場暴力：透過內部宣導與公告聲明，明定全體員工皆有責任共同維護尊重的職場環境。為預防職場不法侵害事件，設有完善的預防機制與專線，營造友善職場。
- 職業安全系列訓練：定期辦理安全衛生教育訓練、消防演練、緊急應變措施及急救人員培訓，全面提升員工危機應變與自救能力。
- 誠信與職業道德宣導：透過日常教育與道德標準宣導，持續強化誠信守法觀念，培養同仁恪守最高道德標準與公司核心價值。

(4)暢通的申訴與溝通制度

晶宏集團建構多元且受保護的申訴管道，確保同仁與外部利害關係人之權益：

- 多元申訴管道：同仁於內部遇有任何不平等對待時，可直接向各級主管或人力資源部門提出申訴。
- 性騷擾防治專屬管道：為維護性別工作平等，免受性騷擾之工作及服務環境，公司設有性騷擾防治之「專屬申訴信箱」與「電子郵箱」。
- 嚴格保密機制：於申訴調查期間，全案皆採取最高規格之保密方式處理，絕不洩漏申訴人之姓名或其他個人資料，以實質行動保障申訴人，避免任何不當報復。

(5)員工關懷與多元溝通機制

晶宏集團秉持以人為本的精神，建立多元化溝通管道與全方位的同仁關懷網絡，將「員工支持」與「透明管理」落實於日常營運，具體實施情形如下：

- 主動式同仁關懷訪談：由人力資源單位或各部門主管，定期進行同仁關懷訪談，主動掌握同仁之工作適應、生活狀況及心理需求，凡遇適應挑戰或特殊變故，即時介入並提供必要之行政與心理協助。
- 雙向績效評核與發展輔導：建立完善的績效考核與新進人員試用期評核制度。全案採取主管與同仁「雙向溝通」模式進行反饋；針對評核結果未達預期者，由主管與人資共同制定「績效提升計畫 (PIP, Performance Improvement Plan) 」並給予個別輔導與改善建議，實質協助同仁適應組織步調與持續成長。
- 全方位諮詢專線：設置同仁個人問題諮詢管道，由人資單位擔任諮詢橋樑，針對工作壓力、職涯發展、生活適應及家庭照護等多元議題，提供即時性的諮詢、協調與轉介機制。
- 安全保密的申訴管道：設置暢通之申訴與溝通管道(包含性騷擾防治專線及專用信箱)，嚴格執行匿名與保密協定，確保同仁意見得以安全、即時反映，並全面依法規流程與組織內部控制程序進行公正調查與回覆。
- 營造透明正向溝通文化：持續深化正向溝通之企業文化，推動透明化管理機制，透過多層級的對話平台，強化組織內部之雙向溝通效率，奠定勞資互信基礎。

4.勞資會議

晶宏雖未設置工會，但每季定期召開勞資會議。2025 年合計各召開 4 次，報告關於勞工動態 (勞工人數、勞工異動情形、離職率等)、事業之生產計畫、業務概況及市場狀況等生產資訊、及其他報告事項。

5.5 職安與員工健康 GRI 403-1 ~GRI 403-10

1.職安衛管理方針與架構

晶宏半導體作為專業的 IC 設計公司，雖然營運型態屬於低風險的辦公室作業環境，但我們深信「人才是企業最重要的資產」，提供一個安全、健康且舒適的工作環境是我們對同仁最基本的承諾。

我們遵循《職業安全衛生法》及國際標準，制定並發布「安全衛生工作守則」。為確管理機制的有效運作，我們建置了跨部門的職業安全衛生管理架構：

由人資、行政管理、資訊及各部門主管共同組成推動小組，負責鑑別潛在的作業風險 (如：人因工程危害、電氣安全、異常工作負荷等)。

我們建立職業安全衛生管理計畫之標準化作業程序，並針對緊急狀況 (如火災、地震、傳染病) 制定應變計畫。

我們依法設置「職業安全衛生委員會」，由總經理親自擔任主任委員，總體規劃與監督全公司之職安衛方針，且勞工代表比例符合法規要求。委員會固定於每季之次月定期召開（每年共 4 次），報告定期的巡檢情形、設備儀器的檢查、安全衛生教育訓練執行、健康檢查實施執行與健康促進計畫，緊急應變措施宣導執行情形、檢視職安衛績效、追蹤改善事項，並作為勞資雙方溝通健康議題的重要平台。

本公司依據職業安全衛生管理計畫，由職安衛推動小組進行危害辨識與風險評估，針對日常辦公作業、機房維護、用電安全及同仁通勤等情境進行危害辨識，依據「發生可能性」與「嚴重度」計算風險值，區分為高、中、低風險等級。本公司主要潛在風險為「長期操作電腦引發之人因肌肉骨骼不適（中風險）」及「實驗室焊錫人員鉛含量過高」。公司透過提供符合人體工學之辦公設備、身體健康檢查鉛含量及定期安排職醫/職護臨場諮詢，從源頭控制風險。

2.全方位的健康照護

晶宏集團採取「預防勝於治療」的策略，從硬體環境防護與軟體個人保健雙軌並進，打造全方位的健康照護。

(1)打造安心職場：致力於消除環境中的潛在危害，讓同仁能無後顧之憂地投入工作。

- 環境監測與優化：每年定期進行作業環境監測，檢測作業場所照明度，確保室內空氣品質與光線符合標準，降低視力受損風險。
- 飲水與衛生安全：飲用水設備定期每月進行濾心更換與維護；冷卻水塔定期進行清洗與消毒滅菌，杜絕滋生細菌風險。
- 設施與消防安全：每年實施電氣設備安全檢查與消防安全設備檢修（申報）。此外，行政總務單位亦執行不定期的職場巡檢，針對潛在跌倒、碰撞等風險進行立即改善。

(2)身心平衡支持：關注身體健康，更包含身心理與生活平衡。

- 優於法規的健康檢查：我們提供優於法令規範的年度員工健康檢查方案。2025 年，共計 178 名員工參與健檢。針對健檢結果異常者，由職護進行分級管理與追蹤，並提供個人化的衛教指導。
- 專業醫療諮詢(臨場服務)：我們安排職業醫學科專科醫師與護理師定期臨場服務(醫師一年 4 次、護理師每月 4 次)。提供同仁一對一的健康諮詢、選工配工評估以及復工評估，2025 年共計服務 84 人次。
- 四大計畫落實：積極推動「人因性危害預防」、「異常工作負荷促發疾病預防」、「母性健康保護」及「執行職務遭受不法侵害預防」四大計畫。
- 身心紓壓與健康促進：為緩解久坐辦公的疲勞，我們提供(請依晶宏實際狀況選擇或修改以下項目：健身社團補助、定期舉辦健康講座、提供多元下午茶選擇/健康零食)，2025 年參與相關健康促進活動者達 143 人次。

3.職安衛教育訓練

為塑造全員參與的安全文化，晶宏集團將職安衛意識融入日常訓練中。每年定期舉辦消防疏散演練，並結合 AED (自動體外心臟電擊去顫器) 與 CPR 急救教學，提升同仁在災害發生時的自救與互救能力，2025 年共舉辦 2 場演練全員防災演練。針對新進人員進行職安衛教育訓練，並於內部系統或公告欄不定期發布健康衛教資訊 (如:辦公室伸展運動、正確的姿勢讓痠痛遠離你等)，2025 年職安衛相關訓練總時數達 369 小時。

在全體同仁的共同努力下，2025 年晶宏集團在職業安全衛生方面維持了優異的績效，共投入了新台幣 617,180 元用於安全衛生相關措施，包含健檢、保險、訓練、環境檢測等。

相關執行情形

年度	2024 年度	2025 年度
職業災害件數	1	0
職業病案例	0	0
失能傷害頻率 (FR)	0	0
失能傷害嚴重率 (SR)	0	0

2024 年有 1 件通勤職業災害，晶宏於傷害期間給予居家工作假，並依勞保局認可之區間申請職災補助及公司補助，使員工未因受傷而造成重大經濟損失。2025 年度未發生任何職業災害案件，故無須啟動因應之職災改善補救措施。

展望未來，晶宏將持續優化職安衛管理系統，未來將研擬導入 ISO 45001 驗證之可行性，致力於打造一個「零災害、零職業病」且充滿活力的幸福職場。

4.落實職場四大健康保護計畫

為建構全方位的健康職場，晶宏半導體依據《職業安全衛生法》及相關指引，積極推動「職場四大健康保護計畫」。我們透過系統性的危害辨識、醫師專業評估及分級管理機制，針對潛在的健康風險進行源頭管理，確保同仁的身心健康。

(1)異常工作負荷促發疾病預防計畫

針對 IC 設計產業常見的長時間腦力作業、輪班或夜間工作特性，我們致力於預防腦心血管疾病 (過勞預防) 的發生。

執行機制：每年配合員工健康檢查，採用「過勞量表」進行篩選，綜合評估同仁的個人健康風險 (如血壓、膽固醇等數據) 及工作負荷情形。

分級管理與面談：針對評估結果列為「高風險群」的同仁，我們主動安排職業醫學科醫師進行一對一健康面談與指導。醫師會依據同仁狀況提出職務調整建議或生活型態改善方案，並由護理人員定期追蹤改善成效。

2025 年執行成果：

本年度篩選出疑似高風險族群共 4 名。

實際完成醫師面訪與衛教諮詢者共 1 名，護理師面訪與衛教諮詢者共 3 名。

經醫師評估，所有受訪者均持續進行健康監控，無須立即進行職務調整，亦無發生與工作相關之腦心血管疾病案例。

(2)母性健康保護計畫

晶宏重視女性同仁的職場權益與母性健康，致力於營造友善的生養環境，讓女性同仁在懷孕、分娩及哺乳期間都能獲得完善的保護與支持。

風險評估與分級：針對懷孕中及產後一年內的女性同仁，啟動健康危害評估。由職安衛人員與醫護人員共同檢視工作場所（如：化學品暴露或人因危害），並進行風險分級（第一級至第四級管理）。

友善措施與諮詢：

護理師諮詢：針對符合資格之母性員工，全數安排護理師諮詢評估，確保工作內容不會影響母體與胎兒健康。

環境支持：公司設有具隱私且設備齊全的哺（集）乳室，提供舒適的哺乳環境。此外，亦規劃孕婦優先安排停車位。

權益保障：落實《性別平等工作法》，保障同仁申請產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留職停薪等權益，並建立順暢的復職協助機制。

2025 年執行成果：

本年度啟動母性健康保護計畫人數共 1 名，經護理師評估，全數同仁經評估後適任原職務，無需調整。

(3)人因性危害預防計畫

考量 IC 設計研發人員長時間使用電腦及固定姿勢作業，容易產生肩頸痠痛或肌肉骨骼不適，我們積極推動人因工程改善計畫。

問卷篩選與分析：利用「骨骼肌肉症狀調查問卷」調查同仁過去一年的身體痠痛情形，並結合現場訪視，鑑別潛在的重複性作業或不良姿勢危害。

改善小組與對策：針對評估結果顯示有潛在危害者，由職安衛單位、醫護人員及部門主管組成改善小組。

改善措施：提供符合人體工學的辦公椅、螢幕支架或輔助靠墊；醫師指導正確坐姿與伸展運動；鼓勵同仁利用公司提供的社團相關運動，緩解肌肉疲勞。

2025 年執行成果：

問卷調查評分感到不適者共 21 名。經醫師訪談與現場評估，員工症狀處於「初期疲勞」或「輕微不適」階段，尚未具備臨床意義的職業傷害或慢性勞損，提供改善建議與衛教指

導已結案。

(4)執行職務遭受不法侵害預防計畫

我們堅持「暴力零容忍」原則，致力於消除職場內外部的身體或精神不法侵害(包含霸凌、騷擾、威脅等)，維護同仁的身心安全與尊嚴。

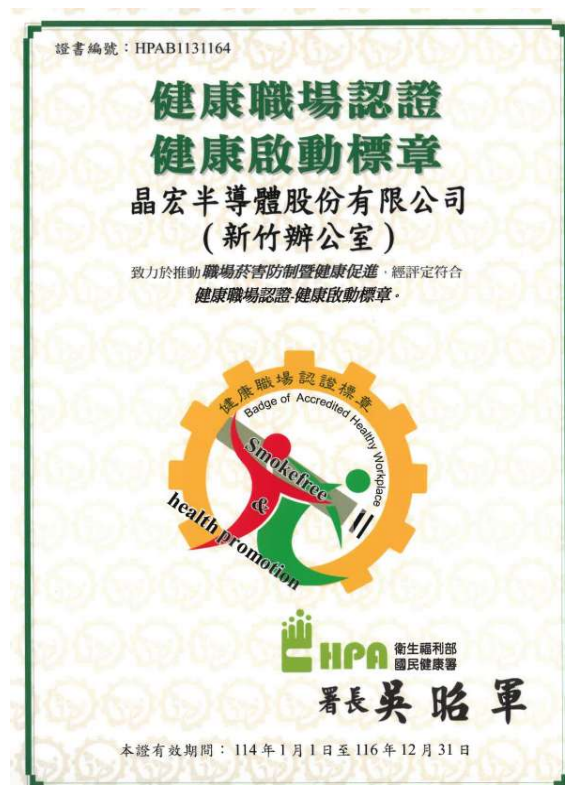
預防與宣導：於新進人員訓練中納入職場暴力預防課程，並定期進行危害辨識 (如：門禁安全、夜間工作安全)。公告「執行職務遭受不法侵害預防計畫」聲明，明確申訴管道。

通報與處置：建立保密且公正的通報機制。一旦接獲申訴，立即啟動調查小組，對受害者提供心理諮商與法律協助，並對行為人進行懲處與輔導。

2025 年執行成果：

本年度進行職場不法侵害風險評估，風險等級為低風險，2025 年無發生任何職場暴力或不法侵害之通報案件。

本公司持續依據《職業安全衛生法》及相關法規，深化安全衛生教育、風險評估與預防措施，實質降低工作場所之潛在危險因素。在全體同仁共同努力下，本公司持續維持優異職場健康環境，並曾榮獲國民健康署「健康職場認證－健康啟動標章」之肯定。



6 環境保護

6.1 氣候變遷 GRI 201-2

1.環境永續

晶宏依《上市上櫃公司永續發展實務守則》來實踐企業社會責任，並將永續應用於營運中，由「永續發展委員會」下各推動小組，推動以下的綠色治理。

法規遵循與國際接軌：嚴格遵守國內外環境保護法規，並主動響應國際環境倡議與永續標準。

資源優化與循環經濟：全面提升能源與水資源之使用效率，評估環保物料。

綠色設計與產品賦能：將永續導入研發，開發低功耗及再利用性，開創環境之綠色科技。

兼職治理與全員參與：設置環境管理人員，定期舉辦環境教育培訓，加強永續環保意識。

氣候因應與減碳承諾：追蹤全球氣候變遷趨勢，鑑別氣候風險與機遇，制定溫室氣體減量路徑，降低營運價值鏈之碳足跡。

配合國際電子產品綠色潮流，本公司採用「環境限用物質管制」，透過嚴格的供應商稽核與物料檢驗機制，確保所有產品百分之百符合歐盟 RoHS、REACH 高度關注物質(SVHC)以及包裝與包裝廢棄物指令等國際環境友善規範，並攜手價值鏈夥伴共創低污染的綠色供應鏈。

為將環境守護落實於日常，對辦公場域之資源回收、廢棄物處置實施嚴密監督，在杜絕環境污染的同時，確保同仁享有安全、健康的職場環境。具體綠色實踐包含：全面推行電子簽核，大幅減少日常紙張與碳粉之消耗，建立數位化辦公環境。採用省電節能標章的多功能事務機，並優先使用環保碳粉，以降低對環境的影響。

晶宏集團在推動「共存共榮」供應鏈的同時，亦高度關注國際間對於生物多樣性、不毀林(Non-Deforestation) 等自然資源管理的趨勢。我們將此視為價值鏈源頭管理的重要方針，在環境保護與自然資源的實踐上，晶宏始終堅持落實法規。於 2025 年評估期間，晶宏集團未發生任何違反環境保護與自然資源管理相關法規之情事。

雖然目前尚未正式發布獨立之《生物多樣性及不毀林政策》，亦未對營運周邊環境進行系統性的生態多樣性評估或揭露相關量化成果；未來我們在引進新供應商夥伴時，計畫將環境管理表現納入評估項目，將其列為未來深化綠色供應鏈的重點。

未來研擬《生物多樣性及不毀林政策》，正式表達對生態保護與負責任供應鏈的承諾。配合政策推行，未來將逐步於報告書中揭露供應鏈環境管理之具體成效，並評估對周邊環境進行生態衝擊評估之可行性，落實資訊透明化。

2.氣候治理

目前全球暖化、異常的天災等極端氣候，已對環境能源及經濟造成影響。晶宏集團位居半導體產業鏈上游，在氣候變遷之溫室氣體排放下，我們仍面臨潛在的實體風險，如極端氣候引

發的天然災害 (如缺水、限電、暴雨等)，將可能使中下游之供應商於生產缺水、製造缺電、運輸過程延遲或進而造成設備異常故障，原物料成本增加，進而增加營運成本與財務損失之風險，對營運活動產生衝擊。

晶宏集團將持續關注與公司營運相關之氣候變遷風險與機會、能源使用效率、涉及產品生命週期之各項環境衝擊議題，並擬定實施方案以掌握營運之潛在風險與機會。

晶宏導入 TCFD 架構，由「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」四大核心面向，建構氣候變遷因應機制：

(1)治理 (Governance)

專責單位督導：設立「永續發展委員會」，定期評估氣候變遷等議題，並擬定中長期永續策略。委員會下之推動小組，由各單位最高主管組成，其中風險管理小組，共同辨識氣候風險、擬定對應策略，並檢視目標達成情形。

永續發展委員會定期向之董事會報告，包含氣候風險管理執行現況與 ESG 重大議題進度，董事會針對報告內容給予策略指導與可行性建議，並持續督促，落實實質監督。

(2)策略 (Strategy)

研發與晶片設計：我們將永續融入產品生命週期，專注於高效能、低功耗的多應用晶片研發。透過持續優化晶片架構與設計，協助客戶開發出更具節能優勢的終端綠色概念產品，降低碳足跡。

營運與設施節能：在日常營運中推動辦公室節能減碳、逐步汰換耗能空調與冰水主機等硬體設備外，取得供應鏈夥伴之產品功耗與碳排數據，可共同規劃相關綠色產品標籤認證。

(3)風險管理 (Risk Management)

風險鑑別與評估流程：永續發展委員會透過風險鑑別，盤點內外部潛在氣候議題，依照對財務與營運的衝擊程度進行排序，相對應之風險管理與緩解措施。

動態檢視與滾動修正：檢視政策法規、技術創新、市場需求等「轉型風險與機會」，並結合「風險管理政策與程序」評估旱災、水災等「實體風險」，並確保公司具備彈性的調適能力。

(4)指標與目標 (Metrics and Targets)

日常節能減碳：每年度訂定內部節水與節電標準，並落實定期追蹤達成率。

溫室氣體盤查與查證進程：持續遵循 ISO 14064-1:2018 國際標準執行溫室氣體盤查，預計於明年度完成第三方查證認證，建立可信賴的溫室氣體排放量。

3.氣候因應(TCFD)

(1)董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理

董事會為本公司氣候治理的最高監督單位，負責掌握氣候變遷對企業長期發展的衝擊與契機。永續發展委員會定期向董事會報告，針對包含氣候變遷、溫室氣體盤查進程等 ESG 議題之執行成果，並依據外部環境趨勢提供具前瞻性的策略指導與可行性建議，持續追蹤各項環境指標的執行進度，督促管理階層動態調整治理規劃。

委員會下設專責之「永續經營風險組」，係依據公司制定的「風險管理政策與程序」，將氣候變遷風險全面納入企業整體的風險管理流程中。每年定期召集各單位，全面辨識並評估氣候等各面向之潛在風險因子，以鑑別需高關注度之重大議題，據此檢視調適策略之落實情形。

為了促使管理階層積極落實氣候轉型，本公司未來將氣候行動與高階主管的激勵機制相結合。「薪資報酬委員會」於每年審閱經理人之薪酬制度時，將溫室氣體盤查、綠色研發進度及能源管理等 ESG 關鍵績效指標 (KPIs) 之達成程度，實質納入績效評估中。透過獎勵制度與氣候變遷管理成果的緊密連結，使管理階層在追求公司業務成長的同時，亦兼顧永續經營承諾，為投資人與全體利害關係人創造長遠價值。

(2)所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)

本公司為確保營運穩定及企業永續經營，評估氣候變遷可能會產生的風險、機會及因應策略並推測其可能對財務產生的影響如下：

●風險項目：

風險項目	評估 發生時間	可能產生議題	對財務 的影響	因應策略
實體風險- 氣候極端 變化	長期	暴雨、乾旱、洪水等極端氣候事件嚴重程度增加;海平面及全球溫度上升	營收減少、 原 物料成 本增加	短期策略： 每年進行溫室氣體的盤查， 並追蹤比較各年度溫室氣體排放情形
				長期策略： 目標達到 2050 淨零排放
轉型風險- 符合環保 法規之原 物料選擇	短期	國際法規對於產品的禁限用物質持續增加，供應商端生產所使用之直接材料的符合度需符合法規，否則可能面臨賠償風險		定期追蹤國際法規是否更新，並及時對供應商展開調查，確保產品符合國際環保法規及客戶要求

●機會項目：

機會項目	評估發生時間	可能產生議題	對財務的影響	因應策略
綠能產品的創新應用	中期	因應全球環保意識抬頭，市場更著重於綠能的應用開發	產品應用市場增加、營收上升、研發成本增加	提前掌握產品趨勢開發，生產低耗能、低電力的晶片，增加於新能源市場、智慧家電應用，冷凝散熱產品優先佈局
能源效率的提升	中期	用水量、電力及其他營運產生的費用大幅減少，可回收資源重複利用	減少營業成本	持續落實節能減碳措施；掌握公司各年度溫室氣體排放情形；依據需求添購綠能家電

(3)極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。

本公司針對極端氣候事件（實體風險）及轉型行動（轉型風險與機會）所進行之財務衝擊評估，請參閱 2.所列之表格，透過將風險量化的方式，確保各項永續策略與公司的財務規劃（包含研發預算編列、供應鏈管理成本）緊密結合。

(4)敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。

為健全公司治理並強化企業在面臨不確定性時的營運風險，晶宏透過永續發展委員會之永續推動小組，將氣候變遷可能引發的環境風險，納入公司整體的風險管理與日常營運流程中，並將管理成效與調整方案，定期向永續發展委員會及董事會進行報告。運作流程如下：

【風險辨識】盤點內外部潛在氣候因子（法規、市場、實體災害）



【風險分析】評估「發生可能性」與「衝擊度」，量化風險



【評量與回應】篩選高關注議題，由董事長審視並擬定減緩對策



【監督與審查】定期監控執行成效，每年至少一次向董事會提報

(5)若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。

晶宏為 IC 設計公司，相較其他行業別對風險因子調度彈性較高。為進一步量化氣候變遷

對企業財務的潛在衝擊，我們正建立氣候情境分析機制。目前關注主管機關針對氣候情境所規劃的參數資料庫及重大假設，初步盤點未來執行情境分析時的核心考量因子如下：

情境、參數及主要假設因子

●轉型碳定價參數：評估未來若碳費起徵門檻（現行為 2.5 萬噸）逐步下修，或 2030 年後碳費率接軌國際碳定價水準（如每公噸新臺幣 1,200 元至 1,800 元）時，對公司整體營業費用與管理成本的潛在衝擊。

●實體風險推估：針對臺灣及核心供應商所在地之實體風險（如乾旱、暴雨致災等），規劃參考「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台 (TCCIP)」等權威數據。

●溫室氣體排放情境：規劃採用聯合國跨政府氣候變遷委員會（IPCC）第六次評估報告（AR6）中之共享社會經濟情境（Shared Socioeconomic Pathways, SSP）。

●價值鏈與邊境機制：分析因子將納入核心供應商（晶圓代工與封測）的地理分布、運送物流模式，以及核心產品是否涉及歐盟碳邊境調整機制或其他之潛在衝擊。

●模型獨立性：鑑於氣候風險交互影響的複雜度，初期模型規劃將各風險因子視為獨立變數評估，預估財務衝擊之評估時間軸將設定為 2027 年至 2050 年。

由於本公司目前的溫室氣體排放量未達現行環境部公告之門檻，短期內無直接之碳費財務支出。然而，我們將轉型風險視為隱形管理成本。未來隨著碳定價法規趨嚴，設算未來潛在的碳費負擔。目前本公司亦積極透過節能節電、研發高效能低功耗產品等手段，降低潛在的碳排財務曝險，確保營運韌性。

(6)若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。

●氣候轉型計畫內容：

本公司的轉型行動聚焦於「綠色營運」與「綠色研發」雙軌並進。我們透過落實日常辦公環境的節能減碳、階段性導入國際標準管理體系、定期評估氣候轉型風險，並偕同供應鏈伙伴建立減碳規畫。在產品端，我們持續投入資源研發多應用晶片的低功耗架構，協助客戶打造更具環保優勢的終端創新綠色產品，以實質行動協助整體半導體產業鏈降低隱形碳足跡。

●辨識與管理風險之指標：

本公司定期追蹤國內外環境保護法規的演變趨勢，並持續將國際永續指標評鑑之氣候風險項目作為內部自我檢視與優化的標竿，藉此建立客觀的氣候風險辨識指標。

●碳管理目標與滾動式修正：

本公司依據主管機關之時程，啟動溫室氣體自主盤查機制。依循 ISO 14064-1:2018 國際標準，推動範疇一（直接排放）與範疇二（能源間接排放）之碳足跡盤查。

●滾動式修正說明：

母公司晶宏近期因營運處所增加、擴增之現況，導致整體能源耗用與基準年數據產生結構性改變。預計將於 2027 年完成最新年度之溫室氣體盤查與第三方機構實地查證。本公司將待此次第三方查證結果正式出爐、掌握精確的碳排基準年後，重新精準修訂中長期的減碳百分比與指定減量目標，以確保永續承諾的務實性與可信賴度。

(7)若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。

本公司目前尚未正式導入內部碳定價機制，為因應全球碳管制趨勢及國內碳費法規的演變，我們正觀察國內外碳交易市場的動向、同業實踐成果與相關管理工具的成熟度。本公司規劃於未來合適階段，由永續發展委員會執行辦公室啟動內部碳定價機制的研議，評估將碳成本納入未來營運規劃、採購決策或研發專案的評估因子中，以強化長期的抗碳曝險能力。

(8)若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs) 以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs) 數量。

本公司以揭露碳排與落實減量為氣候行動的核心，積極推動各項環境指標的落實。

●本公司為專業晶片設計公司，營運模式採取無產線(Fabless)型態，不涉及晶圓製造、封裝及測試等高能耗、高化學製程之生產機台。辦公室及研發測試實驗室為我們的營運處所，在溫室氣體排放結構中，類別二(能源間接排放)之電力消耗為最主要的排放來源，其耗能組成主要來自空調系統、辦公與照明設備、電腦資訊設施及實驗室器材等。

●本公司主動接軌國際標準與國內上市櫃公司溫室氣體轉型路徑。我們依循 ISO 14064-1 國際標準持續辦理年度溫室氣體盤查。為確保碳數據的可信賴性，預計於 2027 年完成 2026 年度之溫室氣體盤查第三方確信與查證工作，後續亦將維持定期外部查證。

●碳抵換與再生能源憑證 (RECs) 之使用：

本公司目前尚未採購或使用再生能源憑證或碳權進行碳抵換。我們將持續關注環境部、法規演變與同業做法，秉持審慎評估的原則，將資源優先投入於內部低碳營運優化及外部供應鏈減碳協同上，未來再視減碳進程評估再生能源工具之綜合效益。

(9)溫室氣體盤查及確信情與減量目標、策略及具體行動計畫。

●溫室氣體盤查

本公司各年度之範疇一、範疇二及範疇三(價值鏈)溫室氣體具體排放數據，已完整揭露於本報告書。透過永續發展委員會推動小組定期進行能源耗用情形，確保日常減碳行

動落實。

●減量目標之調整

我們原先規劃以 2023 年為基準年，設定短期內類別一與類別二溫室氣體排放總量之減量目標。鑑於本公司近期因應業務與研發團隊擴展，辦公場域有所增設與擴增，導致整體的活動數據與能源耗用基線產生結構性變化。為了確保永續承諾的科學性與務實性，我們將於 2027 年取得 2026 年度之第三方查證正式結果後，結合新擴增營運處所的能耗，訂定中長期自主減碳目標（如 2030 年減碳藍圖）。

●減碳具體行動

針對目前能耗占比最高的辦公室用電與空調設備，本公司已採取具體的節能調適措施：配合室內冷房溫度設定管理（維持於 25°C 節能溫度）及增設省電定時裝置。同時，我們規劃與執行老舊、耗能硬體設備的階段性汰換，引進高能源效率的主機系統。照明系統升級逐步執行辦公區域之照明汰換計畫，將傳統日光燈管更換為高效率的 LED 節能燈具，可實質下修照明能耗。日常節電習慣落實辦公室低碳文化，包含推動午休時間辦公區集體關燈、全面將辦公事務機器與電腦設定為省電/休眠模式、縮短螢幕待機時間等，從細節降低不必要的電力浪費。

4.氣候變遷相關指標

本公司根據判別氣候變遷產生的風險及機會，訂定相關氣候變遷指標。

- (1)掌握本公司溫室氣體排放情形，預計母公司晶宏於 2028 年以前進行溫室氣體盤查第三方確信。
- (2)持續落實節能減碳措施，達到 2050 淨零排放目標。

6.2 溫室氣體排放 GRI 305-1、305-2、305-3、305-5

溫室氣體的相關議題近幾年來，備受全球的關注，我們深知地球的氣候與環境正遭受溫室氣體的影響而日趨惡化。為了能在未來更嚴峻的碳排放限制環境中，找到永續經營的新出路，故本公司重新定義企業價值，使企業經營最終要與社會、環境共存才能永續。晶宏集團將永續經營視為長期志業，未來將全力支持永續發展並制定長期框架，為實現永續發展目標做出貢獻，實現本公司的企業社會責任。

晶宏集團為 IC 設計產業無自有工廠，不適用取得 ISO14001、ISO14064 或 bluesign 認證，相關製程已委由外包廠商進行，因此沒有產生大量的電力用量、廢水、空汙、廢棄物等其他造成環境衝擊之溫室氣體排放項目。而晶宏集團自 2023 年配合金管會之推動及國際趨勢，為確保公開揭露之溫室氣體排放量之準確性，已完成溫室氣體盤查，並將盤查結果進行統計

分析，以提供日後規劃及實施改善計畫之參考依據。本公司亦將持續推動節能、環保、愛地球之永續方針，善盡身為地球公民的責任。

1.溫室氣體報告書依循準則如下:

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gases Inventories
- ISO 14064-1:2018 組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告指引之規範
- 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版
- 聯合國氣候變化政府間專家委員會 (IPCC) 第六次評估報告，2023
- 產品碳足跡資訊網

2.溫室氣體排放

SASB 指標編號	指標項目	2023 年	2024 年	2025 年
TC-SC-520a.1	(1)範疇一之全球總排放量 (單位：公噸 CO ₂ e)	39.5978	18.1116	28.7171
	(2)來自全氟化合物的總排放量 (單位：公噸 CO ₂ e)	母公司晶宏主要為晶片設計、研發及銷售，無晶圓製造、封裝、測試等相關半導體製程，故無 PFCs 之排放。		
TC-SC-110a.2	對管理範疇一排放之長期及短期策略或計畫、排放減量目標，以及針對該等目標之績效分析之討論	母公司晶宏為 IC 設計公司，故排放量主要來自類別二(範疇二)能源間接排放量-用電；類別一(範疇一)主要排放源為公務車輛用油、冷媒逸散等。晶宏因辦公室變遷，故更換新的冰水主及及飲水機等，類別一(範疇一)未來評估採用電動公務車來降低排放量。		

(1)晶宏各類別溫室氣體排放量：

單位：公噸 CO₂e

溫室氣體	直接排放量 類別一(範疇一)	能源間接排放量 類別二(範疇二)	其他間接排放量 類別三~六(範疇三)	總排放量
2023 年度	39.5978	273.1703	211.0057	523.7738
2024 年度	18.1116	274.5726	196.0140	488.6982
2025 年度	28.7171	269.5632	189.8753	488.1556

(2)晶宏集團各類別溫室氣體排放量：

單位：公噸 CO₂e

溫室氣體	直接排放量 類別一(範疇一)	能源間接排放量 類別二(範疇二)	其他間接排放量 類別三~六(範疇三)	排放密集度 (範疇一及二)
------	-------------------	---------------------	-----------------------	------------------

2023 年度	53.8223	424.6997	339.2472	0.2583
2024 年度	242.8686	411.2138	318.9718	0.4339
2025 年度	249.1301	401.3810	298.9621	0.4030

註：排放密集度單位為公噸 CO2e/百萬元營業額

(3)晶宏集團直接溫室氣體排放量：

單位：公噸 CO2e

溫室 氣體	二氧化碳 (CO2)	甲烷 (CH4)	氧化 亞氮(N2O)	氫氟 碳化物(HFCs)	總量
2023 年度	5.5313	18.0777	0.1738	30.0395	53.8223
2024 年度	5.7622	20.9253	0.1811	216.0000	242.8686
2025 年度	3.7966	10.5965	0.0479	234.6891	249.1301

註：晶宏無直接排放 PFCs、SF6、NF3 等氣體排放。

6.3 能源管理 GRI 302-1、GRI 302-4

1.能源使用

晶宏集團為 IC 設計公司，無製造、封裝、測試等自有工廠，營運空間以辦公室為主體，整體的能源耗用以照明設備、實驗設備、空調及電腦器材為主。

減碳目標：

現今溫室氣體的排放來源為電力使用，且達 95%以上。平日宣導同仁午休關燈等節約能源概念，加強冷氣清潔保養以提升冷氣效能，力行節能減碳措施。母公司晶宏積極推動各項節能計畫。三年為一期，訂定每期之二氧化碳排放量較上期減少 2%。

晶宏用電產生之二氧化碳氣體排放量：

年度	2024 年度	2025 年度
二氧化碳排放量(噸 CO2/度)	274.5726	269.5632
當期排放量(三年一期)	804.1099	800.8107

2025 年因員工人數增加及辦公室擴編，故本期未達減量 2%之目標。

SASB 指標編號	指標項目	2023 年	2024 年	2025 年
TC-SC-130a.1	(1)能源總耗用量 (含燃料、電力)(GJ) (註)	3,033.2701	2,941.3023	2,979.5714
	(2)電力耗用量占總能源耗用量之百分比(註 1)	100%	100%	100%
	(3)再生能源耗用量占總能源耗用量之百分	0%	0%	0%

註:能源總耗用量=當年度用電度數 $\times 3.6 \times 10^{-3}$ GJ，得此處能源總耗用量。

註 1：晶宏無製程設備，能源耗用量 100% 為辦公室耗用之電力。

晶宏集團能源使用統計

年份	2023 年度	2024 年度	2025 年度
總用電數(度)	842,575.0357	817,028.4208	827,658.7287
總能源耗用(GJ)	3,033.2701	2,941.3023	2,979.5714
二氧化碳放量(公噸 CO ₂ e/度)	424.6997	411.2138	401.3810

註：一度電等於 3.6×10^6 焦耳(J)，1GJ 等於 10^9 焦耳 (J)

2.晶宏集團能源節能措施

類別	計畫項目	說明
綠色文化	提倡重複使用	鼓勵員工攜帶瓷杯、保溫瓶，減少一次性餐具的使用。
		提倡自備便當盒及環保筷，降低紙餐盒與一次性餐具消耗。
		重複使用信封及牛皮紙袋，作為內部文件傳輸袋。
		文書用紙雙面列印，並在旁設置廢紙回收區，以降低紙張浪費。
	e 化作業	導入電子發票及政府電子公文交換系統，減少紙本文件使用
		部分使用線上簽核系統傳簽文件，加速資訊傳遞及減少浪費
辦公設備	綠色標章	採用省電節能標章的多功能事務機，並使用環保碳粉，以降低對環境的影響。
	節約政策	夏季辦公室空調統一設置恆溫 25 度，確保舒適節能併行。
		訂定午休關燈與下班關閉空調機制，減少不必要的消耗，為環境永續盡一份心力。

6.4 水資源管理 GRI 303-1、GRI 303-3、GRI 303-5

1.水資源管理

晶宏集團未從事產品之生產製造，100% 委外加工，營運以辦公室活動為主，故無透過物理和化學處理步驟所產生之超純水、製程用水及相關工業廢水排放。本公司理解全球氣候變遷與水資源短缺對社會帶來的深遠影響，為善盡企業社會責任，我們推行企業內部水資源管理政策，將水資源使用納入日常營運的檢視項目中。

為防範氣候異常對營運可能帶來的衝擊，本公司定期進行風險評估。鑑於本公司之取水源皆來自於各地區以水管及其他設施導引供應之合於衛生公共給水(自來水)，屬於一般生活用水，且營運據點非處於缺水之高風險區域，故目前水資源短缺對本公司整體營運之實質風險較低。

2.廢水排放

在廢水排放管理方面，本公司主要營運據點之辦公室所在地均設有完善的污水處理設施，負責處理大樓日常排放之生活污水，或直接接管至城市污水下水道系統送至污水處理廠。所有生活污水經妥善處理且水質符合國家放流水標準後方始流放，並嚴格接受主管機關之列管，2025 年度，晶宏集團無任何違反水資源或環境相關法規而遭主管機關裁罰之情事發生。

3.節水目標

晶宏在節水制定每年用水總度數減少 1%的減量目標，未來將持續檢視並制定更具前瞻性的用水效率指標。為達成此量化減量目標，本公司於內部推行各項節水行動：

評估辦公大樓內所使用之水龍頭、馬桶替換為具省水標章之功能產品，並將出水量調整至適當省水流速，從源頭避免水資源浪費。不定期透過內部公告與文宣進行節約用水宣導，全面提升員工的環保意識，將珍惜水資源的觀念內化於日常辦公行為中。

母公司晶宏用水量及二氧化碳排放量：

年度	2023 年	2024 年	2025 年
用水量(單位:度)	2,522	2,233	2,470
二氧化碳排放量(CO2e/度)	394	348	370

2025 年度用水量較 2024 年度增加，主係因員工人數增加及辦公場域調整。

晶宏集團用水量及二氧化碳排放量:

年度	2023 年	2024 年	2025 年
用水量(單位:度)	4,012	3,676	3,950
排放量(單位:噸 CO2/度)	0.6259	0.5740	0.5925

6.5 廢棄物管理 GRI 306-3、306-4、306-5

1.廢棄物

晶宏集團為專業 IC 設計公司，驅動晶片均委由代工廠生產製造，日常營運產生之廢棄物，包含塑膠、廢紙等一般廢棄物及產品開發測試時所產生或產品不良、過時庫存晶圓、膠捲、晶片、PCB 鍍金板等電子廢棄物。每年皆透過專業合法之廠商，依廢棄物清理法或政府相關規定之程序，交由專業處理廠商進行分解，以減少對環境衝擊為目標，回收再利用達成循環經濟的效果。

一般生活廢棄物分為一般垃圾及各資源回收類，同仁集中垃圾後，再由清潔公司確認回收分類並清運至指定回收區，後續由合格廢棄物清理公司運至焚化廠處理。生活廢棄物因與各其他廠戶共用，故統一由大樓處理，無法拆分出公司實際用量，此處僅揭露事業廢棄物重量。

SASB 指標編號	指標項目	2023 年	2024 年	2025 年
TC-SC-150a.1	(1)製造過程中產生之有害廢棄物重量(公噸) (2)其回收百分比(%)	0	0	0
		晶宏產品製造均委外，故無本身製造所產生之有害事業廢棄物。在管理作業上，我們將委外生產所退回的晶片不良品交付專業處理廠商進行不同類別的回收再利用及最終處置。		

2.管理政策

晶宏集團為專業 IC 設計公司，產品製造、封裝與測試均委由專業代工廠負責，本身無實體生產線。晶宏為降低營運對環境的衝擊，落實一般廢棄物及事業廢棄物的分類與回收，並嚴格遵循《廢棄物清理法》及政府相關環保法規之程序於廢棄物清理與流向，2025 年度，本公司無任何違反廢棄物管理或環境相關法規而遭主管機關裁罰之情事發生。

晶宏同時重視產品綠色供應鏈針對有毒與有害物質管理，嚴格要求合作之晶圓代工及封測廠商須符合國際環保法規（如 RoHS、REACH 等），並透過製程技術改善、原物料綠色採購等源頭管理措施，確保產品從設計到外包生產過程皆將有害物質降至最低，攜手供應商從源頭減少事業廢棄物的產出。

事業廢棄物處理狀況

重量單位:公噸

年度	2023 年	2024 年	2025 年
一般事業廢棄物-焚化(註 1)	0	0	1.8800
有害事業廢棄物-委外回收	0.5130	0.1537	0.2037
事業廢棄物總量	0.5130	0.1537	2.0837
事業廢棄物回收率(註 2)	100%	100%	9.78%

註：晶宏為晶片設計公司，製造皆外包予專業晶圓代工及封測廠，有害事業廢棄物來自外包廠不良品退回，而非本身營運製造所產生。

註 1：晶宏集團 2025 年度因部分辦公營運處所搬遷，增加一般廢棄物焚化處理，使事業廢棄物排放量增加。

註 2：事業廢棄回收率 = 「處理方式」為回收再利用及委外回收處理之廢棄物重量 / 事業廢棄物總量。

3.減量目標

在一般生活廢棄物方面 (包含一般垃圾、廚餘及資源回收類)，因本公司營運場所皆為辦公大樓，廢棄物皆由大樓統一委託清潔公司確認分類並清運，後續由合格廢棄物清理公司運至焚化廠處理，故無法獨立拆分出本公司之實際重量。透過內部辦公室節能減廢行動，目標使辦公室影印用紙量與一次性塑膠製品 (如紙杯、免洗餐具) 之採購量逐年減少。推行無紙化辦公，鼓勵同仁多利用電子公文與數位系統，減少影印用紙；全面禁止或減少提供一次性餐具，宣導並鼓勵同仁自備環保餐具及水壺。於辦公區落實嚴格的垃圾分類與廚餘回收機制，提升資源回收率，從日常辦公習慣中落實垃圾減量。晶宏日常營運及研發活動所產生之事業廢棄物，主要源自於產品開發測試時之不良品、研發耗損或過時庫存，包含晶圓、膠捲/膜類、廢晶片及 PCB 鍍金板等電子廢棄物，所有事業廢棄物每年皆透過專業、合法之廢棄物處理及回收廠商進行分類、分解與純化，未來將以事業廢棄回收率作為事業廢棄物減量指標。

附錄

附錄一 GRI 內容索引表

表 1 GRI STANDARD 通用準則揭露索引

準則	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 1：基礎 2021			
使用聲明	參考 GRI 準則報導於 2024 年期間的內容。		
適用的 GRI 行業準則	尚無行業準則，參考 SASB 半導體產業準則。		
GRI 2：一般揭露 2021			
組織及報導作法			
2-1	組織詳細資訊	1.1 關於晶宏	5
2-2	組織永續報導中包含的實體	關於本報告書	1
2-3	報導期間、頻率及聯絡人	關於本報告書	1
2-4	資訊重編	關於本報告書	1
2-5	外部保證/ 確信	關於本報告書	1
活動與工作者			
2-6	活動、價值鏈和其他商業關係	1.2 產業鏈位置	8
		1.3 營運概況	8
2-7	員工招募與留才	5.1 人才吸引與留任	58
2-8	不屬於員工的工作者	外包工作(清潔)人員: 2 人	
本公司於勞務承攬(委外)廠商遴選及簽約前，均進行查核廠商合法設立與營運資格，並確認其符合勞動相關法令規範，做為合作評估依據。			
治理			
2-9	治理結構及組成	2.1 公司治理	13
2-10	最高治理單位的提名與遴選	2.1 公司治理	13
2-11	最高治理單位的主席	2.1 公司治理	13
2-12	最高治理單位於監督衝擊管理的角色	3.1 利害關係人議合	33
		2.1 公司治理	13
2-13	衝擊管理的負責人	2.1 公司治理	13
2-14	最高治理單位於永續報導的角色	2.1 公司治理	13
2-15	利益衝突	請參考 2025 年報	
2-16	溝通關鍵重大事件	2.1 公司治理	13

準則	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
2-17	最高治理單位的群體智識	2.1 公司治理	13
2-18	最高治理單位的績效評估	2.1 公司治理	13
2-19	薪酬政策	2.1 公司治理 5.3 薪酬福利	13 68
2-20	薪酬決定流程	2.1 公司治理 5.2 人才培育與發展	13 63
2-21	年度總薪酬比率	5.1 人才吸引與留任 請參考 2025 年年報	58
2-22	永續發展策略的聲明	經營者的話	3
2-23	政策承諾	請參考晶宏官網： 企業永續發展	
2-24	納入政策承諾	請參考晶宏官網： 企業永續發展	
2-25	補救負面衝擊的程序	3.1 利害關係人議合 2.4 誠信經營	33 25
2-26	尋求建議和提出疑慮的機制	2.1 公司治理 2.4 誠信經營	13 25
2-27	法規遵循	2.2 稅務治理	14
2-28	公協會的會員資格	5.4 人權與員工溝通	71
利害關係人議合			
2-29	利害關係人議合方針	3.1 利害關係人議合	33
2-30	團體協約	5.4 人權與員工溝通	71
GRI 3：重大主題 2021			
3-1	決定重大主題流程	3.2 重大性分析	35
3-2	重大主題列表	3.3 重大主題鑑別	39
重大主題準則揭露索引			
經濟主題			
GRI 200：經濟績效 2016			
3-3	重大主題管理	重大永續議題的管理方針 及目標：經營績效	
201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	1.3 營運概況	8

準則	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會	6.1 氣候變遷	79
GRI 205：反貪腐 2016			
3-3	重大主題管理	重大永續議題的管理方針及目標：誠信治理	
205	反貪腐	2.4 誠信經營	25
206	反競爭行為	2.4 誠信經營	25
GRI 418：資訊安全 2016			
3-3	重大主題管理	重大永續議題的管理方針及目標：資安與隱私管理	
418-1	客戶隱私:2016	2.5 資訊安全	27
GRI 300：環境主題 2016			
GRI 204：採購實務 2016			
3-3	重大主題管理	重大永續議題的管理方針與目標：供應鏈管理	
204-1	來自當地供應商的採購支出比例	4.3 永續供應鏈	47
308-1	採用環境標準篩選新供應商	4.3 永續供應鏈	47
308-2	供應鏈中負面的環境衝擊以及所採取的行動	4.3 永續供應鏈	47
414-1	使用社會標準篩選新供應商	4.3 永續供應鏈	47
414-2	供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動	4.3 永續供應鏈	47
GRI 302：能源 2016			
3-3	重大主題管理	重大永續議題的管理方針與目標：產品創新與研發	
302	能源	4.4 創新管理	53
416	客戶健康與安全	4.4 創新管理	53
GRI 2-29：利害關係人議合方針 2016			
3-3	重大主題管理	重大永續議題的管理方針與目標：客戶關係管理	
2-29	利害關係人議合	4.2 客戶關係管理	42

準則	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 400：社會主題 2016			
GRI 204：勞雇關係 2016			
3-3	重大主題管理	重大永續議題的管理方針及目標：人才培育	
401-1	新進員工和離職員工	5.1 人力吸引與留任	58
401-2	提供給全職員工（不包括臨時或兼職員工）的福利	5.1 人力吸引與留任	58
402	勞資關係	5.5 職安與員工健康	74
404-1	員工每年接受訓練的平均時數	5.2 人力培育與發展	63
405-1	治理單位和員工的多元化	2.1 公司治理	13
		5.1 人才吸引與留任	58

附錄二 氣候相關資訊

氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施

項目	報告書揭露章節
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理	6.1 氣候變遷
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務短期、中期、長期	6.1 氣候變遷
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	6.1 氣候變遷
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險	6.1 氣候變遷
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因數及主要財務影響。	6.1 氣候變遷
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	6.1 氣候變遷
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	6.1 氣候變遷
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證 (RECs)數量。	6.1 氣候變遷
9.溫室氣體盤查及確信情形	6.2 溫室氣體排放
9-1-1.最近二年度溫室氣體盤查資訊	6.2 溫室氣體排放
9-1-2.最近二年度溫室氣體確信資訊	6.2 溫室氣體排放
9-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。	6.3 能源管理 6.4 水資源管理 6.5 廢棄物管理

附錄三 產業別永續指標資訊

編號	指標	種類	揭露情形	單位	頁碼
1	消耗能源總量、外購電力百分比 及再生能源使用率	量化	6.3 能源管理	十億焦耳(GJ) / 百分比(%)	87
2	總取水量及總耗水量	量化	6.4 水資源管理	二氧化碳(CO2)/度	89
3	所產生有害廢棄物之重量及回收百分比	量化	6.5 廢棄物管理	公噸 (t)	90
4	說明職業災害類別、人數及比率	量化	5.5 職安與員工健康	數量	74
5	產品生命週期管理之揭露：含報廢產品及 電子廢棄物之重量以及再循環之百分比	量化	6.5 廢棄物管理	公噸 (t)	90
6	與使用關鍵材料相關的風險管理之描述	質化	4.3 永續供應鏈	不適用	47
7	因與反競爭行為條例相關的法律訴訟而造成之損失 的金錢	量化	4.5 智慧財產權	不適用	55
8	依產品類別之主要產品產量	量化	1.2 產業鏈位置	不適用	8

附錄四 其他準則(永續議題資訊蒐集邊界)

●蒐集完整資訊 ◎蒐集部分資訊 - 未納入資訊蒐集邊界

邊界(章節/議題)	晶宏(母公司)	子公司(集團合併子公司)
關於本報告書	●	●
經營者的話	●	●
年度永續亮點	●	●
1.1 關於晶宏	●	●
1.2 產業鏈位置	●	●
1.3 營業概況	●	●
1.4 社會回饋	●	◎
2.1 公司治理	●	◎
2.2 稅務治理	●	◎
2.3 風險管理	●	◎
2.4 誠信經營	●	◎
2.5 資訊安全	●	◎
3.1 利害關係人議合	●	●
3.2 重大主題鑑別	●	●
3.3 重大主題列表	●	●
3.4 重大主題管理方針	●	●
4.1 產品品質	●	●
4.2 客戶關係管理	●	●
4.3 永續供應鏈	●	●
4.4 創新管理	●	●
4.5 智慧財產權	●	●
5.1 人才吸引與留任	●	●
5.2 人才培育與發展	●	●
5.3 薪酬福利	●	●
5.4 人權與員工溝通	●	●
5.5 職安與員工健康	●	●
6.1 氣候變遷	●	●
6.2 溫室氣體排放	●	●
6.3 能源管理	●	●
6.4 水資源管理	●	●
6.5 廢棄物管理	●	●

附錄五 確信機構意見書

母公司晶宏基本資料

- 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業
- 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司
- 資本額未達 50 億元之公司

依上市櫃公司永續發展路徑圖規定，應於以下時點揭露溫室氣體盤查資訊：

1. 母公司個體應於 2026 年完成 2025 年度溫室氣體盤查，並於年報揭露盤查資訊；2028 年完成 2027 年度個體盤查資訊及確信情形，並於年報揭露盤查資訊及確信情形。
2. 合併財務報告子公司應於 2027 年完成 2026 年度溫室氣體盤查，並於年報揭露盤查資訊；2029 年完成 2028 年度合併財務報告子公司盤查資訊及確信情形，並於年報揭露盤查資訊及確信情形。

晶宏集團目前每年完成溫室氣體盤查，未來將於 2027 年進行查證確信。